

(12) 特許協力条約に基づいて公開された国際出願

7a

(19) 世界知的所有権機関  
国際事務局



(43) 国際公開日  
2012年1月5日 (05.01.2012)

PCT

(10) 国際公開番号  
W O 2012/001967 A 1

- (51) 国際特許分類 :  
H01L 27/04 (2006.01) H01L 27/088 (2006.01)  
H01L 21/336 (2006.01) H01L 29/739 (2006.01)  
H01L 21/8234 (2006.01) H01L 29/78 (2006.01)  
H01L 27/06 (2006.01)
- (21) 国際出願番号 : PCT/JP201 1/003718
- (22) 国際出願日 : 2011年6月29日 (29.06.2011)
- (25) 国際出願の言語 : 日本語
- (26) 国際公開の言語 : 日本語
- (30) 優先権データ :  
特願 2010-15 1235 2010年7月1日 (01.07.2010) JP  
特願 2011-139567 2011年6月23日 (23.06.2011) JP
- (71) 出願人 (米国を除く全ての指定国について): 株式会社デンソー(DENSO CORPORATION) [JP/JP];  
〒4488661 愛知県刈谷市昭和町1丁目1番地 Aichi (JP).
- ( ) 発明者 ;および
- ( ) 発明者/出願人 (米国についてのみ): 田邊 広光  
(TANABE, Hiromitsu) [JP/JP]; 〒4488661 愛知県刈

谷市昭和町1丁目1番地株式会社デンソー内 Aichi (JP). 河野 憲司 (KOUNO, Kenji) [JP/JP]; 〒4488661 愛知県刈谷市昭和町1丁目1番地株式会社デンソー内 Aichi (JP). 都築 幸夫 (TSUZUKI, Yukio) [JP/JP]; 〒4488661 愛知県刈谷市昭和町1丁目1番地株式会社デンソー内 Aichi (JP).

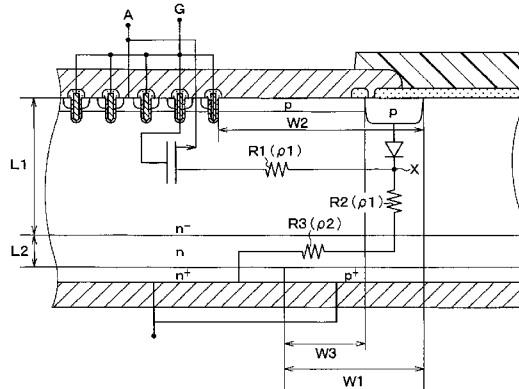
(74) 代理人 : 金 順姫 (KIN, Junji); 〒4600003 愛知県名古屋市中区錦2丁目1番19号 瀧定ビル6階 Aichi (JP).

(81) 指定国 (表示のない限り、全ての種類の国内保護が可能): AE, AG, AL, AM, AO, AT, AU, AZ, BA, BB, BG, BH, BR, BW, BY, BZ, CA, CH, CL, CN, CO, CR, CU, CZ, DE, DK, DM, DO, DZ, EC, EE, EG, ES, FI, GB, GD, GE, GH, GM, GT, HN, HR, HU, ID, IL, IN, IS, KE, KG, KM, KN, KP, KR, KZ, LA, LC, LK, LR, LS, LT, LU, LY, MA, MD, ME, MG, MK, MN, MW, MX, MY, MZ, NA, NG, NI, NO, NZ, OM, PE, PG, PH, PL, PT, RO, RS, RU, SC, SD, SE, SG, SK, SL, SM, ST, SV, SY, TH, TJ, TM, TN, TR, TT, TZ, UA, UG, US, UZ, VC, VN, ZA, ZM, ZW.

[続葉有]

- (54) Title: SEMICONDUCTOR DEVICE
- (54) 発明の名称 : 半導体装置

[図4]



(57) Abstract: Disclosed is a semiconductor device wherein  $W3 \geq ((k2 \cdot (DT) \tau)^2 - L1^2)^{1/2}$ ;  $W2 \geq L1 / K^{1/2}$  (where  $K \geq 2$ ); and  $W1 \geq 10\mu m$ , where  $L1$  is the thickness of a drift layer (1),  $D$  is a carrier dispersal coefficient;  $\tau$  is the lifetime;  $k1$  is a first parameter based on an IGBT (100) and an FWD (200);  $k2$  is a second parameter  $k2$  based on a well layer (13); and  $k$  is the value obtained by multiplying, by  $k1$ , the ratio of the snap-back voltage to the built-in potential between the well layer and the drift layer.  $W1$  is the distance from a location whereat a peripheral end part of the well layer is projected on the rear face of the drift layer to a boundary between a cathode region (3) and a collector region (2);  $W2$  is the distance from a boundary between the IGBT and the FWD, from among the base region (4), to the peripheral end part of the well layer; and  $W3$  is the distance from the location whereat the boundary between the well layer and the base region is projected on the rear face to the boundary between the cathode region and the collector region. It is thus possible to alleviate deteriorations in tolerance of the FWD as the hole injection from the well layer increases when the well layer is the anode, while also alleviating reductions in the region that essentially functions as the anode by causing the holes to reach from areas that are adjacent to the borders of the cell regions within the well layer.

(57) 要約 :

[続葉有]



W O 2012/001967 A 1



- (84) 指定国 (表示のない限り、全ての種類の広域保護力(何国)ARIPO (BW, GH, GM, KE, LR, LS, MW, ML, NA, SD, SL, SZ, TZ, UG, ZM, ZW), ユーラシア (AM, AZ, BY, KG, KZ, MD, RU, TJ, TM), ヨーロッパ (AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR), OAPI (BF, BJ, CF, CG, CI, CM, GA, GN, GQ, GW, ML, MR, NE, SN, TD, TG).
- 添付公開書類：  
 - 国際調査報告 (条約第 21 条(3))

ドリフト層 (1) の厚み  $L_1$ 、キャリアの拡散係数を  $D$ 、ライフタイムを  $\tau$ 、IGBT (100) および FWD (200) に基づく第 1 パラメータを  $k_1$ 、ウエル層 (13) に基づく第 2 パラメータを  $k_2$ 、ウエル層とドリフト層の間のビルトインポテンシャルに対するスナップバック電圧の比に  $k_1$  を掛けた値を  $K$  とすると、 $W_3 \geq ((k_2 \cdot (D \tau)^{1/2})^2 - L_1^2)^{1/2}$  かつ、 $W_2 \geq L_1 / K^{1/2}$  ( $K \geq 2$ ) かつ、 $W_2 - W_1 \geq 10 \mu\text{m}$ 。  $W_1$  は、ウエル層の外周側端部をドリフト層の裏面側に投影した位置よりカソード領域 (3) とコレクタ領域 (2) との境界部までの距離。  $W_2$  は、ベース領域 (4) のうち IGBT と FWD との境界部からウエル層の外周側端部までの距離。  $W_3$  は、ウエル層とベース領域との境界部を裏面側に投影した位置よりカソード領域とコレクタ領域との境界部までの距離。これにより、ウエル層がアノードとなるときに、ウエル層からのホール注入が多くなることで FWD の耐量が低下してしまうことを抑制しつつ、ウエル層のうちセル領域の外縁近傍からのホールが届かせ、実質的にアノードとして機能する領域が減少することを抑制することができる。

## 明 細 書

発明の名称 : 半導体装置

## 関連出願の相互参照

- [0001] 本出願は、2010年7月1日に出願された日本特許出願2010\_151235号および2011年6月23日に出願された日本特許出願2011-139567号を基にしており、そしてそれらを参照することによって、その開示内容を本出願に組み込む。

## 技術分野

- [0002] 本発明は、スイッチング素子として機能する絶縁ゲート型バイポーラトランジスタ (以下、IGBTという) とフリーホイールダイオード (以下、FWDという) とが同一チップ内に集積化された半導体装置に関するものである。

## 背景技術

- [0003] 従来より、直流—交流変換を行うためのインバータ回路などでは、スイッチング素子として機能するIGBTとFWDとが同一チップ内に集積化された半導体装置が使用されている。IGBTのオンオフによって直流—交流変換を行うと共に、IGBTをオフしたときに、FWDを通じて負荷 (例えばモータ) に流れる電流を還流させている。
- [0004] このような半導体装置に使用されるFWDでは、IGBTがオフしているときの順方向電圧 $V_f$ に対する順方向電流 $I_f$ の特性 (以下、 $V_f - I_f$ 特性という) は線形となるが、IGBTをオンしたときの $V_f - I_f$ 特性はスナップバック電圧の影響により非線形な領域が発生する。図6は、FWDの $V_f - I_f$ 特性を示した図である。この図に示されるように、IGBTがオンしたときにはオフしているときと比較して順方向電圧 $V_f$ が変動すると共に、スナップバック電圧が発生する領域があり、線形性が得られない。
- [0005] 具体的には、IGBTとFWDとを1チップに形成した半導体装置の場合、IGBTをオンしたときの等価回路図は、図7のように示される。すなわ

ち、p型ディープウェル層13とn型ドリフト層1にて構成されるFWD200に対してIGBT100のチャンネル抵抗 $R_a$ とチャンネルからFWD200のPN接合部（p型ディープウェル層13の下部）に至るまでの内部抵抗 $R_b$ とが並列的に接続され、さらにこれらにp型ディープウェル層13の下部におけるn型ドリフト層1の内部抵抗 $R_c$ とフィールドストップ（以下、FSという）層1aの内部抵抗 $R_d$ を直列的に接続した状態となる。このような回路において、IGBT100がオンすると、内部抵抗 $R_b$ が小さいことからダイオード側よりもIGBT100のチャンネル側にばかり電流が流れるため、伝導度変調が起きず、順方向電圧 $V_f$ が増大してしまう。

[0006] このため、IGBT100とFWD200を備えた半導体装置では、FWD200動作時にIGBT100にゲート電圧を印加しないようにゲート制御を行う。そして、FWD200の動作を判定するために、ダイオードセンスを行っているが、正確なセンスを行うためには $V_f - I_f$ 特性に線形性が要求されるため、スナップバック電圧の影響を受ける非線形な領域を避けてセンスを行わなければならない、順方向電圧 $V_f$ が大きくなるところでしか適用できなかった。

[0007] これに対して、特許文献1において、ゲート構造がないp型ベース領域4の幅を広くすることで、 $V_f$ の増大を抑制することが提案されている。

#### 先行技術文献

#### 特許文献

[0008] 特許文献1：特開2008\_53648号公報

#### 発明の概要

[0009] しかしながら、FWD200として機能する領域を広げることによってIGBT100の領域を減らすことになるため、IGBT100のオン損失が大きくなるという問題がある。

[0010] 本発明は上記点に鑑みて、FWDの $V_f - I_f$ 特性の線形性を改善しつつ、IGBTのオン損失を低減できる半導体装置を提供することを目的とする。

[001 1] 上記目的を達成するため、本発明のひとつの態様では、ディープウェル層の外周側端部をドリフト層の裏面側に投影した位置よりカソード領域とコレクタ領域との境界部までの距離を $W_1$ 、ベース領域のうち絶縁ゲート型バイポーラトランジスタとフリーホイールダイオードとの境界部からディープウェル層の外周側端部までの距離を $W_2$ 、ディープウェル層とベース領域との境界部を裏面側に投影した位置よりカソード領域とコレクタ領域との境界部までの距離を $W_3$ 、ドリフト層の厚みを $L_1$ 、ドリフト層内でのキャリアの拡散係数を $D$ 、キャリアのライフタイムを $\tau$ 、絶縁ゲート型バイポーラトランジスタおよびフリーホイールダイオードの構造に基づいて決まる第1パラメータを $k_1$ 、ディープウェル層の構造に基づいて決まる第2パラメータを $k_2$ 、ディープウェル層とドリフト層の間のビルトインポテンシャル ( $V_{AK}(th)$ ) に対するスナップバック電圧 ( $V_{SB}$ ) の比に対して第1パラメータ $k_1$ を掛けた値 ( $k_1 \cdot V_{SB} / V_{AK}(th)$ ) を $K$ とすると、

距離 $W_1$ と距離 $W_2$ および距離 $W_3$ は、

$$W_3 \geq \left( (k_2 \cdot (D\tau)^{1/2})^2 - L_1^2 \right)^{1/2}$$

かつ、

$$W_2 \geq L_1 / K^{1/2}$$

ただし、 $K \geq 2.5$

かつ、

$$W_2 - W_1 \geq 10 \mu m$$

を満たす値とされていることを特徴としている。

[001 2] このように、距離 $W_1$ と距離 $W_2$ と距離 $W_3$ が上記3つの数式を満たす値となるようにしている。これにより、深いディープウェル層がアノードとなるときに、ディープウェル層からのホール注入が多くなることでFWDの耐量が低下してしまうことを抑制しつつ、ディープウェル層のうちセル領域の外縁近傍からのホールが届かず、実質的にアノードとして機能する領域が減少することを抑制することができる。

[001 3] 本発明の他の態様では、距離 $W_3$ 、 $W_2$ 、 $W_1$ が

$$W_3 = \left( (k_2 \cdot (D\tau)^{1/2})^2 - L_1^2 \right)^{1/2}$$

$$\text{かつ } W_2 = L_1 / K^{1/2}$$

かつ

$$W_2 - W_1 = 10 \text{ nm}$$

であると好ましい。

[001 4] 本発明の他の態様では、セル領域および外周領域において、第 1 導電型のドリフト層の裏面側に、ドリフト層よりも高不純物濃度とされた第 1 導電型のフィールドストップ層が配置され、このフィールドストップ層の表層部にコレクタ領域およびカソード領域が形成される半導体装置に対しても適用できる。

[001 5] 本発明の他の態様では、ベース領域を貫通し、一方向を長手方向として複数本が所定の間隔で並べられたトレンチを備え、ゲート絶縁膜およびゲート電極がトレンチ内において形成されたトレンチゲート構造の半導体装置に対して適用すると好ましい。

[001 6] 本発明の他の態様では、ゲート構造の長手方向の先端位置においても、距離  $W_1$  と距離  $W_2$  および距離  $W_3$  が、

$$W_3 \geq \left( (k_2 \cdot (D\tau)^{1/2})^2 - L_1^2 \right)^{1/2}$$

かつ、

$$W_2 \geq L_1 / K^{1/2}$$

ただし、 $K \geq 2.5$

$$\text{かつ } W_2 - W_1 \geq 10 \text{ nm}$$

を満たすようにすることで、ゲート構造の長手方向の先端位置においても、FWD の耐量が低下してしまうことを抑制しつつ、ディープウェル層のうちセル領域の外縁近傍からのホールが届かず、実質的にアノードとして機能する領域が減少することを抑制することができる。

[001 7] 本発明の他の態様では、複数のゲート構造の間の一部において、エミッタ領域が形成されない部分を備えることにより、エミッタ領域が形成されていて IGBT として動作する部分を含む第 1 の領域と、エミッタ領域が形成さ

れない部分を含み、かつ、当該部分が F W D として動作する第 2 の領域とを構成し、 I G B T を囲む F W D が備えられ部分を第 3 の領域として、第 1 の領域および第 2 の領域は、ゲート構造と同方向が長手方向とされ、第 3 の領域に加えて第 2 の領域にも F W D を備えた構成とすることを特徴としている。

[001 8] このように、第 1 ～第 3 の領域を備えた場合において、第 2 の領域にも F W D が備えられるようにすることで、ゲート電圧印加時に動作する F W D の面積を増やすことが可能となり、スナツプ/クック電圧の低減を図ることが可能となる。

[001 9] 本発明の他の態様では、エミッタ領域が形成されない部分の幅が  $20\ \mu\text{m}$  以上とされるようにすると好ましい。

このように、第 2 の領域に備えられる F W D の幅を  $20\ \mu\text{m}$  以上とすることで F W D のオン電圧を低減することが可能となる。

[0020] 本発明の他の態様では、カソード領域は、第 1 の領域の長手方向と同方向を長手方向として形成されていると共に、第 1 の領域の長手方向先端部よりも突き出して配置されており、該長手方向において分割されていることを特徴としている。

[0021 ] このような構成とすれば、分割したカソード領域の間のコレクタ領域によって構成される I G B T にて I G B T 動作させることで電流を流し、電流密度を高くすることで他の部分の I G B T についても I G B T 動作させるようにする。これにより、I G B T のスナツプバック電圧を低減することが可能となる。これにより、F W D の面積を増やすことによるスナツプバック電圧の低減と、I G B T を動作させやすくすることによるスナツプバック電圧の低減の両立を図ることが可能となる。

[0022] 本発明の他の態様では、第 1 の領域は長手方向において複数に分割されていることを特徴としている。このように、第 1 の領域を複数に分割するようにしても良い。この場合において、分割された第 1 の領域の間の領域にベース領域のみが形成されることで、当該領域にも F W D が構成されるようにす

れば、図 12 (c) の W4 の広い FWD の面積を増やすことやこの領域が第 3 の領域の補助的な役割をすることが可能となり、スナツプバック電圧の低減を図ることが可能となる。

[0023] 本発明の他の態様では、カソード領域を第 1 の領域の長手方向と同方向を長手方向として形成し、第 1 の領域の長手方向先端部の方がカソード領域の長手方向先端部よりも突き出して配置されるようにすることもできる。

[0024] このように、カソード領域を第 1 の領域の長手方向と同方向を長手方向として形成する場合において、第 1 の領域が長手方向において分割されていると、その分割されている領域においてスナツプバック電圧が大きくなることが懸念される。しかしながら、第 1 の領域の長手方向先端部の方がカソード領域の長手方向先端部よりも突き出して配置されるようにすることで、この領域で IGBT が形成されるようにできる。このため、この領域で IGBT 動作させることで電流を流し、電流密度を高くすることで他の部分の IGBT についても IGBT 動作させるようにできる。これにより、IGBT のスナツプ/ック電圧を低減することが可能となる。

[0025] 本発明の他の態様では、分割された第 1 の領域の間の距離が距離 W2 の 2 倍以上とされるようにすることを特徴としている。

[0026] このように、分割された第 1 の領域の間の距離を距離 W2 の 2 倍以上に取ることにより、この領域をトレンチゲート構造の両先端位置に配置される第 3 の領域の代わりとすることもできる。

[0027] 本発明の他の態様では、第 1 の領域は、さらに長手方向において複数箇所で分割されており、複数箇所で分割された当該第 1 の領域の間の領域にエミッタ領域が形成されないことで、当該領域にも FWD が構成され、カソード領域は、複数箇所で分割された第 1 の領域の間の領域と対応する位置において第 1 の領域と対応する位置よりも幅広とされていることを特徴としている。

[0028] このような構成によれば、分割された第 1 の領域の間においてダイオード動作させられる FWD の面積を増やすことやこの領域が第 3 の領域の補助的



な役割をすることができ、よりFWDのスナップバック電圧を低減できる。

[0029] 本発明の他の態様では、第1の領域は複数本並べて配置され、隣り合う当該第1の領域のうち対向する辺の一部が凹まされ、該凹まされた領域にもFWDが構成されていることを特徴としている。

[0030] このように、FWDが構成される領域の幅を広げることにより、その領域に構成されるFWDがダイオード動作し易くなる。これにより、FWDの面積が増えることやこの領域が第3の領域の補助的な役割をすることで半導体装置全体のスナップバック電圧を小さくすることが可能になる。

[0031] 本発明の他の態様では、カソード領域は、第1の領域の長手方向と同方向を長手方向として形成されており、第1の領域の一部が凹まされた領域に設けられたFWDと対向して、当該凹まされた領域に設けられたFWDの幅に合わせてカソード領域が形成されるようにすると好ましい。

[0032] このような構成によれば、幅広とされたFWDとされる領域とカソード領域とが対向したレイアウトとなり、その部分を効率的にダイオード動作させられるため、よりFWDのスナップバック電圧を低減できる。

[0033] 本発明の他の態様では、カソード領域は、第2の領域と対応する場所に形成された領域と、該第2の領域と対応する場所に形成された領域よりも幅が狭く、第1の領域と対応する場所に形成された領域とを有していることを特徴としている。

[0034] このような構成によれば、カソード領域のうちの第2の領域と対応する場所に形成された領域についてはダイオード動作を行わせ、第1の領域と対応する場所に形成された領域についてはMOS動作を行わせることができる。このため、IGBT動作を基本としつつ、MOS動作も行わせることが可能になることから、スイッチング損失の低減を図ることが可能となる。このようなスイッチング損失の低減効果は、半導体装置をインバータ駆動に適用する場合のように頻繁にスイッチングが行われるような適用形態とされる場合に有効である。

[0035] 本発明の他の態様では、ドリフト層の裏面側において、セル領域の外縁部

には、コレクタ領域およびカソード領域が混在する混在領域が備えられていることを特徴としている。

[0036] このように、セル領域の外縁部においてコレクタ領域とカソード領域とを混在させた混在領域を備えることで、寄生トランジスタがオンし難くなるようにできる。これにより、半導体装置の耐量を向上させられる。また、キャリア再注入を抑制できるため、スイッチング損失の低減を図ることも可能となる。

[0037] なお、上記各手段の括弧内の符号は、後述する実施形態に記載の具体的手段との対応関係を示すものである。

### 図面の簡単な説明

[0038] [図1] 本発明の第1実施形態にかかる半導体装置の断面図である。

[図2] 図1に示す半導体装置の上面レイアウト図である。

[図3] p型ディープウエル層13からn+型不純物領域3までの距離とキャリアのライフタイムとの関係を示した半導体装置の断面図である。

[図4] 図1に示す半導体装置のダイオード作動を行うときの等価回路を模式的に描いた断面図である。

[図5] 図1に示す半導体装置のアノード-カソード間電圧 $V_{AK}$ に対する順方向電流 $I_f$ の特性（以下、 $V_{AK}-I_f$ 特性という）を示した図である。

[図6] FWDの $V_f-I_f$ 特性を示した図である。

[図7] IGBTとFWDとを1チップに形成した半導体装置の場合において、IGBTをオンしたときの等価回路図である。

[図8] 距離 $W_2$ に対するスナップバック電圧 $V_{SB}$ の関係をSim解析した結果を示す図である。

[図9] 距離 $W_2$ 、距離 $W_1$ に対するスナップバック電圧 $V_{SB}$ の関係をSim解析した結果を示す図である。

[図10] 図1に示す半導体装置の $V_{ce}-I_f$ 特性について電子線照射量を60kGyとして測定した結果を示す図である。

[図11] (a) は、本発明の第2実施形態にかかる半導体装置の上面レイアウト

ト図であり、(b)は、(a)の領域X1Bの部分拡大図である。

[図12] (a)～(c)は、それぞれ、図11(b)に示すX1A-X1A、X1B-X1B、X1C-X1Cに沿う断面図である。

[図13] 第2の領域でのFWD200の幅W4とFWD200がオンし始める電圧VF(スナップバック電圧VSBに相当)との関係を示したグラフである。

[図14] 本発明の第3実施形態にかかる半導体装置の上面レイアウト図である。

[図15] 本発明の第4実施形態にかかる半導体装置の上面レイアウト図である。

[図16] 本発明の第5実施形態にかかる半導体装置の上面レイアウト図である。

[図17] 本発明の第6実施形態にかかる半導体装置の上面レイアウト図である。

[図18] 本発明の第7実施形態にかかる半導体装置の上面レイアウト図である。

[図19] 本発明の第8実施形態にかかる半導体装置の上面レイアウト図である。

[図20] 本発明の第9実施形態にかかる半導体装置の上面レイアウト図である。

[図21] 本発明の第10実施形態にかかる半導体装置の上面レイアウト図である。

[図22] 本発明の第11実施形態にかかる半導体装置の上面レイアウト図である。

[図23] 本発明の第12実施形態にかかる半導体装置の上面レイアウト図である。

[図24] 本発明の第13実施形態にかかる半導体装置の上面レイアウト図である。

[図25] 本発明の第14実施形態にかかる半導体装置の上面レイアウト図である。

[図26] 本発明の第15実施形態にかかる半導体装置の上面レイアウト図である。

[図27] 本発明の第16実施形態にかかる半導体装置の上面レイアウト図である。

[図28] 本発明の第17実施形態にかかる半導体装置の上面レイアウト図である。

[図29] 本発明の第18実施形態にかかる半導体装置の上面レイアウト図である。

[図30] (a) は、本実施形態にかかる半導体装置の上面レイアウト図、(b) は、図30(a)の二点差線で囲んだ領域の部分拡大図である。

[図31] 図30に示す半導体装置の $V_{ce} - I_c$ 特性を調べた図である。

[図32] 距離 $L_c$ とIGBT100のスナップバック電圧 $V_{SB}$ について調べた結果を示すグラフである。

[図33] (a) ~ (c) は、領域3bの他のレイアウトを示した図である。

[図34] n+型不純物領域3を他の構造とする場合の半導体装置のレイアウト図である。

[図35] n+型不純物領域3を他の構造とする場合の半導体装置のレイアウト図である。

[図36] n+型不純物領域3を他の構造とする場合の半導体装置のレイアウト図である。

[図37] (a) は、セル領域における基板裏面側のレイアウトを示した図であり、(b) は、(a)の部分拡大図である。

[図38] 半導体装置が壊れるメカニズムを示した説明図である。

[図39] (a) は、セル領域における基板裏面側のレイアウトを示した図であり、(b) は、(a)の部分拡大図である。

[図40] (a) は、セル領域における基板裏面側のレイアウトを示した図であ

り、(b)は、(a)の部分拡大図である。

[図41]セル領域における基板裏面側のレイアウトを示した図である。

[図42](a)～(c)は、第1の領域のセル構成、第2、第3の領域のセル構成などの一例を示した断面図である。

### 発明を実施するための形態

[0039] 以下、本発明の実施形態について図に基づいて説明する。

(第1実施形態)

本発明の第1実施形態について説明する。図1は、本実施形態にかかる半導体装置の断面図、図2は、図1に示す半導体装置の上面レイアウト図である。図1は、図2のI-Iに沿う断面図に相当している。以下、これらの図を参照して、本実施形態の半導体装置について説明する。

[0040] 図1に示すように、本実施形態の半導体装置は、例えば不純物濃度が $1 \times 10^{13} \sim 1 \times 10^{14} \text{ cm}^{-3}$ とされたn型ドリフト層1を構成する半導体基板に対してIGBT100やFWD200を備えることにより構成されている。図1および図2に示したように、IGBT100が備えられるIGBT形成領域とFWD200が備えられるダイオード形成領域がセル領域とされ、セル領域の外周部に外周領域が備えられている。図2に示されるように、半導体装置を構成するチップの中央部がIGBT形成領域とされ、その周囲を囲むようにダイオード形成領域が配置されることでセル領域が構成され、さらにそのセル領域の外周を囲むように外周領域が配置されている。

[0041] セル領域におけるIGBT形成領域およびダイオード形成領域において、n型ドリフト層1の裏面側における当該n型ドリフト層1の表層部には、FS層1aが形成されている。このFS層1aは、n型ドリフト層1よりも高不純物濃度のn型層にて構成され、空乏層の広がりを防ぐことで耐圧と定常損失の性能向上を図ると共に、基板裏面側から注入されるホールの注入量を制御するために備えてある。

[0042] また、セル領域におけるIGBT形成領域およびダイオード形成領域において、n型ドリフト層1の裏面側におけるFS層1aの表層部には、コレク

タ領域に相当する p+型不純物領域 2 およびカソード領域に相当する n+型不純物領域 3 が形成されている。p+型不純物領域 2 は、ボロン等の p 型不純物が注入されて形成され、例えば不純物濃度が  $1 \times 10^{17} \sim 1 \times 10^{20} \text{ cm}^{-3}$  で構成されている。n+型不純物領域 3 は、リン等の n 型不純物が注入されて形成され、例えば不純物濃度が  $1 \times 10^{19} \sim 1 \times 10^{21} \text{ cm}^{-3}$  で構成されている。n\_型ドリフト層 1 の裏面側は基本的には p+型不純物領域 2 とされているが、部分的に n+型不純物領域 3 が形成された構造とされている。

[0043] 図 2 中の実線ハッチングを示した領域が n+型不純物領域 3 の形成されている領域であり、それ以外の領域が p+型不純物領域 2 の形成されている領域である。図 2 中の破線ハッチングを示した領域は、p 型ディープウェル層 1 3 の形成されている領域である。

[0044] 図 2 に示されるように、n\_型ドリフト層 1 の裏面側は基本的には p+型不純物領域 2 とされているが、部分的に n+型不純物領域 3 が形成された構造とされている。本実施形態の場合、n+型不純物領域 3 は、セル領域において短冊状のものが複数本ストライプ状に配置された構造とされている。なお、n+型不純物領域 3 のうち短冊状の部分のものは、図 2 中では 5 本のものを縦方向に 2 つに分割したものとして描いてあるが、実際にはそれ以上の多数本が形成されている。

[0045] また、セル領域における IGBT 形成領域においては、n\_型ドリフト層 1 の表層部には、所定厚さの p 型ベース領域 4 が形成されている。この p 型ベース領域 4 を貫通して n-型ドリフト層 1 まで達するように複数個のトレンチ 6 が形成されており、このトレンチ 6 によって p 型ベース領域 4 が複数個に分離されている。具体的には、トレンチ 6 は複数個所定のピッチ (間隔) で形成されており、図 1 の奥行き方向 (紙面垂直方向) において各トレンチ 6 が平行に延設されたストライプ構造、もしくは並行に延設されたのちその先端部において引き回されることで環状構造とされている。そして、環状構造とされる場合、各トレンチ 6 が構成する環状構造は複数本ずつを 1 組として多重リング構造が構成され、隣接する多重リング構造同士の長手方向が平行

となるように配置されている。

[0046] 隣接するトレンチ6によってp型ベース領域4が複数に分割された状態となるが、少なくともその一部は、チャンネル領域を構成するチャンネルp層4aとなり、このチャンネルp層4aの表層部に、エミッタ領域に相当するn+型不純物領域5が形成されている。なお、本実施形態では、分割された各p型ベース領域4がチャンネルp層4aとなる場合を図示してあるが、そのうちの一部にn+型不純物領域5を形成しないことで、IGBTとして機能する部分を間引いた構造（以下、間引き構造という）とされても良い。

[0047] n+型不純物領域5は、n-型ドリフト層1よりも高不純物濃度で構成され、p型ベース領域4内において終端しており、かつ、トレンチ6の側面に接するように配置されている。より詳しくは、トレンチ6の長手方向に沿って棒状に延設され、トレンチ6の先端よりも内側で終端した構造とされている。

[0048] 各トレンチ6内は、各トレンチ6の内壁表面を覆うように形成されたゲート絶縁膜7と、このゲート絶縁膜7の表面に形成されたドーブトPoly-Si等により構成されるゲート電極8とにより埋め込まれている。ゲート電極8は、図1とは別断面において互いに電氣的に接続され、同電位のゲート電圧が印加される様になっている。このような構造により、トレンチゲート構造が構成されている。

[0049] さらに、n+型不純物領域5およびチャンネルp層4aは、層間絶縁膜9に形成されたコンタクトホール9aを通じてエミッタ電極に相当する上部電極10と電氣的に接続されており、上部電極10や図示しない配線などを保護するように保護膜11が形成されている。そして、p+型不純物領域2の裏面側に下部電極12が形成されることにより、IGBT100が構成されている。

[0050] 一方、セル領域におけるダイオード形成領域でも、IGBT形成領域と同様に、n<sub>-</sub>型ドリフト層1の表層部に所定厚さのp型ベース領域4が形成されている。さらに、p型ベース領域4の周囲を囲むように、p型ベース領域4

よりも接合深さが深くされた p 型ディープウェル層 13 が形成されている。この P 型ディープウェル層 13 は、p 型ベース領域 4 よりも高不純物濃度で構成され、例えば不純物濃度が  $1 \times 10^{18} \sim 1 \times 10^{19} \text{ cm}^{-3}$  で構成されている。

[0051] このため、ダイオード形成領域に備えられた p 型ベース領域 4 および p 型ディープウェル層 13 をアノードとし、n<sub>-</sub>型ドリフト層 1 および n<sub>+</sub>型不純物領域 3 をカソードとして PN 接合されたダイオード構造を有する FWD 200 が構成されている。この FWD 200 は、p 型ディープウェル層 13 に対して上部電極 10 がアノード電極として電氣的に接続され、n<sub>+</sub>型不純物領域 3 に対して下部電極 12 がカソード電極として電氣的に接続された構造とされている。

[0052] このため、IGBT 100 と FWD 200 とは、エミッタとアノードとカソードと電氣的に接続されると共に、コレクタとカソードとが電氣的に接続されることで、同一チップにおいて互いに並列接続された構造とされている。

[0053] なお、外周領域においては、図示しないが、n<sub>-</sub>型ドリフト層 1 の表層部において、セル領域の外周を囲むように p 型ベース領域 4 よりも深くされた p 型拡散層が形成され、更に p 型拡散層の外周を囲むように p 型ガードリング層が多重リング構造として形成されるなど、外周耐圧構造が構成されている。この外周耐圧構造により、電界が偏り無く広げら得ることで、半導体装置の耐圧向上が図られている。

[0054] 以上のように、本実施形態にかかる IGBT 100 と FWD 200 とを一体化した半導体装置が構成されている。このように構成された半導体装置は、例えば直流-交流変換を行うためのインバータ回路などのスイッチング回路に備えられ、IGBT 100 がスイッチング素子として機能させられると共に、FWD 200 が IGBT 100 をオフしたときに還流電流を流す還流素子として機能させられる。

[0055] このとき、FWD 200 では、ダイオード形成領域に備えられた p 型ベース領域 4 および p 型ディープウェル層 13 がアノードとして機能することで



、ダイオード動作を行う。ところな 深い p 型ディープウェル層 13 がアノードとなるために、p 型ディープウェル層 13 からのホール注入が多くなって FWD 200 の耐量を低下させる可能性がある。

[0056] 一方、図 3 に示す半導体装置の断面図に表されるように、p 型ディープウェル層 13 から n+型不純物領域 3 までの距離が長いと、キャリアのライフタイムでの関係から、セル終端部、つまり p 型ディープウェル層 13 のうちセル領域の外縁近傍からのホールが届かず、実質的にアノードとして機能する領域が減少する。このため、深い p 型ディープウェル層 13 からのホール注入を抑制して FWD 200 の耐量を確保しつつ、実質的にアノードとして機能する領域を大きくできるように、各部の設計を行っている。以下、この設計について説明する。

[0057] 図 4 は、図 1 に示す半導体装置のダイオード動作を行うときの等価回路を模式的に描いた断面図である。また、図 5 は、図 1 に示す半導体装置の VAK - If 特性を示した図である。アノード-カソード間電圧 VAK は、FWD 200 の順方向電圧 Vf と同等であるため、図 5 の特性は、FWD 200 の Vf - If 特性に相当する。

[0058] まず、IGBT 100 と FWD 200 の等価回路は、図 4 中に示したものとなる。すなわち、IGBT 100 のコレクタに対して n-型ドリフト層 1 の横方向の内部抵抗 R1 (抵抗率  $\rho_1$ ) が接続されている。そして、IGBT 100 のエミッターコレクタ間と内部抵抗 R1 が FWD 200 に対して並列接続されていると共に、これら FWD 200 等に対して n-型ドリフト層 1 の縦方向の内部抵抗 R2 (抵抗率  $\rho_1$ ) と、FS 層 1a の横方向の内部抵抗 R3 (抵抗率  $\rho_2$ ) が直列接続されている。また、p 型ディープウェル層 13 の外周側端部を n-型ドリフト層 1 の裏面側に投影した位置から、n+型不純物領域 3 と p+型不純物領域 2 との境界部までの距離を W1 とし、FWD 200 として機能する p 型ベース領域 4 の端部 (p 型ベース領域 4 のうち IGBT 100 と FWD 200 との境界部 (最も外側のトレンチ 5 の側壁)) から p 型ディープウェル層 13 の外周側端部までの距離を W2 とする。p 型ディ

—プウエル層 13 と p 型ベース領域 4 との境界部を裏面側に投影した位置よりカソード領域となる n+型不純物領域 3 とコレクタ領域となる p+型不純物領域 2 との境界部までの距離を  $W_3$  とする。また、n-型ドリフト層 1 の厚みを  $L_1$ 、FS 層 1a の厚みを  $L_2$  とする。

[0059] また、図 5 に示す  $V_{AK}-I_f$  特性より、スナップバック電圧が最も大きくなる時のアノード-カソード間電圧  $V_{AK}$  を  $V_{AK1}$  とし、 $FW D 200$  がダイオード動作し始めるときのアノード-カソード間電圧  $V_{AK}$  を  $V_{AK2}$  とする。また、 $V_{AK}-I_f$  特性が線形となるところから直線を引いたときの切片が P 型ディープウエル層 13 と n\_型ドリフト層 1 との間のビルトインポテンシャル、つまり理論上ダイオード動作するのに必要な電圧であり、このビルトインポテンシャルを  $V_{AK}(th)$  とする。

[0060] これらに基づき、以下の関係式が成り立つ。まず、数式 1 に示すように、スナップバック電圧  $V_{SB}$  は、 $V_{AK1}$  と  $V_{AK2}$  の差として表される。

[0061] (数 1)  $V_{SB} = V_{AK1} - V_{AK2}$

また、スナップバック電圧  $V_{SB}$  が最も大きくなる時の  $V_{AK1}$  は、 $FW D 200$  がダイオード動作を行っていることが必要であることから、図 4 中の点 X の電位に基づいて、次式を導くことができる。なお、下記の式で、 $I$  は、 $I_{GBT100}$  から n\_型ドリフト層 1 の内部抵抗  $R_1$ 、 $R_2$  および FS 層 1a の内部抵抗  $R_3$  を通って流れる電流を意味している。また、下記の式では、 $I_{GBT100}$  のチャンネル抵抗に関しては、非常に小さいことから無視している。

[0062] (数 2)  $V_{th} = I \cdot R_1$

(数 3)  $I = V_{AK1} - (R_1 / (R_1 + R_2 + R_3))$

(数 4)  $V_{AK1} = V_{AK}(th) \times ((R_1 + R_2 + R_3) / R_1)$

また、p 型ディープウエル層 13 と n\_型ドリフト層 1 との間のビルトインポテンシャル  $V_{AK}(th)$  は、 $FW D 200$  がダイオード動作し始めた電圧  $V_{AK2}$  とほぼ等しいため、次式で表せる。

[0063] (数 5)  $V_{AK2} \doteq V_{AK}(th)$

この数式5 および上記した数式4 を上記数式1 に代入すると、次式を導出することができる。

[0064] (数6)  $V_{SB} \doteq ( (R_2 + R_3) / R_1 ) \times V_{AK} (t_h)$

そして、 $R_1 \sim R_3$  は、それぞれ  $R_1 = W_2 \cdot \rho_1 / L_1$ 、 $R_2 = \rho_1 \cdot L_1 / W_2$ 、 $R_3 = W_1 \cdot \rho_2 / L_2$  で表されることから、数式6 を次式に変換できる。

[0065] (数7)

$$V_{SB} \doteq ( (L_1 - \rho_1 / W_2 + W_1 - \rho_2 / L_2) / (W_2 - \rho_1 / L_1) ) \times V_{AK} (t_h)$$

ここで、 $V_{SB} / V_{AK} (t_h)$  に対して IGBT100 および FWD200 の形状や濃度等、IGBT100 および FWD200 の構造に基づいて決まる第1パラメータを  $k_1$  とし、ビルトインポテンシャル  $V_{AK} (t_h)$  に対するスナップバック電圧  $V_{SB}$  の比である  $V_{SB} / V_{AK} (t_h)$  に対して第1パラメータを掛けた値 ( $= k_1 \cdot V_{SB} / V_{AK} (t_h)$ ) をベとする。また、ビルトインポテンシャルを表す  $V_{AK} (t_h)$  は定数であり、スナップバック電圧  $V_{SB}$  が小さいほど非線形性が小さくなって線形性が改善されることから、 $k$  が小さくなるほど線形性を改善できる。したがって、次式で表される右辺がその  $k$  以下となるようにすることで、線形性の改善を図ることができる。

[0066] (数8)  $K \geq ( (L_1 \cdot \rho_1 / W_2 + W_1 - \rho_2 / L_2) / (W_2 - \rho_1 / L_1) )$

また、 $p$  型ディープウェル層13の外周端部がゲートのバイアスによって影響を受けないダイオードとして動作させるための  $W_2$  の条件は、上記数式8に基づいて下記数式9 および数式10のように求めることができる。なお、 $n$ \_型ドリフト層1の抵抗率  $\rho_1$  に対してFS層1aの抵抗率  $\rho_2$  は十分に小さいことから、 $W_1 \cdot \rho_2 / L_2 \doteq 0$  と見なしている。

[0067] (数9)  $K \geq ( (L_1 \cdot \rho_1 / W_2) / (W_2 - \rho_1 / L_1) ) = L_1^2 / W_2^2$

$$(数 10) \quad W_2 \geq L_1 / K^{1/2}$$

また外周端部におけるスナップバック電圧を $-40^\circ\text{C}$ における $V_{AK}(th) = 0.8$  [V] に対して無視できる $0.1$  V以下にする場合は、実験結果を示した図8より $K \geq 2.5$ となる。すなわち、図8中に示しように、 $L_1 = 135 \mu\text{m}$ とした場合には、 $W_2 = 85 \mu\text{m}$ のときにスナップバック電圧が $0.1$  Vとなることから、数式9に $L_1 = 135 \mu\text{m}$ 、 $W_2 = 85 \mu\text{m}$ を代入すると、 $K \geq 2.5$ となる。同様に、 $L_1 = 80 \mu\text{m}$ とした場合には、 $W_2 = 50 \mu\text{m}$ のときにスナップバック電圧が $0.1$  Vとなることから、数式9に $L_1 = 80 \mu\text{m}$ 、 $W_2 = 50 \mu\text{m}$ を代入すると、 $K \geq 2.56$ となる。このように、いずれの結果からも $K \geq 2.5$ を満たすようにすることで、スナップバック電圧を $0.1$  V以下に抑えることが可能となることが判る。なお、図8に示すsim解析では、 $W_1 = 0 \mu\text{m}$ 、 $L_2 > 0$ 、 $W_3$ は任意の値に設定している。

[0068] また $W_2$ が数式10を満たしている場合であっても、 $W_1$ が大きい場合やライフタイムが短い場合は、ディープウェル層13の外周端部から注入されたホールがカソードとなる $n+$ 型不純物領域3まで届かなくなるため、実効的な $W_2$ が短く( $R_1$ が小さく)なりスナップバックが出現する。このため、ライフタイムを例えば2 psとした場合において、 $W_1$ 、 $W_2$ とスナップバック電圧 $V_{SB}$ との関係について調べた。そのsim結果を図9に示す。また、図10は、本実施形態にかかる半導体装置の $V_{ce}-I_f$ 特性について電子線照射量を $60 \text{ kGy}$ として測定した結果を示した図である。この図において $V_{ce}$ が部分的にマイナス方向に突出したものがスナップバック電圧 $V_{SB}$ であり、この図のスナップバック電圧 $V_{SB}$ を取り出してプロットしたのが図9に相当する。

[0069] スナップバック電圧 $V_{SB}$ が $-40^\circ\text{C}$ の $V_{AK}(th) = 0.8$  Vに対して無視できる $0.1$  V以下に抑制できるようにするためには、図9より、次式が成り立つ。なお、図9に示す実験では、 $L_1 = 125 \mu\text{m}$ 、 $W_2 = 85 \mu\text{m}$ 、 $L_2 = 1 \mu\text{m}$ 、 $W_3$ は任意の値としている。

[0070] (数 1 1)  $W_2 - W_1 \geq 10 \mu m$

一方、距離  $W_3$  については、図 3 に示すように、ホールが p 型ディープウェル層 13 から斜め方向に最短距離で p+型不純物領域 2 と n+型不純物領域 3 との境界位置に向かってホールが注入された時、注入量が大きくなり破壊しないためには、拡散長よりも上で述べた最短距離が十分大きいことが必要となることから、図 3 中に示した三角形の関係で示される三平方の定理より、数式 1 2 が成り立つ。そして、これを変換すると数式 1 3 を導出できる。なお、 $D$  は、n\_型ドリフト層 1 内でのキャリアの拡散係数であり、 $k_2$  は、P 型ディープウェル層 13 の深さ、濃度、耐量等の p 型ディープウェル層 13 の構造に基づいて決まる第 2 パラメータである。

[0071] (数 1 2)  $W_3^2 + L_1^2 \geq k_2 \cdot D \tau^{1/2}$

(数 1 3)  $W_3 \geq \left( (k_2 \cdot (D \tau)^{1/2})^2 - L_1^2 \right)^{1/2}$

そして、距離  $W_1 \sim W_3$  については、半導体装置の小型化などを考慮すると、上記数式を満たす中で最も小さい値であることが好ましいため、また  $W_1 - W_3$  は耐圧の観点から大きな値となることが望ましいため次式が成り立つ関係とするのが良い。

[0072] (数 1 4)

$$W_2 = L_1 / K^{1/2}$$

かつ

$$W_2 - W_1 = 10 \text{ が } m$$

かつ

$$W_3 = \left( (K_2 - (D T)^{1/2})^2 - L_1^2 \right)^{1/2}$$

よって、本実施形態の半導体装置では、距離  $W_1$ 、 $W_2$ 、 $W_3$  が数式 1 4 を満たす値に設定している。

[0073] 以上説明したように、本実施形態の半導体装置では、IGBT 100 と FWD 200 を備えた構造において、ダイオード形成領域に備えられた p 型ベース領域 4 および p 型ディープウェル層 13 をアノードとして機能させることで、ダイオード動作を行わせている。

[0074] そして、p型ディープウエル層13の外周側端部をn-型ドリフト層1の裏面側に投影した位置より、n+型不純物領域3とp+型不純物領域2との境界部までの距離 $W_1$ と $FW D 2 0 0$ として機能するp型ベース領域4の端部からP型ディープウエル層13の外周側端部までの距離 $W_3$ が数式14を満たす値となるようにしている。

[0075] これにより、深いp型ディープウエル層13がアノードとなるときに、p型ディープウエル層13からのホール注入が多くなることで $FW D 2 0 0$ の耐量が低下してしまうことを抑制しつつ、p型ディープウエル層13のうちセル領域の外縁近傍からのホールが届かせ、実質的にアノードとして機能する領域が減少することを抑制することができる。

(第2実施形態)

本発明の第2実施形態について説明する。本実施形態は、第1実施形態に対して異なる場所でも $FW D$ の $V_f - I_f$ 特性の線形性を改善できる構成を採用したものであり、その他に関しては第1実施形態と同様であるため、第1実施形態と異なる部分についてのみ説明する。

[0076] 図11(a)は、本実施形態にかかる半導体装置の上面レイアウト図であり、図11(b)は、図11(a)の領域X1Bの部分拡大図である。なお、図11(a)、(b)は断面図ではないが、図を見易くするために部分的にハッチングを示してある。また、図12(a)～(c)は、それぞれ、図11(b)に示すX1A-X1A、X1B-X1B、X1C-X1Cに沿う断面図である。ただし、図12(c)については、より各領域の断面構造が明確になるように、図11(b)のX1C-X1Cに沿う断面を更に延長して多くのセル分備えた図としてある。なお、本実施形態の半導体装置では、p型チャネル領域4aの表層部にコンタクト領域4bを形成した構造としてあり、このコンタクト領域4bを介して上部電極10と電氣的に接続されるようにしてあるが、基本的な構造は第1実施形態と同様である。

[0077] 図11(a)、(b)に示すように、本実施形態の半導体装置は、外周領域内に第1～第3の領域を備えた構成とされている。具体的には、トレンチ

6の側面においてエミッタ領域に相当するn+型不純物領域5が形成されていてIGBT100として機能する部分が含まれる領域を第1の領域、この第1の領域に併設されたエミッタ領域に相当するn+型不純物領域5が形成されておらずFWD200として機能させる部分が含まれる領域を第2の領域、トレンチゲート構造の長手方向の先端位置においてp+型不純物領域2が形成されている領域のうちp型ガードリング層14などが形成された外周領域よりも内側(つまりセル領域の外縁部におけるFWD200が形成されている領域)を第3の領域としている。

[0078] このようなゲート電極8の先端位置においても、「W0200のソ干\_1f特性の線形性の問題が発生する。このため、第3の領域に備えられるp型ベース領域4とp型ディープウエル層13とによって構成されるFWD200について、第1実施形態と同様に、各種寸法について規定している。

[0079] 具体的には、本実施形態でも、図12(a)、(b)中に示したように、P型ディープウエル層13の外周側端部をn-型ドリフト層1の裏面側に投影した位置から、n+型不純物領域3とp+型不純物領域2との境界部までの距離をW1とし、FWD200として機能するp型ベース領域4の端部(p型ベース領域4のうちIGBT100とFWD200との境界部(エミッタ領域に相当するn+型不純物領域5の先端位置))からp型ディープウエル層13の外周側端部までの距離をW2とする。p型ディープウエル層13とp型ベース領域4との境界部を裏面側に投影した位置よりカリート領域となるn+型不純物領域3とコレクタ領域となるp+型不純物領域2との境界部までの距離をW3とする。また、n-型ドリフト層1の厚みをL1とする。

[0080] このように構成された半導体装置におけるトレンチゲート構造の先端位置においても、p型ベース領域4とp型ディープウエル層13を長くして内部抵抗を大きくしたいが、これらが長くなり過ぎるとp型ディープウエル層13のうちのセル領域の終端からn+型不純物領域3までホールが届かなくなる。このため、W1~W3が上記第1実施形態で示した数式10、11、13、好ましくは数式14の関係を満たすようにすることで、FWD200のV

$f - I_f$  特性の線形性を改善することが可能となる。

[0081] また、図 12 (c) に示すように、第 1、第 2 の領域において、エミッタ領域に相当する  $n$ +型不純物領域 5 を形成しない間引き構造としている。このような間引き構造とすることで、その間引き部分にてダイオード動作させ、隣り合うトレンチゲート構造の間に FWD 200 が構成されるようにしている。

[0082] この間引き構造のうち、第 2 の領域に構成される部分の少なくとも一部について、 $n$ +型不純物領域 5 が形成されておらず  $p$  型ベース領域 4 のみが形成されている箇所の最も端から端のトレンチゲート構造の間の距離を第 2 の領域での FWD 200 の幅  $W_4$  とすると、 $W_4 \geq 20 \mu m$  となるようにしている。図 13 は、第 2 の領域での FWD 200 の幅  $W_4$  と FWD 200 がオンし始める電圧  $V_f$  (スナップバック電圧  $V_{SB}$  に相当) との関係を示したグラフである。この図に示されるように、第 2 の領域での FWD 200 の幅  $W_4$  が  $20 \mu m$  を超えると FWD 200 がオンし始める電圧  $V_f$  が急に上昇し始める。この結果に基づき、第 2 の領域での FWD 200 の幅  $W_4$  が  $20 \mu m$  以上となるようにしている。これにより、FWD 200 のオン電圧を低減することが可能になる。ただし FWD のリカバリー (SW) 損失を低減することを目的に SW 動作の直前又は動作中にゲートに電圧を印加するような制御を行う場合、この  $W_4 < 20 \mu m$  した方が SW 損失を低減できる場合もある。この場合も  $W_1 \sim W_3$  を本特許の条件を満たすことにより FWD の線形性の向上やスナップバックによる  $V_f$  の急激な上昇を抑制することができる。

[0083] 以上説明したように、トレンチゲート構造の先端位置においても、 $W_1 \sim W_3$  が上記第 1 実施形態で示した数式 10、11、13、好ましくは数式 14 の関係を満たすようにすることで、FWD 200 の  $V_f - I_f$  特性の線形性を改善することが可能となる。またこの構成で第 3 の領域と第 2 の領域の距離を縮めることにより第 3 の領域が ON することにより上がった電流密度を第 2 の領域に効率的に伝えられるため線形性がより向上される。さらに、



第2の領域でのFWD200の幅 $W_4$ が $2\phi_0$ 以上となるようにすることで、FWD200のオン電圧を低減することが可能になる。

(第3実施形態)

本発明の第3実施形態について説明する。本実施形態は、第2実施形態に対して異なる場所でもFWDの $V_f - I_f$ 特性の線形性を改善しつつ、IGBTのオン損失を低減できる構成を採用したものであり、その他に関しては第2実施形態と同様であるため、第2実施形態と異なる部分についてのみ説明する。

[0084] 図14は、本実施形態にかかる半導体装置の上面レイアウト図である。なお、図14は断面図ではないが、図を見易くするために部分的にハッチングを示してある。この図に示すように、第1の領域を長手方向において2つに分割、つまりエミッタ領域に相当する $n+$ 型不純物領域5を長手方向において2つに分割しており、分割した第1の領域の間において $n+$ 型不純物領域5が形成されておらず、隣接するトレンチゲート構造の間の領域に $p$ 型ベース領域4のみが形成されることでFWD200が形成されるようにしている。

[0085] このように、第1の領域を長手方向において2つに分割し、分割した第1の領域の間においてFWD200が構成されるようにしても良い。このようにすれば、エミッタ領域に相当する $n+$ 型不純物領域5の近くにダイオード動作する第2の領域を形成できる。これによりFWD200の面積が増えることやこの領域が第3の領域の補助的な役割することでより効率的にFWD200の電流密度を向上できることで半導体装置全体のスナップ/クック電圧を低減することが可能になる。

[0086] なお、このように第1の領域を長手方向において分割する場合、その第1の領域の間の幅 $W$ を数式10の $W_2$ の2倍以上に取ることにより、この領域をトレンチゲート構造の両先端位置に配置される第3の領域の代わりとすることもできる。また、ここでは第1の領域を長手方向において2つに分割する場合について説明したが、複数、つまり2つに限らず3つ以上の数に分割しても構わない。

(第4実施形態)

本発明の第4実施形態について説明する。本実施形態は、第2実施形態に対して第1の領域と第2の領域のレイアウトを変更したものであり、その他に関しては第2実施形態と同様であるため、第2実施形態と異なる部分についてのみ説明する。

[0087] 図15は、本実施形態にかかる半導体装置の上面レイアウト図である。なお、図14は断面図ではないが、図を見易くするために部分的にハッチングを示してある。この図に示すように、複数本並べられた第1の領域の一部、具体的には隣り合う第1の領域の対向する辺の一部を凹ませた図中破線で囲んだ部分をエミッタ領域に相当するn+型不純物領域5が備えられていない領域とし、本実施形態では、この領域を第2の領域とした構成としている。つまり、本実施形態では、上記第2実施形態のように各第1の領域や各第2の領域がそれぞれ同じ幅で構成されているのではなく、第1の領域の間において部分的に第2の領域の幅を広げた構造にしている。

[0088] このように、一部の第2の領域の幅 $W_4$ を広げることにより、第2の領域に構成されるFWD200がダイオード動作し易くなる。これにより、FWD200の面積が増えることやこの領域が第3の領域の補助的な役割することでより効率的にFWD200の電流密度を向上できることで半導体装置全体のスナップバック電圧を小さくすることが可能になる。

(第5実施形態)

本発明の第5実施形態について説明する。本実施形態も、第2実施形態に対して第1の領域と第2の領域のレイアウトを変更したものであり、その他に関しては第2実施形態と同様であるため、第2実施形態と異なる部分についてのみ説明する。

[0089] 図16は、本実施形態にかかる半導体装置の上面レイアウト図である。なお、図16は断面図ではないが、図を見易くするために部分的にハッチングを示してある。この図に示すように、第1の領域を紙面上下方向、つまりトレンチゲート構造の長手方向において複数個に分割し、分割した第1の領域

の間に第 1 の領域とほぼ同寸法の第 2 の領域が配置されるようにすることで各第 1 の領域がマトリクス状に配置された構造にしている。つまり、トレンチゲート構造の長手方向に並べ第 1 の領域を 1 つの列として、第 1 の領域の列が複数列並べて配置され、隣り合う各列の第 1 の領域が対向配置される構造とされている。このような構造としても、分割された各第 1 の領域の間の第 2 の領域に構成される F W D 2 0 0 がダイオード動作し易くなる。これにより、F W D 2 0 0 の面積が増えることやこの領域が第 3 の領域の補助的な役割することでより効率的に F W D 2 0 0 の電流密度を向上できることで半導体装置全体のスナップ/クック電圧を小さくすることが可能になる。

(第 6 実施形態)

本発明の第 6 実施形態について説明する。本実施形態は、第 5 実施形態に対して第 1 の領域と第 2 の領域のレイアウトを変更したものであり、その他に関しては第 5 実施形態と同様であるため、第 5 実施形態と異なる部分についてのみ説明する。

[0090] 図 17 は、本実施形態にかかる半導体装置の上面レイアウト図である。なお、図 17 は断面図ではないが、図を見易くするために部分的にハッチングを示してある。この図に示すように、本実施形態でも、第 1 の領域を紙面上下方向、つまりトレンチゲート構造の長手方向において複数個に分割し、分割した第 1 の領域の間に第 1 の領域とほぼ同寸法の第 2 の領域が配置されるようにしているが、トレンチゲート構造の長手方向に並べ第 1 の領域を 1 つの列として、第 1 の領域の列が複数列並べて配置されているものの、隣り合う各列の第 1 の領域が互いにずれて配置される構造とされている。つまり、各第 1 の領域が千鳥状に配置された構造とされている。このような構造としても、分割された各第 1 の領域の間の第 2 の領域に構成される F W D 2 0 0 がダイオード動作し易くなる。これにより、F W D 2 0 0 の面積が増えることやこの領域が第 3 の領域の補助的な役割することでより効率的に F W D 2 0 0 の電流密度を向上できることで半導体装置全体のスナップ/クック電圧を小さくすることが可能になる。

(第7実施形態)

本発明の第7実施形態について説明する。本実施形態は、第6実施形態に対して第1の領域と第2の領域のレイアウトを変更したものであり、その他に関しては第6実施形態と同様であるため、第6実施形態と異なる部分についてのみ説明する。

[0091] 図18は、本実施形態にかかる半導体装置の上面レイアウト図である。なお、図18は断面図ではないが、図を見易くするために部分的にハッチングを示してある。この図に示すように、本実施形態でも、第1の領域を紙面上下方向、つまりトレンチゲート構造の長手方向において複数個に分割しているが、第6実施形態と比べて分割場所の間隔を長くした構造としている。このような構造としても、分割された各第1の領域の間の第2の領域に構成されるFWD200がダイオード動作し易くなる。これにより、FWD200の面積が増えることやこの領域が第3の領域の補助的な役割することでより効率的にFWD200の電流密度を向上できることで半導体装置全体のスナップ/クック電圧を小さくすることが可能になる。

(第8実施形態)

本発明の第8実施形態について説明する。本実施形態は、第4実施形態に対して第1の領域と第2の領域のレイアウトを変更したものであり、その他に関しては第4実施形態と同様であるため、第4実施形態と異なる部分についてのみ説明する。

[0092] 図19は、本実施形態にかかる半導体装置の上面レイアウト図である。なお、図19は断面図ではないが、図を見易くするために部分的にハッチングを示してある。この図に示すように、本実施形態でも、隣り合う第1の領域の対向する辺の一部を凹ませて第2の領域としているが、第4実施形態のように隣り合う第1の領域の対向する辺の同じ場所に第2の領域を配置するのではなく、互い違いに第2の領域を配置した構造としている。このような構造としても、第2の領域に構成されるFWD200がダイオード動作し易くなり、FWD200の面積が増えることやこの領域が第3の領域の補助的な

役割することでより効率的に FWD200 の電流密度を向上できることで半導体装置全体のスナップバック電圧を小さくすることが可能になる。

(第9実施形態)

本発明の第9実施形態について説明する。本実施形態は、第2実施形態に対して第1～第3の領域のレイアウトを変更したものであり、その他に関しては第2実施形態と同様であるため、第2実施形態と異なる部分についてのみ説明する。

[0093] 図20は、本実施形態にかかる半導体装置の上面レイアウト図である。なお、図20は断面図ではないが、図を見易くするために部分的にハッチングを示してある。この図に示すように、本実施形態では、第3の領域をセル領域の外縁部に配置するのではなく、セル領域の中央位置に点在させるように配置し、かつ、第2の領域が第3の領域の間を繋ぐように配置された構造となるようにしている。

[0094] 具体的には、円形状に囲まれた範囲を第3の領域として、第3の領域が正六角形の各角部に配置された形状、つまりハニカム状に配置されたレイアウトとされ、各第3の領域を繋ぐ六角形の各辺に相当する位置に第2の領域が配置されたレイアウトとされている。図中破線はトレンチゲート構造を示しているが、紙面上下方向を長手方向として複数本のトレンチゲート構造が配置されており、その複数本のトレンチゲート構造が交差するように第1～第3の領域がレイアウトされることになる。このトレンチゲート構造のトレンチ6の側面のうち第1の領域と接している場所にはエミッタ領域に相当するn+型不純物領域5が備えられ、第2の領域や第3の領域と接している場所にはエミッタ領域に相当するn+型不純物領域5が備えられていない構造となるようにしている。

[0095] このように、第1～第3の領域のレイアウトを変更しても、第2実施形態と同様の効果を得ることができる。また第3の領域同士の距離が短くなるため効率よく第2の領域の電流密度を向上でき、これにより半導体装置全体のスナップバック電圧をより小さくすることが可能になる。

(第10実施形態)

本発明の第10実施形態について説明する。本実施形態は、第9実施形態に対して第1～第3の領域のレイアウトを変更したものであり、その他に関しては第9実施形態と同様であるため、第9実施形態と異なる部分についてのみ説明する。

[0096] 図21は、本実施形態にかかる半導体装置の上面レイアウト図である。なお、図21は断面図ではないが、図を見易くするために部分的にハッチングを示してある。この図に示すように、本実施形態でも、セル領域の外縁部に配置するのではなく、セル領域の中央位置に点在させるように配置し、かつ、第2の領域が第3の領域の間を繋ぐように配置された構造となるようにしている。そして、円形状に囲まれた範囲を第3の領域として、第3の領域が正方形の各角部に配置された形状、つまりマトリクス状に配置されたレイアウトとされ、各第3の領域を繋ぐ正方形の各辺に相当する位置に第2の領域が配置されたレイアウトとされている。

[0097] このように、第1～第3の領域のレイアウトを変更しても、第9実施形態と同様の効果を得ることができる。

(第11実施形態)

本発明の第11実施形態について説明する。本実施形態も、第9実施形態に対して第1～第3の領域のレイアウトを変更したものであり、その他に関しては第9実施形態と同様であるため、第9実施形態と異なる部分についてのみ説明する。

[0098] 図22は、本実施形態にかかる半導体装置の上面レイアウト図である。なお、図22は断面図ではないが、図を見易くするために部分的にハッチングを示してある。この図に示すように、本実施形態でも、セル領域の外縁部に配置するのではなく、セル領域の中央位置に点在させるように配置し、かつ、第2の領域が第3の領域の間を繋ぐように配置された構造となるようにしている。そして、円形状に囲まれる範囲を第3の領域として、第3の領域が正三角形の各角部に配置されたレイアウトとされ、各第3の領域を繋ぐ正三

角形の各辺に相当する位置に第 2 の領域が配置されたレイアウトとされている。

[0099] このように、第 1～第 3 の領域のレイアウトを変更しても、第 9 実施形態と同様の効果を得ることができる。

(第 12 実施形態)

本発明の第 12 実施形態について説明する。本実施形態は、第 2 実施形態に対して半導体装置の基板裏面側のレイアウトについても考慮したものであり、その他に関しては第 2 実施形態と同様であるため、第 2 実施形態と異なる部分についてのみ説明する。

[0100] 図 23 は、本実施形態にかかる半導体装置の上面レイアウト図である。なお、図 23 は断面図ではないが、図を見易くするために部分的にハッチングを示してある。この図に示すように、本実施形態では、第 2 実施形態のような第 1～第 3 の領域を備えた構造について、第 1 の領域の長手方向先端部よりもカソード領域に相当する n+型不純物領域 3 (図中一点鎖線で囲んだ領域) が図中矢印 A1 のように突き出すように形成されている。このような構造の場合、IGBT100 におけるスナップバック電圧  $V_{SB}$  が大きくなることが懸念されることから、本実施形態では、n+型不純物領域 3 を長手方向において図中矢印 A2 のように分割し、分割した n+型不純物領域 3 の間にコレクタ領域に相当する p+型不純物領域 2 が形成されることで IGBT100 が形成されるようにしている。

[0101] このような構成とすれば、分割した n+型不純物領域 3 の間の p+型不純物領域 2 によって構成される IGBT100 を IGBT 動作させることで電流を流し、電流密度を高くすることで他の部分の IGBT100 についても IGBT 動作させるようにする。これにより、IGBT100 のスナップバック電圧  $V_{SB}$  を低減することが可能となる。

[0102] したがって、FWD200 の面積を増やすことによるスナップバック電圧  $V_{SB}$  の低減と、IGBT100 を動作させやすくすることによるスナップバック電圧  $V_{SB}$  の低減の両立を図ることが可能となる。

[01 03] なお、このように  $n+$ 型不純物領域 3 を長手方向において分割する場合において、本実施形態では  $n+$ 型不純物領域 3 を 2 つに分割する場合について説明したが、複数、つまり 2 つに限らず 3 つ以上の数に分割しても構わない。

(第 1 3 実施形態)

本発明の第 1 3 実施形態について説明する。本実施形態は、第 1 2 実施形態に対して半導体装置の基板裏面側のレイアウトについても考慮したものであり、その他に関しては第 1 2 実施形態と同様であるため、第 1 2 実施形態と異なる部分についてのみ説明する。

[01 04] 図 2 4 は、本実施形態にかかる半導体装置の上面レイアウト図である。なお、図 2 4 は断面図ではないが、図を見易くするために部分的にハッチングを示してある。この図に示すように、本実施形態では、第 3 実施形態のように第 1 の領域を長手方向において 2 つに分割した構造について、第 1 の領域の長手方向先端部がカソード領域に相当する  $n+$ 型不純物領域 3 ( 図中一点差線で囲んだ領域 ) よりも図中矢印 B 1 のように突き出すように形成されている。このような構造の場合、 $n+$ 型不純物領域 3 の中央部においてスナップバック電圧  $V_{SB}$  が大きくなることが懸念されるが、第 1 の領域が  $n+$ 型不純物領域 3 の先端よりも突き出すように配置されることで、この領域で IGBT 100 が形成されるようにできる。このため、この領域の IGBT 100 を IGBT 動作させることで電流を流し、電流密度を高くすることで他の部分の IGBT 100 についても IGBT 動作させるようにできる。これにより、IGBT 100 のスナップバック電圧  $V_{SB}$  を低減することが可能となる。

[01 05] このような構造としても、FWD 200 の面積を増やすことによるスナップバック電圧  $V_{SB}$  の低減と、IGBT 100 を動作させやすくすることによるスナップバック電圧  $V_{SB}$  の低減の両立を図ることが可能となる。つまり、第 1 2 実施形態のような図中矢印 A 1 のように  $n+$ 型不純物領域 3 が第 1 の領域よりも突き出す場合には、図中矢印 A 2 のように  $n+$ 型不純物領域 3 を分割することで IGBT 100 となる領域を補填し、IGBT 100 のスナ



ツップバック電圧  $V_{SB}$  を低減する。逆に、第 13 実施形態のような図中矢印 B1 のように n+型不純物領域 3 よりも第 1 の領域が突き出していて IGBT 100 となる領域が存在する場合には、図中矢印 B2 のように第 1 の領域を分割することでこの領域に第 3 の領域を作成し、FWD200 のスナップバック電圧  $V_{SB}$  を低減できる。この時 B2 の距離は数式 10 の  $W_2$  の 2 倍以上の距離をとると望ましい。

(第 14 実施形態)

本発明の第 14 実施形態について説明する。本実施形態は、第 13 実施形態に対して半導体装置の基板裏面側のレイアウトについても考慮したものであり、その他に関しては第 13 実施形態と同様であるため、第 13 実施形態と異なる部分についてのみ説明する。

[01 06] 図 25 は、本実施形態にかかる半導体装置の上面レイアウト図である。なお、図 25 は断面図ではないが、図を見易くするために部分的にハッチングを示してある。この図に示すように、本実施形態では、第 13 実施形態のように第 1 の領域を分割してその間に広い第 2 の領域を配置した構造にしつつ、さらに第 1 の領域を長手方向において複数箇所分割した構造としている。そして、複数箇所分割された第 1 の領域の間の図中破線で囲んだ部分をエミッタ領域に相当する n+型不純物領域 5 が備えられていない領域とし、本実施形態では、この領域を第 2 の領域とした構成としている。さらに、n+型不純物領域 3 (図中一点鎖線で囲んだ領域) が分割された第 1 の領域の間の第 2 の領域と対応する部分において、他の部分よりも幅広とされている。

[01 07] このような構成によれば、分割された第 1 の領域の間においてダイオード動作させられる FWD200 の面積を増やすことやこの領域が第 3 の領域の補助的な役割することでより効率的に FWD200 の電流密度を向上できることができ、より FWD200 のスナップバック電圧  $V_{SB}$  を低減できる。

(第 15 実施形態)

本発明の第 15 実施形態について説明する。本実施形態は、第 4 実施形態に対して半導体装置の基板裏面側のレイアウトについても考慮したものであ

り、その他に関しては第4実施形態と同様であるため、第4実施形態と異なる部分についてのみ説明する。

[0108] 図26は、本実施形態にかかる半導体装置の上面レイアウト図である。なお、図26は断面図ではないが、図を見易くするために部分的にハッチングを示してある。この図に示すように、本実施形態でも、第1の領域の一部を凹ませた図中破線で囲んだ部分をエミッタ領域に相当するn+型不純物領域5が備えられていない領域とし、この領域を第2の領域とすることで第2の領域の幅を広げた構成としているが、この第2の領域の幅に合わせてn+型不純物領域3を配置している。

[0109] このような構成によれば、幅広とされた第2の領域とn+型不純物領域3とが対向したレイアウトとなり、この領域が第3の領域の補助的な役割することでより効率的にFWD200の全体の電流密度を向上しよりFWD200のスナップバック電圧VSBを低減できる。したがって、第12実施形態と同様の効果を得ることができる。

(第16実施形態)

本発明の第16実施形態について説明する。本実施形態は、第9実施形態に対して半導体装置の基板裏面側のレイアウトについても考慮したものであり、その他に関しては第9実施形態と同様であるため、第9実施形態と異なる部分についてのみ説明する。

[0110] 図27は、本実施形態にかかる半導体装置の上面レイアウト図である。なお、図27は断面図ではないが、図を見易くするために部分的にハッチングを示してある。この図に示すように、本実施形態でも、円形状に囲まれた範囲を第3の領域として、第3の領域が正六角形の各角部に配置された形状、つまりハニカム状に配置されたレイアウトとされ、各第3の領域を繋ぐ六角形の各辺に相当する位置に第2の領域が配置されたレイアウトとされている。そして、これに対応して、各第3の領域が構成する六角形の中心点および各中心を繋ぐ直線部分にコレクタ領域に相当するp+型不純物領域2を配置することで、p+型不純物領域2が複数の正三角形形状に配置されるようにし、そ

の正三角形の線内にカソード領域に相当するn+型不純物領域3を配置した構造としている。

[0111] このように、第1～第3の領域、つまり基板表面側においてIGBT100として機能する部分やFWD200として機能する部分のレイアウトと、基板裏面側においてIGBT100のコレクタ領域となるp+型不純物領域2やFWD200のカソード領域となるn+型不純物領域3のレイアウトを合せている。これにより、それぞれの第3の領域同士の距離が近くなるため効率的にIGBT動作やダイオード動作を行わせられるため、よりFWD200のスナップバック電圧VSBを低減できる。したがって、第12実施形態と同様の効果を得ることができる。

(第17実施形態)

本発明の第17実施形態について説明する。本実施形態は、第10実施形態に対して半導体装置の基板裏面側のレイアウトについても考慮したものであり、その他に関しては第10実施形態と同様であるため、第10実施形態と異なる部分についてのみ説明する。

[0112] 図28は、本実施形態にかかる半導体装置の上面レイアウト図である。なお、図27は断面図ではないが、図を見易くするために部分的にハッチングを示してある。この図に示すように、本実施形態でも、円形状に囲まれる範囲を第3の領域として、第3の領域が正方形の各角部に配置された形状、つまりマトリクス状に配置されたレイアウトとされ、各第3の領域を繋ぐ正方形の各辺に相当する位置に第2の領域が配置されたレイアウトとされている。そして、これに対応して、各第3の領域が構成する正方形の中心点および各中心を繋ぐ直線部分にコレクタ領域に相当するp+型不純物領域2を配置することで、p+型不純物領域2が複数の正方形に配置されるようにし、その正方形の線内にカソード領域に相当するn+型不純物領域3を配置した構造としている。

[0113] このように、第1～第3の領域、つまり基板表面側においてIGBT100として機能する部分やFWD200として機能する部分のレイアウトと、

基板裏面側において IGBT 100 のコレクタ領域となる p+型不純物領域 2 や FWD 200 のカソード領域となる n+型不純物領域 3 のレイアウトを合せている。これにより、第 16 実施形態と同様の効果が得られる。

(第 18 実施形態)

本発明の第 18 実施形態について説明する。本実施形態は、第 11 実施形態に対して半導体装置の基板裏面側のレイアウトについても考慮したものであり、その他に関しては第 11 実施形態と同様であるため、第 11 実施形態と異なる部分についてのみ説明する。

[0114] 図 29 は、本実施形態にかかる半導体装置の上面レイアウト図である。なお、図 29 は断面図ではないが、図を見易くするために部分的にハッチングを示してある。この図に示すように、本実施形態でも、円形状に囲まれる範囲を第 3 の領域として、第 3 の領域が正三角形の各角部に配置されたレイアウトとされ、各第 3 の領域を繋ぐ正三角形の各辺に相当する位置に第 2 の領域が配置されたレイアウトとされている。そして、これに対応して、各第 3 の領域が構成する正三角形の中心点および各中心を繋ぐ直線部分にコレクタ領域に相当する p+型不純物領域 2 を配置することで、p+型不純物領域 2 が複数の正六角形に配置されるようにし、その正六角形の線内にカソード領域に相当する n+型不純物領域 3 を配置した構造としている。

[0115] このように、第 1～第 3 の領域、つまり基板表面側において IGBT 100 として機能する部分や FWD 200 として機能する部分のレイアウトと、基板裏面側において IGBT 100 のコレクタ領域となる p+型不純物領域 2 や FWD 200 のカソード領域となる n+型不純物領域 3 のレイアウトを合せている。これにより、第 16 実施形態と同様の効果が得られる。

(第 19 実施形態)

本発明の第 19 実施形態について説明する。本実施形態は、第 12 実施形態に対してよりスイッチング損失低減が図れるレイアウトにしたものであり、その他に関しては第 12 実施形態と同様であるため、第 12 実施形態と異なる部分についてのみ説明する。

- [0116] 図30(a)は、本実施形態にかかる半導体装置の上面レイアウト図、図30(b)は、図30(a)の二点差線で囲んだ領域の部分拡大図である。なお、図30(a)は断面図ではないが、図を見易くするために部分的にハッチングを示してある。この図に示すように、本実施形態でも、第1〜第3の領域を備えた構造について、第1の領域の長手方向先端部よりもn+型不純物領域3が突き出すように形成され、n+型不純物領域3が長手方向において分割されている構造とされている。分割した各n+型不純物領域3の間の距離 $L_c$ が200 $\mu\text{m}$ 以上となるようにレイアウトされている。そして、n+型不純物領域3が第2の領域と対応する場所に形成された領域3aだけでなく第1の領域と対応する場所に形成された領域3bを備えた構成とされている。
- [0117] 領域3aは、第2の領域の幅に対応する幅とされている。領域3bは、隣接する各領域3aの中央位置に形成され、第1の領域の幅や領域3aの幅よりも狭く、かつ、第1の領域の長手方向と同方向を長手方向として延設されている。
- [0118] このように構成された半導体装置では、n+型不純物領域3のうちの領域3aについてはダイオード動作を行わせ、領域3bについてはMOS動作を行わせることができる。すなわち、FWD200として機能する第2の領域と対応する位置に形成された領域3aについてはカソード領域として機能することでダイオード動作させられる。また、IGBT100として機能する第1の領域と対応する位置に形成された領域3bは、MOSFETにおけるドレイン領域として機能することでMOS動作させられる。このため、次のような効果を得ることができる。
- [0119] 図31は、本実施形態にかかる半導体装置の $V_{ce} - I_c$ 特性を調べた図である。また、比較例として領域3bを有しない第12実施形態の半導体装置の $V_{ce} - I_c$ 特性も図31中に示してある。この図中の小電流領域を確認すると、第12実施形態の半導体装置の場合、 $V_{ce}$ が1V近辺から $V_{ce}$ の増加に伴って徐々に $I_c$ が上昇していく特性になっている。これに対して、本実施形態の半導体装置の場合、 $V_{ce}$ が1.5V近辺において $I_c$ が

急に上昇し、その後、第12実施形態の半導体装置と同様に $V_{ce}$ の増加に伴って徐々に $I_c$ が上昇していく特性になる。これは、本実施形態の半導体装置の場合、第12実施形態の半導体装置と比較して低注入化が可能となつて、より速くスイッチ行われていることを表しており、スイッチング損失を低減することが可能となる。

[0120] 一般的に、MOSFETはIGBTよりもスイッチング動作が速く、MOSFETの方がIGBTよりもスイッチング損失が小さい。本実施形態の半導体装置では、IGBT動作を基本としつつ、MOS動作も行わせることが可能になることから、スイッチング損失の低減を図ることが可能となる。このようなスイッチング損失の低減効果は、半導体装置をインバータ駆動に適用する場合のように頻繁にスイッチングが行われるような適用形態とされる場合に有効である。

[0121] また、図中の大電流領域については、本実施形態の半導体装置も第12実施形態の半導体装置も $V_{ce} - I_c$ 特性がほぼ同様になる。このため、本実施形態の半導体装置によれば、スイッチング周波数の高い低電流でスイッチング損失低減を図りつつ、熱定格を決める大電流領域では第12実施形態の半導体装置と同様の電流特性を得ることが可能となる。

[0122] さらに、本実施形態では、分割した各 $n+$ 型不純物領域3の間の距離 $L_c$ が $200\mu m$ 以上となるようにしている。図32は、FS層のシート抵抗が $2.5E-5 [\Omega/\square]$ 、板厚が $50\mu m$ 、基板の比抵抗が $65 [\Omega cm]$ の場合の距離 $L_c$ とIGBT100のスナップバック電圧 $V_{SB}$ について調べた結果を示すグラフである。この図に示されるように、距離 $L_c$ が長くなるほど、つまりIGBT動作を行うことができる範囲を広くするほど、スナップバック電圧 $V_{SB}$ を低下させられる。そして、距離 $L_c$ が $200\mu m$ 以上になると、スナップバック電圧 $V_{SB}$ が $40^\circ C$ における $V_{AK}(th) = 0.8 [V]$ に対して無視できる $0.1V$ 以下にすることが可能になる。このように、距離 $L_c$ を $200\mu m$ 以上に設定することで十分にスナップバック電圧 $V_{SB}$ を小さくすることが可能となる。

- [01 23] なお、本実施形態では、領域 3 b を隣接する各領域 3 a の中央位置に形成しているが、他の構造としても良い。図 3 3 (a) ~ (c) は、領域 3 b の他のレイアウトを示した図であり、図 3 0 (b) に相当する部分拡大図である。図 3 3 (a) に示したように領域 3 b を長手方向において複数に分割した構造としても良いし、図 3 3 (b) に示すように、領域 3 b を 2 本配置した構造としても良い。さらに、図 3 3 (c) に示すように、領域 3 b を 2 本配置しつつ、それぞれ長手方向において複数に分割し、さらに分割された各領域 3 b が交互に配置された構造としても良い。
- [01 24] また、本実施形態では、 $n+$ 型不純物領域 3 を長手方向において 2 つに分割する場合について説明したが、他の構造とすることもできる。図 3 4 ~ 図 3 6 は、 $n+$ 型不純物領域 3 を他の構造とする場合の半導体装置のレイアウト図である。図 3 4 ~ 図 3 6 の二点鎖線で囲んだ領域は、図 3 0 (b) や図 3 3 (a) ~ (c) の構造とされている。
- [01 25] 図 3 4 に示すように、第 1 3 実施形態と同様、 $n+$ 型不純物領域 3 を分割しない構造とすることができる。この場合にも、第 1 の領域の長手方向先端部が  $n+$ 型不純物領域 3 よりも突き出すように形成されることになるが、この突き出し部分において IGBT 動作を行うことができる範囲を広く取れるため、IGBT 100 のスナップバック電圧  $V_{SB}$  を低減することが可能となる。なお、この構造の場合、 $n+$ 型不純物領域 3 の先端に対して第 1 の領域の長手方向先端部が突き出す距離  $L_c$  が 100  $\mu\text{m}$  以上とすることで十分にスナップバック電圧  $V_{SB}$  を小さくすることが可能となる。
- [01 26] また、図 3 5 に示すように、 $n+$ 型不純物領域 3 を長手方向において複数個に分割した構造としても良い。この場合にも、分割された各  $n+$ 型不純物領域 3 の間の距離  $L_c$  が 200  $\mu\text{m}$  以上となるようにすると、より十分にスナップバック電圧  $V_{SB}$  を小さくすることが可能となる。
- [01 27] さらに、図 3 6 に示すように、第 1 の領域の長手方向先端部が  $n+$ 型不純物領域 3 よりも突き出す構造とされる場合にも、 $n+$ 型不純物領域 3 を長手方向において分割することができる。この場合にも、 $n+$ 型不純物領域 3 の先端に

対して第 1 の領域の長手方向先端部が突き出す距離  $L_c$  が 100  $\mu\text{m}$  以上となり、かつ、分割された各  $n$ +型不純物領域 3 の間の距離  $L_c$  が 200  $\mu\text{m}$  以上となるようにすると、より十分にスナップバック電圧  $V_{SB}$  を小さくすることが可能となる。

(第 20 実施形態)

本発明の第 20 実施形態について説明する。本実施形態は、第 12 実施形態に対してよりスイッチング損失低減が図れるレイアウトにしたものであり、その他に関しては第 12 実施形態と同様であるため、第 12 実施形態と異なる部分についてのみ説明する。

[01 28] 図 37 (a) は、セル領域における基板裏面側のレイアウトを示した図であり、図 37 (b) は、図 37 (a) の部分拡大図である。なお、図中破線で示したセル領域の内部には、実際にはカソード領域に相当する  $n$ +型不純物領域 3 も形成されているが、例えば第 12 ~ 第 19 実施形態で説明したように様々なレイアウトのものを採用できるため、図 37 (a) では図示を省略してある。

[01 29] 図 37 (a) に示すように、セル領域の外縁部においてコレクタ領域に相当する  $p$ +型不純物領域 2 およびカソード領域に相当する  $n$ +型不純物領域 3 が混在する混在領域 15 が形成されている。この混在領域 15 は、基本的には  $p$ +型不純物領域 2 とされているが、部分的に  $n$ +型不純物領域 3 が形成された構造とされている。具体的には図 37 (b) に示すように、複数の正方形形状にて  $n$ +型不純物領域 3 が点在させられており、その寸法を  $1 \mu\text{m} \square \sim 20 \mu\text{m} \square$  に設定することで拡散係数 ( $= d \text{ て } 1/2$ ) にて規定される拡散長以下となるようにしている。また、点在している各  $n$ +型不純物領域 3 の間の間隔が  $150 \mu\text{m}$  未満に設定することで、定常時やスイッチング時に電流密度が大きくなり過ぎて混在領域 15 において IGBT 100 がオンしてしまうことを抑制している。

[01 30] 図 38 に示す断面図のように、動作中に  $p$  型ディープウェル層 13 とその下に位置する  $p$ +型不純物領域 2 との間にキャリアが蓄積されている。このた



め、スイッチング時に図中矢印で示すように p +型不純物領域 2 の表面を経路として電子電流が流れて n +型不純物領域 3 に流れ込む。これにより、p 型デープウエル層 1 3 と n \_型ドリフト層 1 および p +型不純物領域 2 とによって構成される寄生 P N P トランジスタがオンしてしまう。このため、p 型デープウエル層 1 3 とその下に位置する p +型不純物領域 2 との間にホールが再注入されて電流集中が発生し、半導体装置が壊れる可能性がある。

[01 31] このため、本実施形態に示すように、セル領域の外縁部において p +型不純物領域 2 に n +型不純物領域 3 を点在させた混在領域 1 5 を備えることで、寄生 P N P トランジスタがオンし難くなるようにできる。これにより、半導体装置の耐量を向上させられる。また、ホール再注入を抑制できるため、スイッチング損失の低減を図ることも可能となる。

(第 2 1 実施形態)

本発明の第 2 1 実施形態について説明する。本実施形態は、第 2 0 実施形態に対して混在領域 1 5 の構造を変更したものであり、その他に関しては第 2 0 実施形態と同様であるため、第 2 0 実施形態と異なる部分についてのみ説明する。

[01 32] 図 3 9 ( a ) は、セル領域における基板裏面側のレイアウトを示した図であり、図 3 9 ( b ) は、図 3 9 ( a ) の部分拡大図である。なお、セル領域の内部には、実際にはカソード領域に相当する n +型不純物領域 3 も形成されているが、例えば第 1 2 ~ 第 1 9 実施形態で説明したように様々なレイアウトのものを採用できるため、図 3 9 ( a ) では図示を省略してある。

[01 33] 図 3 9 ( a ) 、 ( b ) に示すように、本実施形態では、混在領域 1 5 に備えられる n +型不純物領域 3 にてセル領域の外縁部を囲むレイアウトとしている。そして、混在領域 1 5 に備えられる n +型不純物領域 3 の幅を  $20 \mu\text{m}$  以下に設定することで拡散係数  $(= d \text{ て } 1/2)$  にて規定される拡散長以下となるようにしている。また、各 n +型不純物領域 3 の間の間隔を  $150 \mu\text{m}$  未満に設定することで、定常時やスイッチング時に電流密度が大きくなり過ぎて混在領域 1 5 において I G B T 1 0 0 がオンしてしまうことを抑制している。

このような構成としても、第20実施形態と同様の効果を得ることができる。

(第22実施形態)

本発明の第22実施形態について説明する。本実施形態も、第20実施形態に対して混在領域15の構造を変更したものであり、その他に関しては第20実施形態と同様であるため、第20実施形態と異なる部分についてのみ説明する。

[0134] 図40(a)は、セル領域における基板裏面側のレイアウトを示した図であり、図40(b)は、図40(a)の部分拡大図である。なお、セル領域の内部には、実際にはカソード領域に相当するn+型不純物領域3も形成されているが、例えば第12～第19実施形態で説明したように様々なレイアウトのものを採用できるため、図40(a)では図示を省略してある。

[0135] 図40(a)、(b)に示すように、本実施形態では、混在領域15に備えられるn+型不純物領域3が略四角形状とされるセル領域の各辺の垂直方向に延設されたレイアウトとしている。そして、混在領域15に備えられるn+型不純物領域3の幅を1 $\mu$ m～20 $\mu$ mに設定することで拡散係数(=d<sup>2</sup>/t)にて規定される拡散長以下となるようにしている。また、各n+型不純物領域3の間隔を150 $\mu$ m未満に設定することで、定常時やスイッチング時に電流密度が大きくなり過ぎて混在領域15においてIGBT100力オンしてしまうことを抑制している。このような構成としても、第20実施形態と同様の効果を得ることができる。

(第23実施形態)

本発明の第23実施形態について説明する。本実施形態は、第21実施形態に対して混在領域15の構造を変更したものであり、その他に関しては第21実施形態と同様であるため、第21実施形態と異なる部分についてのみ説明する。

[0136] 図41は、セル領域における基板裏面側のレイアウトを示した図である。なお、セル領域の内部には、実際にはカソード領域に相当するn+型不純物領

域 3 も形成されているが、例えば第 12 ～第 19 実施形態で説明したように様々なレイアウトのものを採用できるため、図 4 1 では図示を省略してある。

[01 37] この図に示すように、本実施形態では、混在領域 15 において、セル領域の外縁部を囲むように配置された複数の n+型不純物領域 3 のうち最も内周側のものを、それよりも外周側に位置しているものよりも太くしている。具体的には、 $20\mu\text{m}$  より太く設定することで拡散係数 ( $=d$  で  $1/2$ ) にて規定される拡散長より太くしている。

[01 38] 混在領域 15 に備えられる各 n+型不純物領域 3 の間の間隔を広く取ると、定常時やスイッチング時に電流密度が大きくなり過ぎて IGBT 100 がオンしてしまう。このため、セル領域の外縁部を囲むように配置された複数の n+型不純物領域 3 のうち最も内周側のものを太くしておくことで、それよりも外側において電流密度を低下させることが可能となる。これにより、混在領域 15 において定常時やスイッチング時に電流密度が大きくなり過ぎて IGBT 100 がオンしてしまうことをより抑制することが可能となる。

(他の実施形態)

(1) 上記各実施形態では、IGBT 100 と FWD 200 を備えた半導体装置の一例について説明したが、各構成の形状を変更するなど、適宜変更可能である。例えば、第 2 ～第 23 実施形態では、第 1 ～第 3 の領域を備えた構造について説明した。また、第 4 ～第 8 実施形態において、図中破線で囲んだエミッタ領域に相当する n+型不純物領域 5 が備えられていない領域を設け、この領域を第 2 の領域と同じ構造とする場合について説明した。しかしながら、上記各実施形態で説明した構造は単なる一例を示したものであり、第 1 ～第 3 の領域の構成や第 4 ～第 8 実施形態において図中破線で囲んだ領域の構成を変更しても良い。

[01 39] 図 4 2 (a) ～ (c) は、第 1 の領域のセル構成、第 2、第 3 の領域のセル構成および第 4 ～第 8 実施形態において図中破線で囲んだ領域のセル構成の一例を示した断面図である。

- [0140] 図42(a)に示すように、第1の領域については、エミッタ領域に相当するn+型不純物領域5を形成しないことで、IGBT100として機能する部分を間引いた間引き構造としている。この間引き部分におけるp型ベース領域4内に隣接するトレンチゲート構造を繋ぐようにn型領域(ホールストツバ(HS)層)20を備えた構造とすることができる。
- [0141] このように、n型領域20を備えることにより、IGBT100がIGBT動作を行う際には、p型ベース領域4のうちn型領域20の下方位置においてキャリアを蓄積することができる。つまり、n型領域20が無い場合には、ホールがp型ベース領域4を通じて上部電極10側に抜けてしまい、オン電圧が高くなることから、オン電圧低下のために、IGBT動作時にできるだけキャリアを蓄積させておき、導電率変調が起こるようにすることが望ましい。このため、n型領域20を備え、p型ベース領域4のうちn型領域20の下方位置においてキャリアを蓄積することで、導電率変調を起こさせることが可能となり、オン電圧低下を実現できる。そして、IGBT形成領域におけるダイオード動作に伴うホール注入が抑えられるため、リカバリ特性を改善することも可能となる。
- [0142] なお、間引き部のp型ベース領域4のうちn型領域20よりも上方に残された部分は接地される。間引き部の近傍のIGBT100がIGBT動作を行う際には、コレクターエミッタ間がショートすることになるため、間引き部に構成されるFWD200がダイオード動作しなく可能性がある。このため、p型ベース領域4を接地することで、間引き部に構成されるFWD200が確実にダイオード動作できるようにしている。
- [0143] また、図42(b)に示すように、第2、第3の領域については、全域間引き部にて構成することもできる。さらに、図42(c)に示すように、第4～第8実施形態において図中破線で囲んだ領域については、図42(a)に示した第1の領域の構造から、単にエミッタ領域に相当するn+型不純物領域5を除いた構造によって構成することもできる。この場合において、第2の領域を図42(b)の構造とする場合には、第4～第8実施形態等において

て図中破線で囲んだ領域と第2の領域とが異なる構造となるが、特に問題はない。

[0144] (2) 上記各実施形態では、基本的に、第1導電型をn型、第2導電型をp型とするnチャネルタイプのIGBTを例に挙げて説明したが、各部の導電型を反転させたPチャネルタイプのIGBTを適用することもできる。この場合、IGBT以外の他の構成要素についても、導電型を反転させた構造となる。また、上記第1実施形態では、トレンチゲート構造について説明したが、ラテラル型のゲート構造のIGBTについても、距離 $W_1$ 〜 $W_3$ を第1実施形態と同様の関係とすることで、第1実施形態に示した効果を得ることができる。また一部の実施例はDMOSにも適用可能である。

[0145] (3) 上記第1実施形態では、FS層1aを形成した構造を例に挙げたが、n型ドリフト層1の裏面に、p+型不純物領域2およびn+型不純物領域3のみが形成されたFS層1aが備えられていない構造としても良い。

## 請求の範囲

[請求項 1]

セル領域に縦型の絶縁ゲート型バイポーラトランジスタ (100) が備えられると共に、該セル領域における前記絶縁ゲート型バイポーラトランジスタ (100) を囲むようにフリーホイールダイオード (200) が備えられ、さらに前記セル領域を囲む外周耐圧構造が形成された外周領域が備えられる半導体装置であって、

第 1 導電型のドリフト層 (1) と、

前記セル領域および前記外周領域において、前記第 1 導電型のドリフト層 (1) の裏面側に配置された第 2 導電型のコレクタ領域 (2) と、

前記セル領域において、前記第 1 導電型のドリフト層 (1) の裏面側における前記コレクタ領域 (2) が配置されていない領域に配置された第 1 導電型のカソード領域 (3) と、

前記ドリフト層 (1) の表面側の表層部において、前記セル領域のうち前記絶縁ゲート型バイポーラトランジスタ (100) が備えられる領域および前記フリーホイールダイオード (200) が備えられる領域に形成された第 2 導電型のベース領域 (4) と、

前記ベース領域 (4) の表層部に形成された第 1 導電型のエミッタ領域 (5) と、

前記エミッタ領域 (5) と前記ドリフト層 (1) の間における前記ベース領域 (4) の表面に形成されたゲート絶縁膜 (7) と、

前記ゲート絶縁膜 (7) の上に形成されたゲート電極 (8) と、

前記ドリフト層 (1) の表面側の表層部において、前記セル領域のうち前記フリーホイールダイオード (200) が備えられる領域に形成され、前記ベース領域 (4) の外周を囲みつつ、前記ベース領域 (4) と接続され、前記ベース領域 (4) よりも高不純物濃度で深くされた第 2 導電型のディープウェル層 (13) と、

前記エミッタ領域 (5) と前記ベース領域 (4) および前記ディー

プウエル層 (13) と電氣的に接続された上部電極 (10) と、

前記コレクタ領域 (2) および前記カソード領域 (3) に電氣的に接続された下部電極 (12) とを有し、

前記ディープウエル層 (13) の外周側端部を前記ドリフト層 (1) の裏面側に投影した位置より前記カソード領域 (3) と前記コレクタ領域 (2) との境界部までの距離を  $W_1$ 、前記ベース領域 (4) のうち前記絶縁ゲート型バイポーラトランジスタ (100) と前記フリーホイールダイオード (200) との境界部から前記ディープウエル層 (13) の外周側端部までの距離を  $W_2$ 、前記ディープウエル層 (13) と前記ベース領域 (4) との境界部を裏面側に投影した位置より前記カソード領域 (3) と前記コレクタ領域 (2) との境界部までの距離を  $W_3$ 、前記ドリフト層 (1) の厚みを  $L_1$ 、前記ドリフト層 (1) 内でのキャリアの拡散係数を  $D$ 、キャリアのライフタイムを  $\tau$ 、前記絶縁ゲート型バイポーラトランジスタ (100) および前記フリーホイールダイオード (200) の構造に基づいて決まる第1パラメータを  $k_1$ 、前記ディープウエル層 (13) の構造に基づいて決まる第2パラメータを  $k_2$ 、前記ディープウエル層 (13) と前記ドリフト層 (1) の間のビルトインポテンシャル ( $V_{AK(th)}$ ) に対するスナップバック電圧 ( $V_{SB}$ ) の比に対して前記第1パラメータ  $k_1$  を掛けた値 ( $k_1 \cdot V_{SB} / V_{AK(th)}$ ) を  $K$  とすると、

距離  $W_1$  と距離  $W_2$  および距離  $W_3$  は、

$$W_3 \geq \left( (k_2 \cdot (D\tau)^{1/2})^2 - L_1^2 \right)^{1/2} \quad (1/2)$$

かつ、

$$W_2 \geq L_1 / K^{1/2}$$

ただし、 $K \geq 2.5$

かつ

$$W_2 - W_1 \geq 10 \mu m$$

を満たす値とされていることを特徴とする半導体装置。

[請求項2]

前記距離  $W_3$ 、 $W_2$ 、 $W_1$  は、

$$W_3 = \left( (k^2 \cdot (D\tau)^{1/2})^2 - L_1^2 \right)^{1/2}$$

かつ

$$W_2 = L_1 / K^{1/2}$$

かつ

$$W_2 - W_1 = 10 \text{ nm}$$

であることを特徴とする請求項1に記載の半導体装置。

[請求項3]

前記ゲート電極(8)が一方向を長手方向として延設されたゲート構造とされ、

前記ゲート構造の長手方向の先端位置においても、

前記距離  $W_1$  と前記距離  $W_2$  および前記距離  $W_3$  は、

$$W_3 \geq \left( (k^2 \cdot (D\tau)^{1/2})^2 - L_1^2 \right)^{1/2}$$

かつ、

$$W_2 \geq L_1 / K^{1/2}$$

ただし、 $K \geq 2.5$

かつ

$$W_2 - W_1 \geq 10 \mu\text{m}$$

を満たす値とされていることを特徴とする請求項1または2に記載の半導体装置。

[請求項4]

前記複数のゲート構造の間の一部において、前記エミッタ領域(5)が形成されない部分を備えることにより、前記エミッタ領域(5)が形成されていて前記絶縁ゲート型バイポーラトランジスタ(100)として動作する部分を含む第1の領域と、前記エミッタ領域(5)が形成されない部分を含み、かつ、当該部分が前記フリーホイールダイオード(200)として動作する第2の領域とを構成し、前記絶縁ゲート型バイポーラトランジスタ(100)を囲む前記フリーホイールダイオード(200)が備えられ部分を第3の領域として、

前記第1の領域および前記第2の領域は、前記ゲート構造と同方向



が長手方向とされ、

前記第3の領域に加えて前記第2の領域にも前記フリーホイールダイオード(200)を備えた構成とすることを特徴とする請求項3に記載の半導体装置。

[請求項5] 前記エミッタ領域(5)が形成されない部分の幅が $20\mu\text{m}$ 以上とされていることを特徴とする請求項4に記載の半導体装置。

[請求項6] 前記カソード領域(3)は、前記第1の領域の長手方向と同方向を長手方向として形成されていると共に、前記第1の領域の長手方向先端部よりも突き出して配置されており、該長手方向において分割されていることを特徴とする請求項4または5に記載の半導体装置。

[請求項7] 前記第1の領域は長手方向において複数に分割されていることを特徴とする請求項4または5に記載の半導体装置。

[請求項8] 分割された前記第1の領域の間の領域に前記ベース領域(4)のみが形成されることで、当該領域にもフリーホイールダイオード(200)が構成されていることを特徴とする請求項7に記載の半導体装置。

[請求項9] 前記カソード領域(3)は、前記第1の領域の長手方向と同方向を長手方向として形成されており、

前記第1の領域の長手方向先端部の方が前記カソード領域(3)の長手方向先端部よりも突き出して配置されていることを特徴とする請求項7または8に記載の半導体装置。

[請求項10] 前記分割された前記第1の領域の間の距離( $W$ 、 $B2$ )が前記距離 $W2$ の2倍以上とされていることを特徴とする請求項7ないし9のいずれか1つに記載の半導体装置。

[請求項11] 前記第1の領域は、さらに長手方向において複数箇所分割されており、複数箇所分割された当該第1の領域の間の領域に前記エミッタ領域(5)が形成されないことで、当該領域にもフリーホイールダイオード(200)が構成されていることを特徴とする請求項7ないし9のいずれか1つに記載の半導体装置。

イオード (200) が構成され、

前記カソード領域 (3) は、複数箇所分割された前記第1の領域の間の領域と対応する位置において前記第1の領域と対応する位置よりも幅広とされていることを特徴とする請求項7ないし10のいずれか1つに記載の半導体装置。

[請求項12]

前記第1の領域は複数本並べて配置され、隣り合う当該第1の領域のうち対向する辺の一部が凹まされ、該凹まされた領域にもフリーホイールダイオード (200) が構成されていることを特徴とする請求項4または5に記載の半導体装置。

[請求項13]

前記カソード領域 (3) は、前記第1の領域の長手方向と同方向を長手方向として形成されており、

前記第1の領域の一部が凹まされた領域に設けられた前記フリーホイールダイオード (200) と対向して、当該凹まされた領域に設けられた前記フリーホイールダイオード (200) の幅に合わせて前記カソード領域 (3) が形成されていることを特徴とする請求項12に記載の半導体装置。

[請求項14]

前記カソード領域 (3) は、前記第2の領域と対応する場所に形成された領域 (3a) と、該第2の領域と対応する場所に形成された領域 (3a) よりも幅が狭く、かつ、前記第1の領域と対応する場所に形成された領域 (3b) とを有していることを特徴とする請求項4ないし13のいずれか1つに記載の半導体装置。

[請求項15]

前記ドリフト層 (1) の裏面側において、前記セル領域の外縁部には、前記コレクタ領域 (2) および前記カソード領域 (3) が混在する混在領域 (15) が備えられていることを特徴とする請求項1ないし14のいずれか1つに記載の半導体装置。

[請求項16]

前記セル領域および前記外周領域において、前記第1導電型のドリフト層 (1) の裏面側に配置され、前記ドリフト層 (1) よりも高不純物濃度とされた第1導電型のフィールドストップ層 (1a) を有し

、

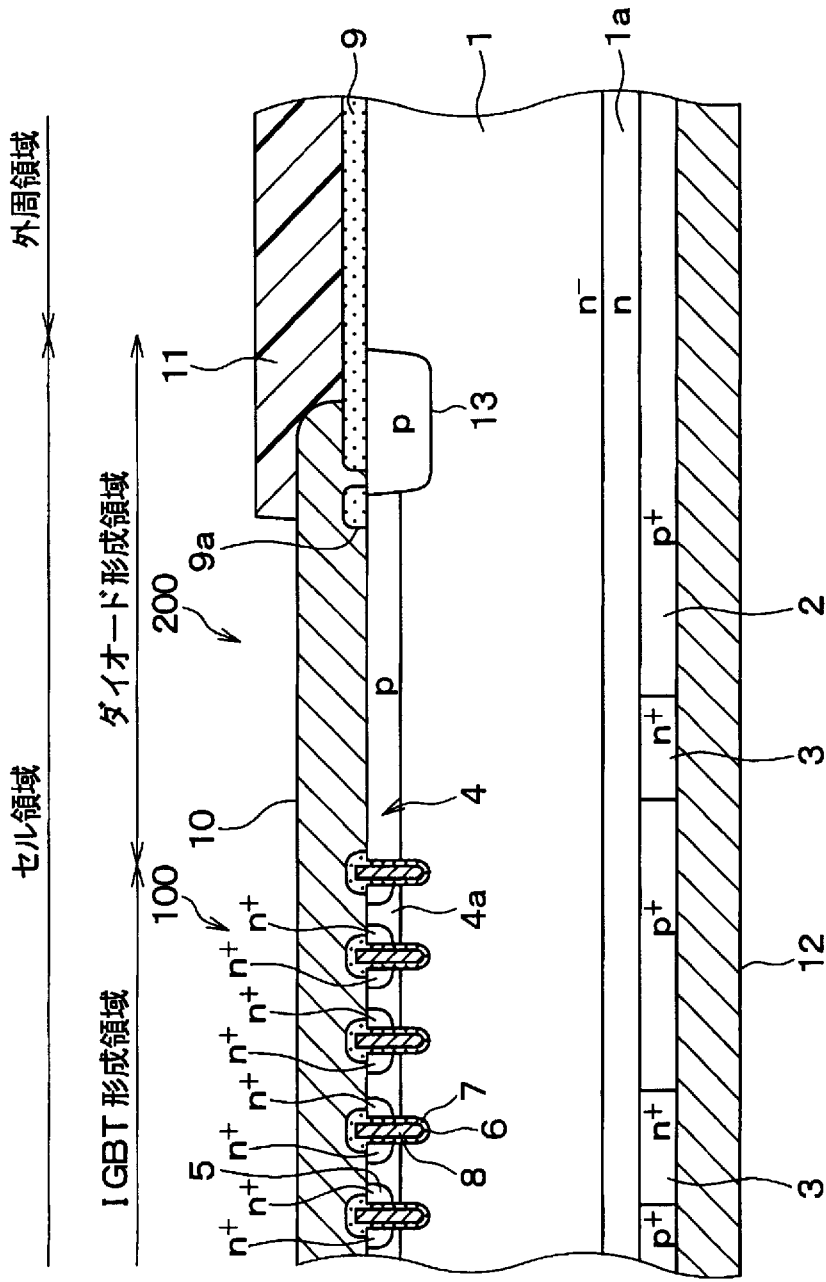
前記コレクタ領域 (2) および前記カソード領域 (3) は、前記ドリフト層 (1) の裏面側における前記フィールドストップ層 (1a) の表層部に形成されていることを特徴とする請求項 1 ないし 15 のいずれか 1 つに記載の半導体装置。

[請求項 17]

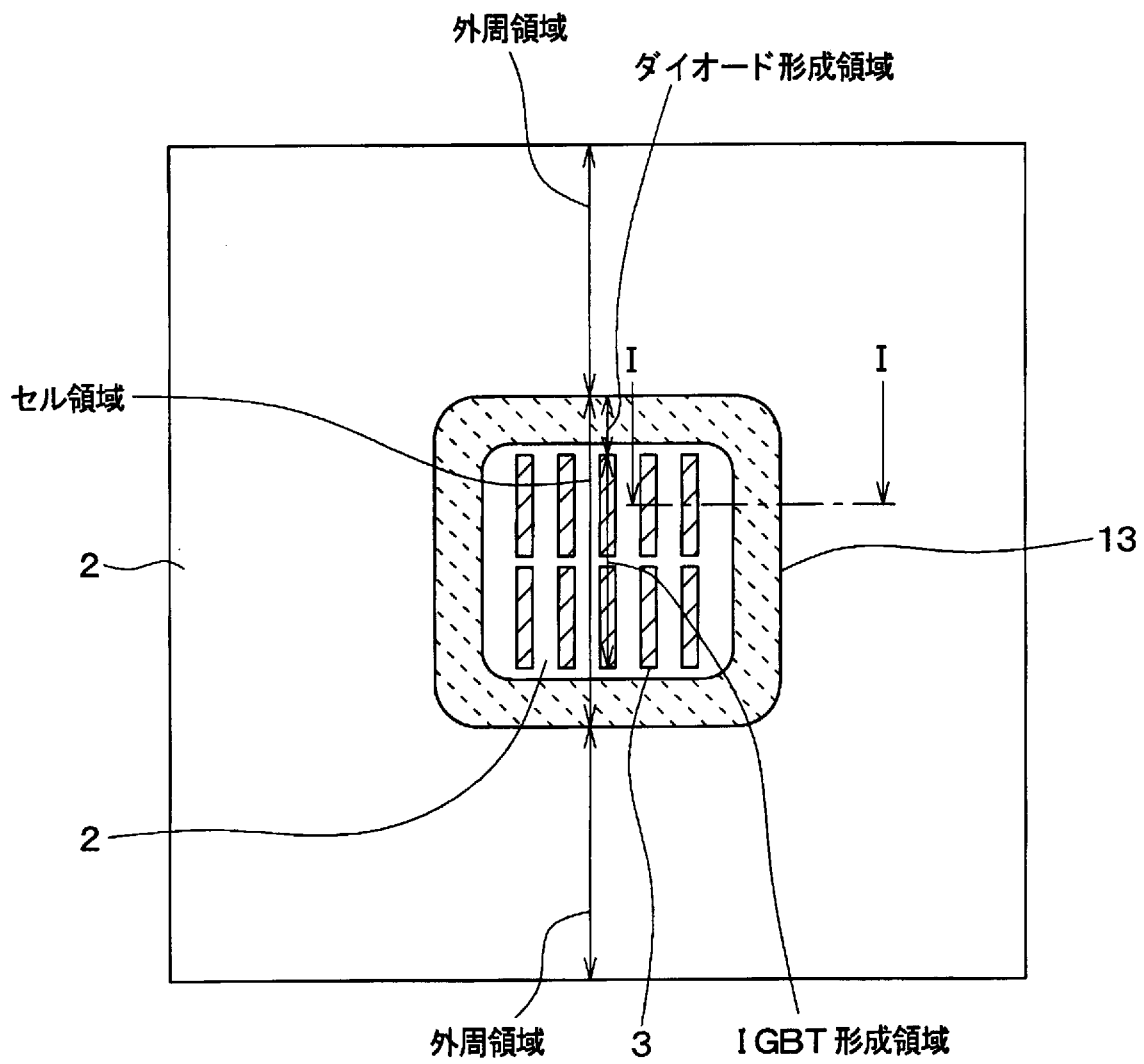
前記ベース領域 (4) を貫通し、一方向を長手方向として複数本が所定の間隔で並べられたトレンチ (6) を有し、

前記ゲート絶縁膜 (7) および前記ゲート電極 (8) が前記トレンチ (6) 内において形成されたトレンチゲート構造であることを特徴とする請求項 1 ないし 16 のいずれか 1 つに記載の半導体装置。

[図1]

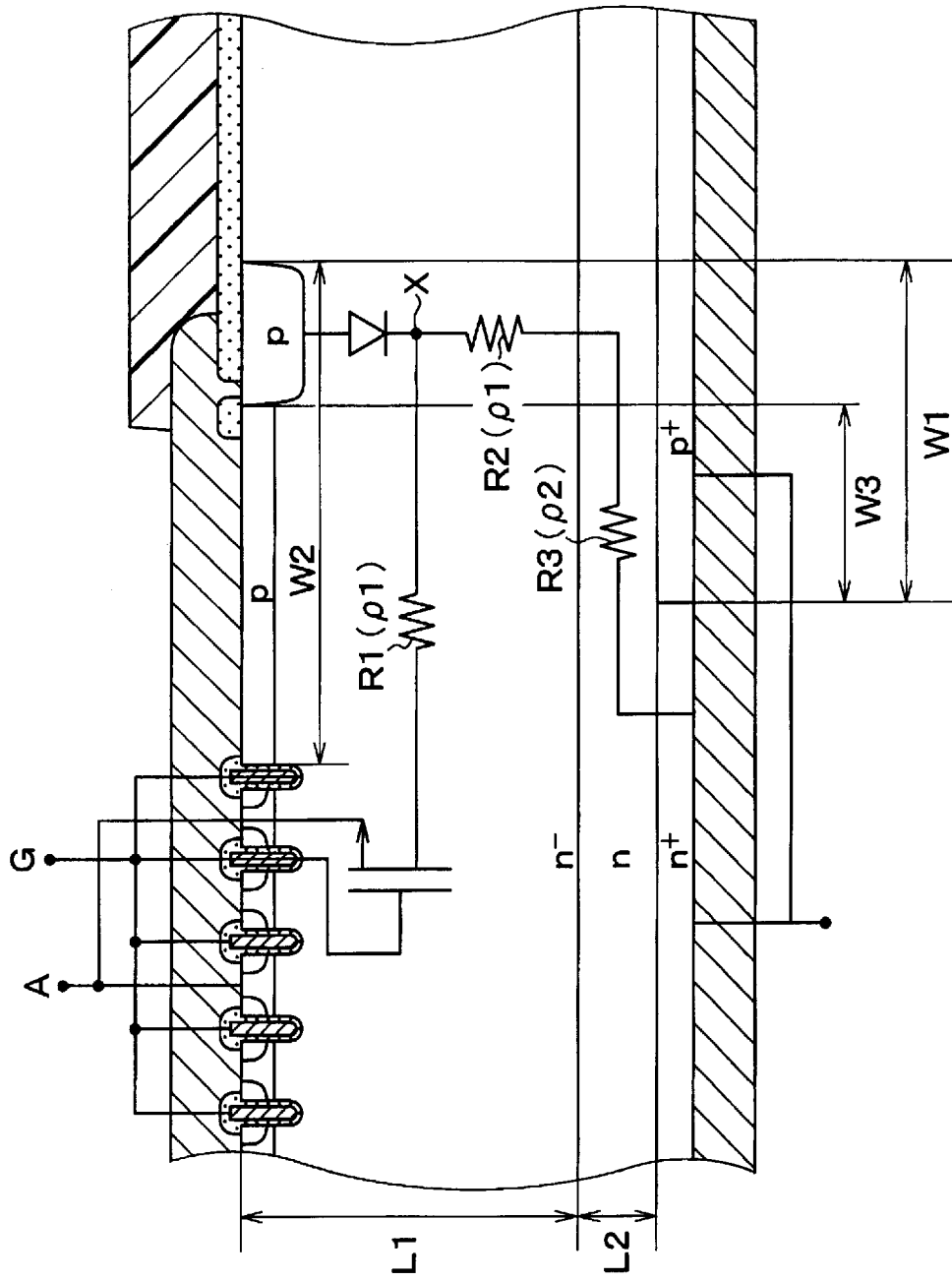


[図2]

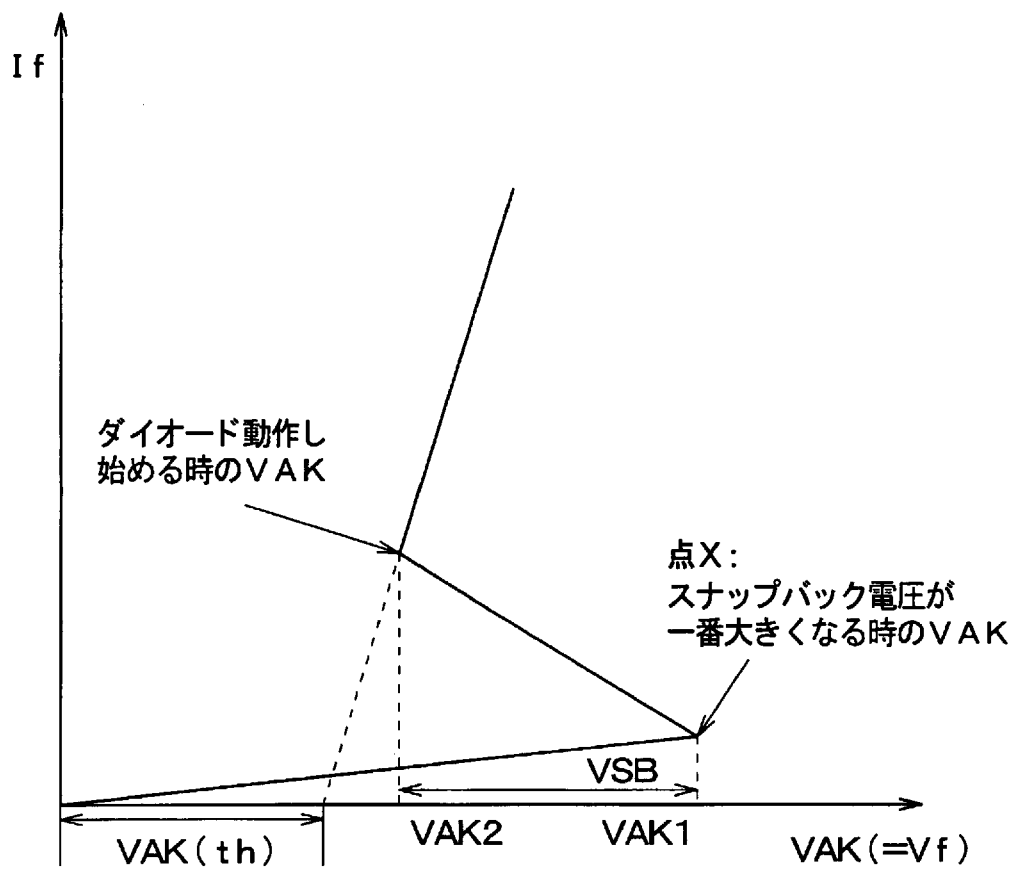




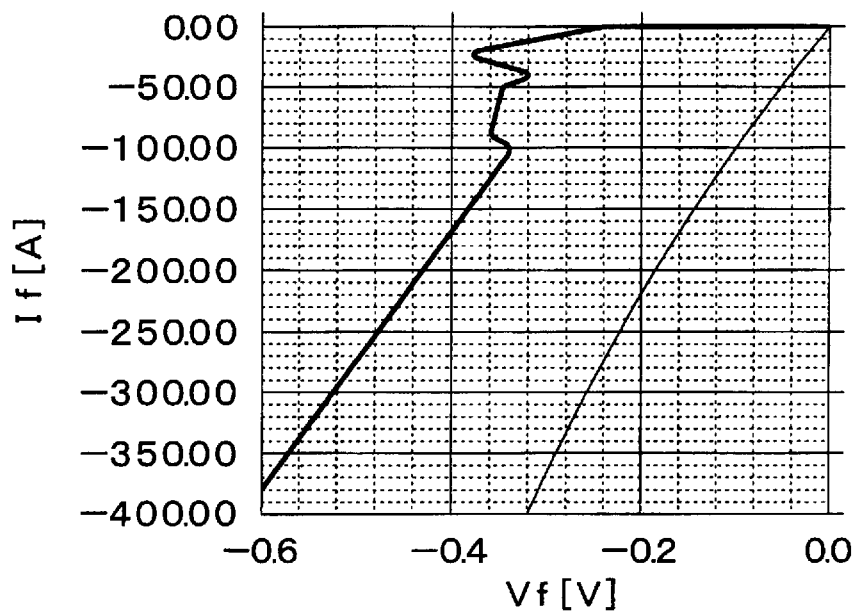
[図4]



[図5]



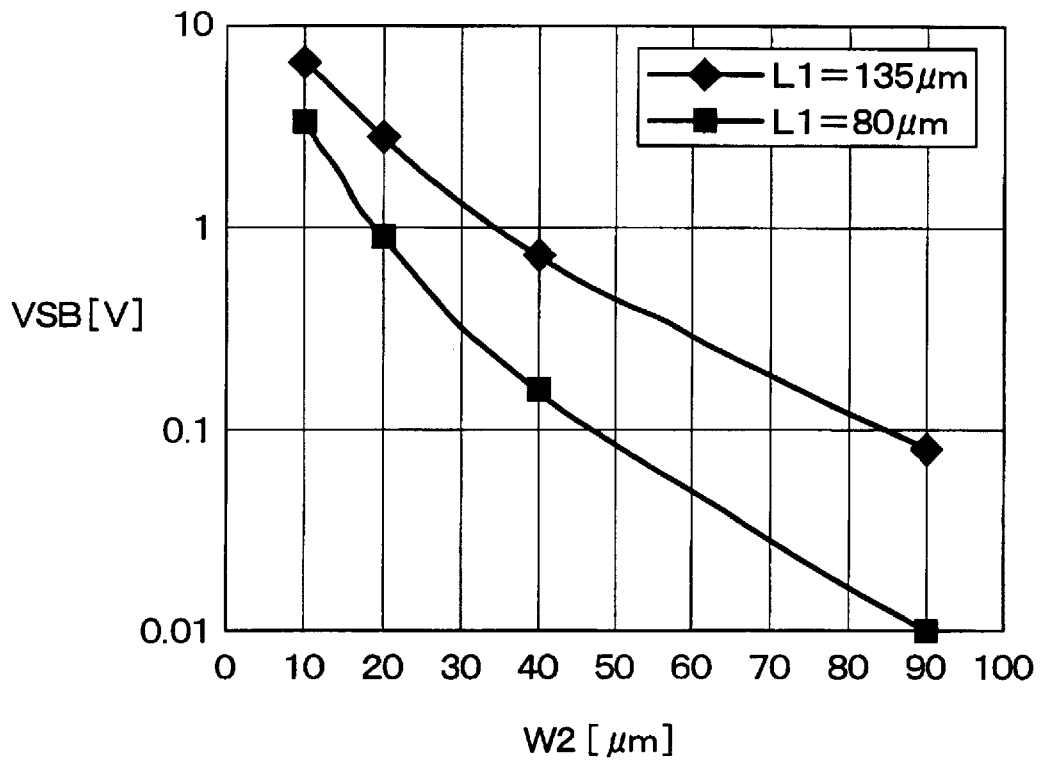
[図6]



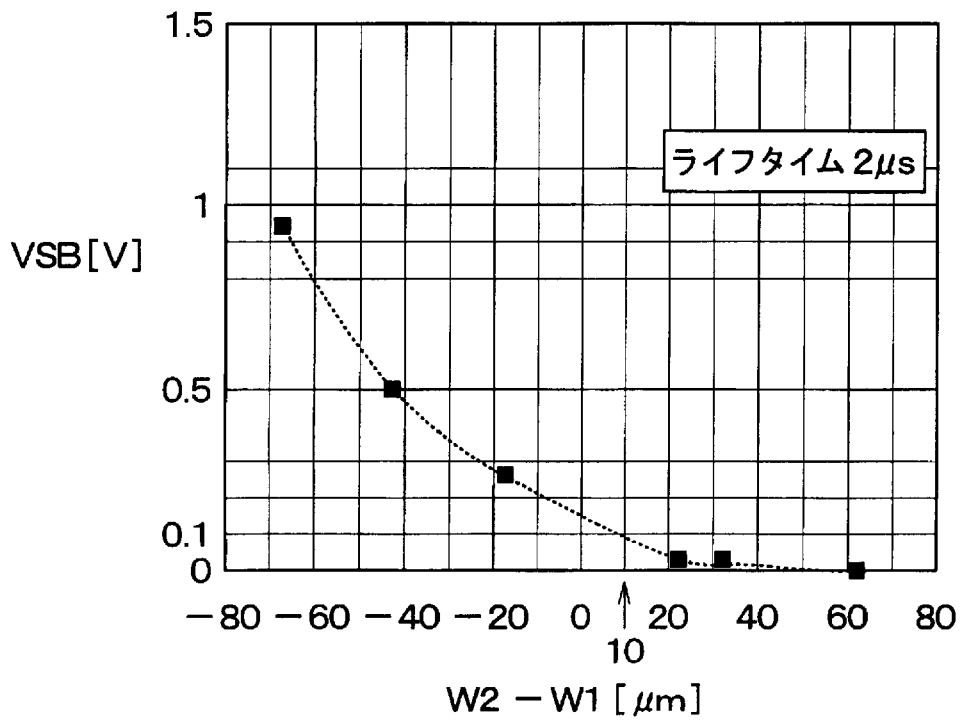




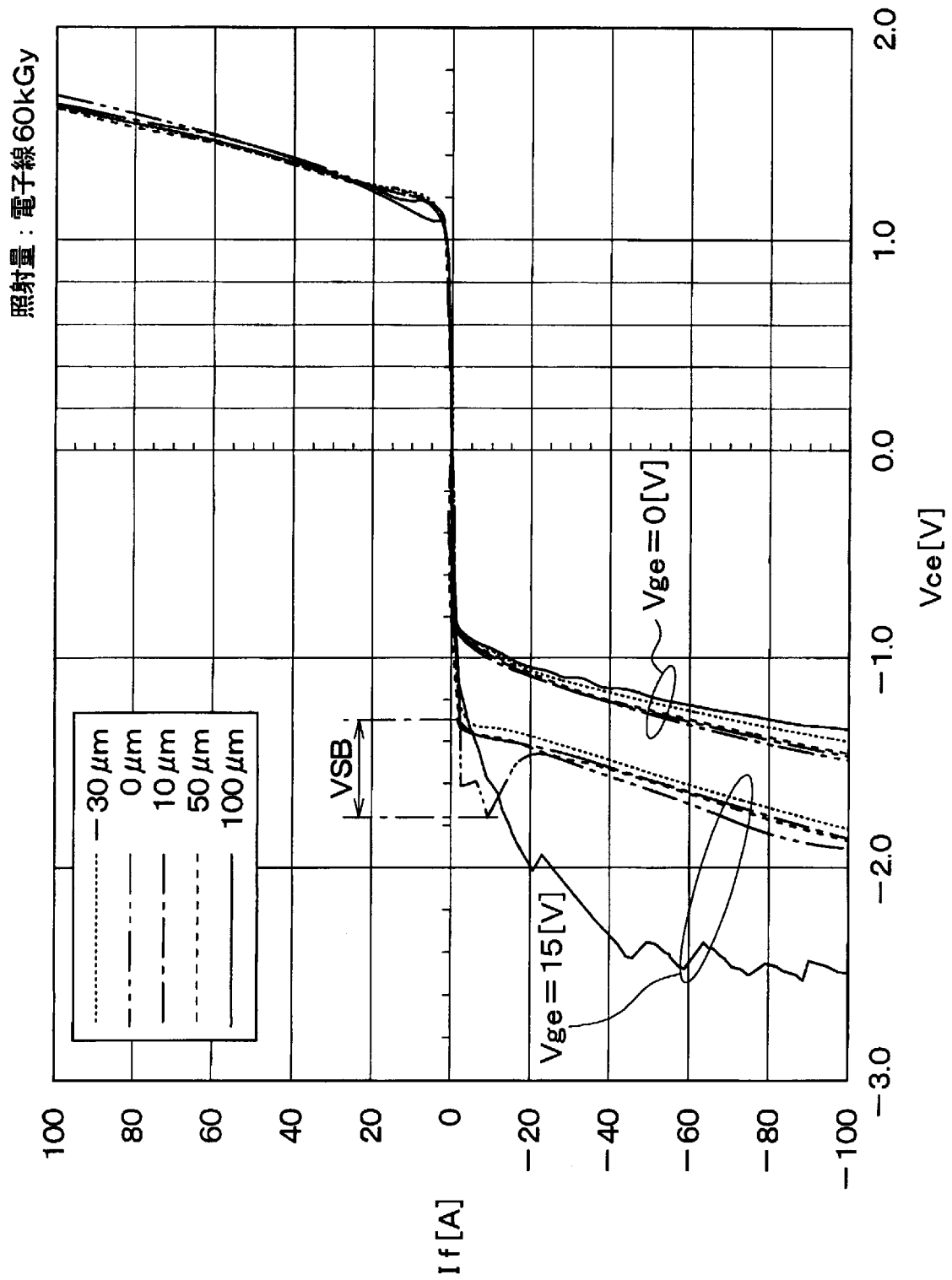
[図8]



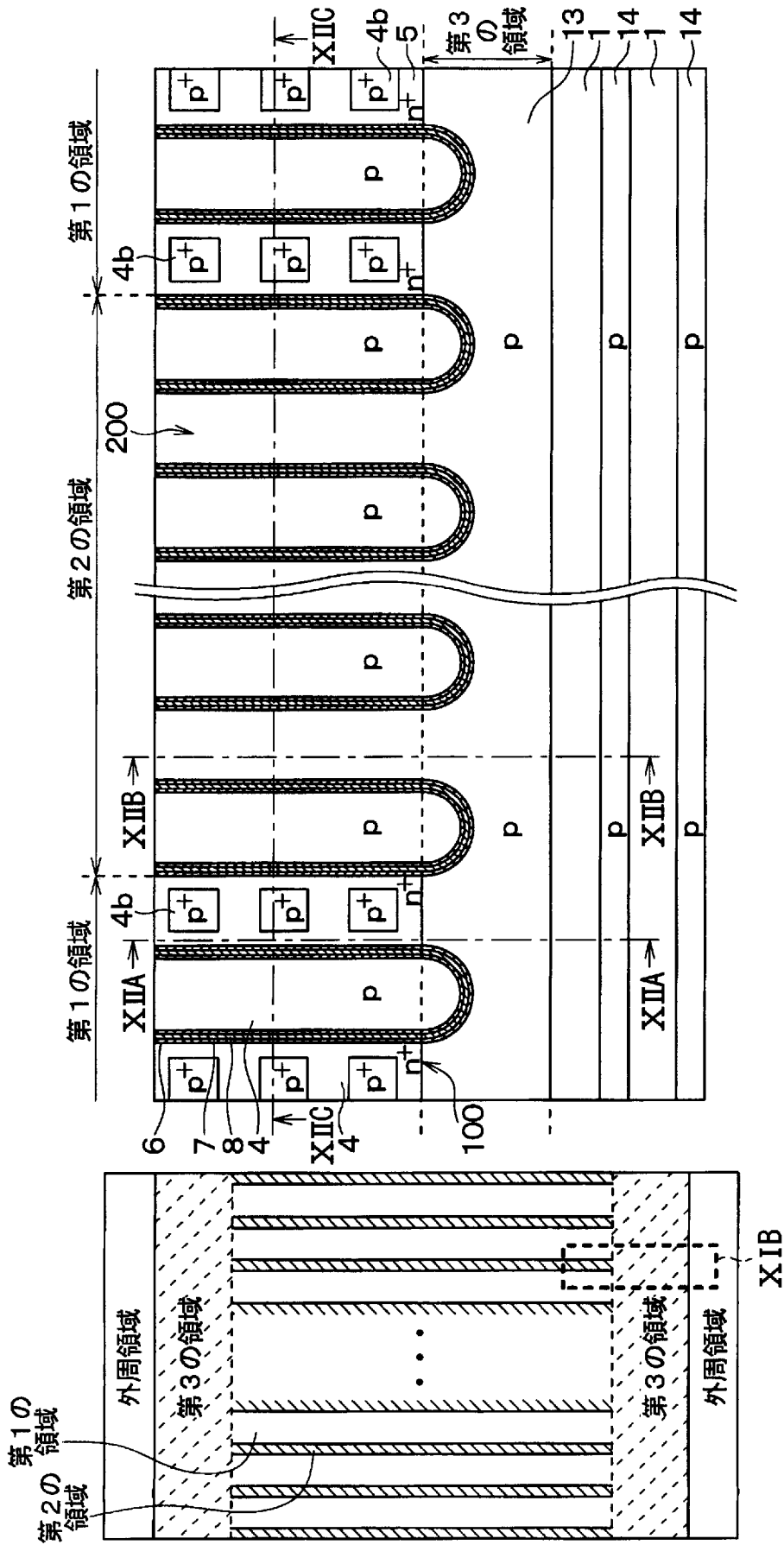
[図9]



[図10]



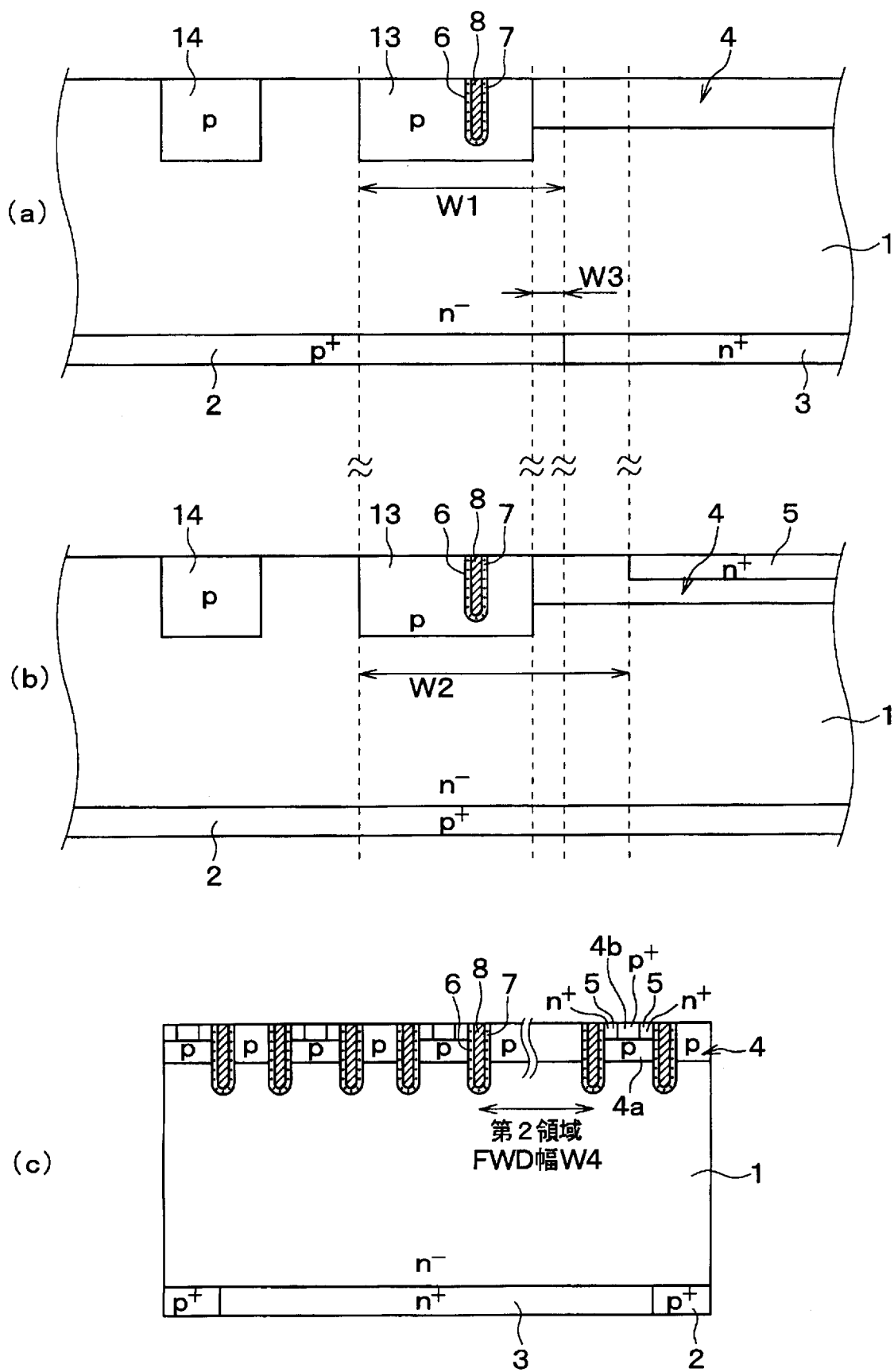
[図11]



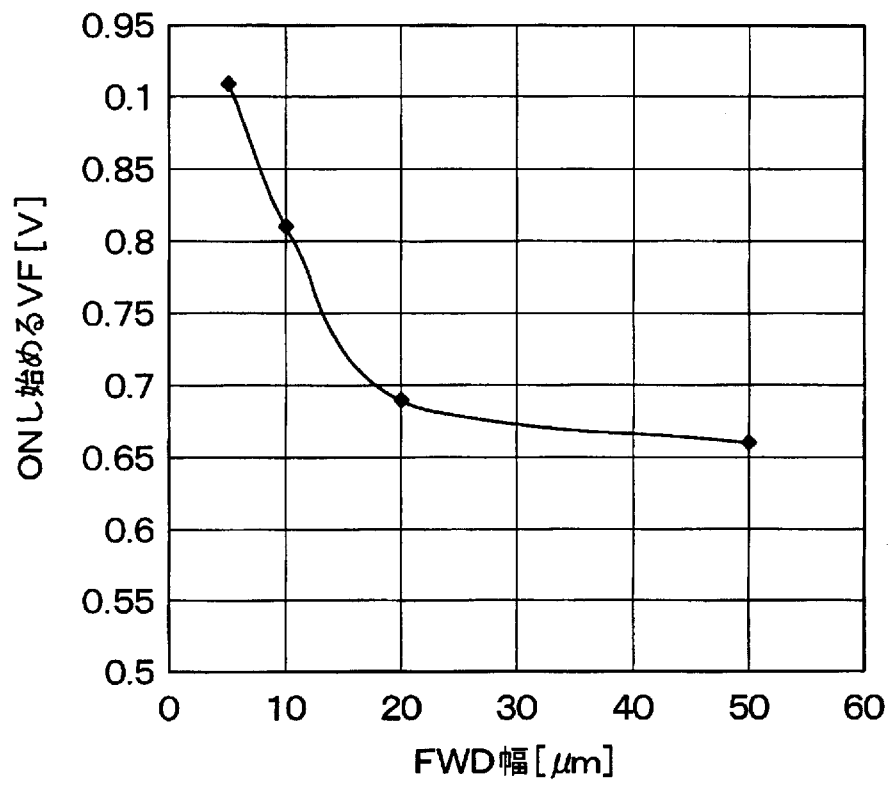
(b)

(a)

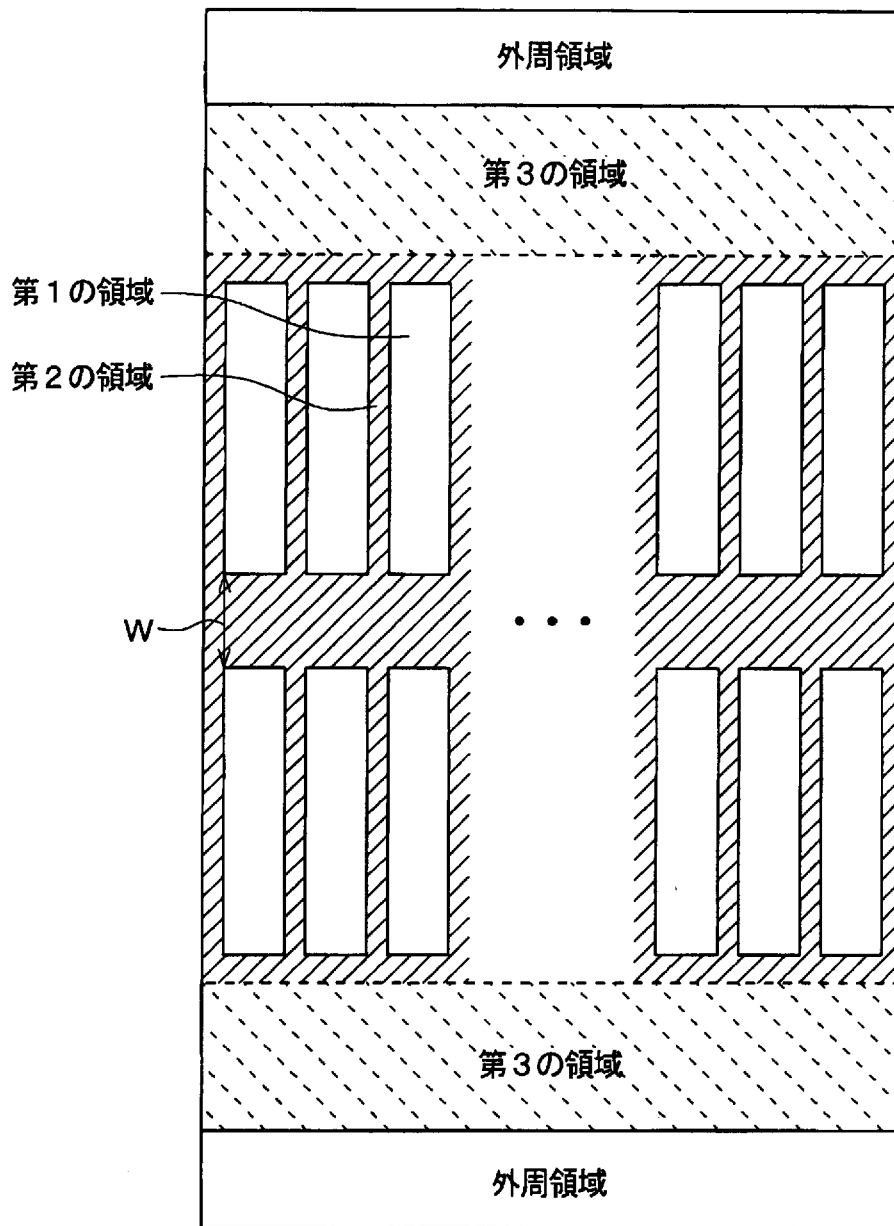
[図12]



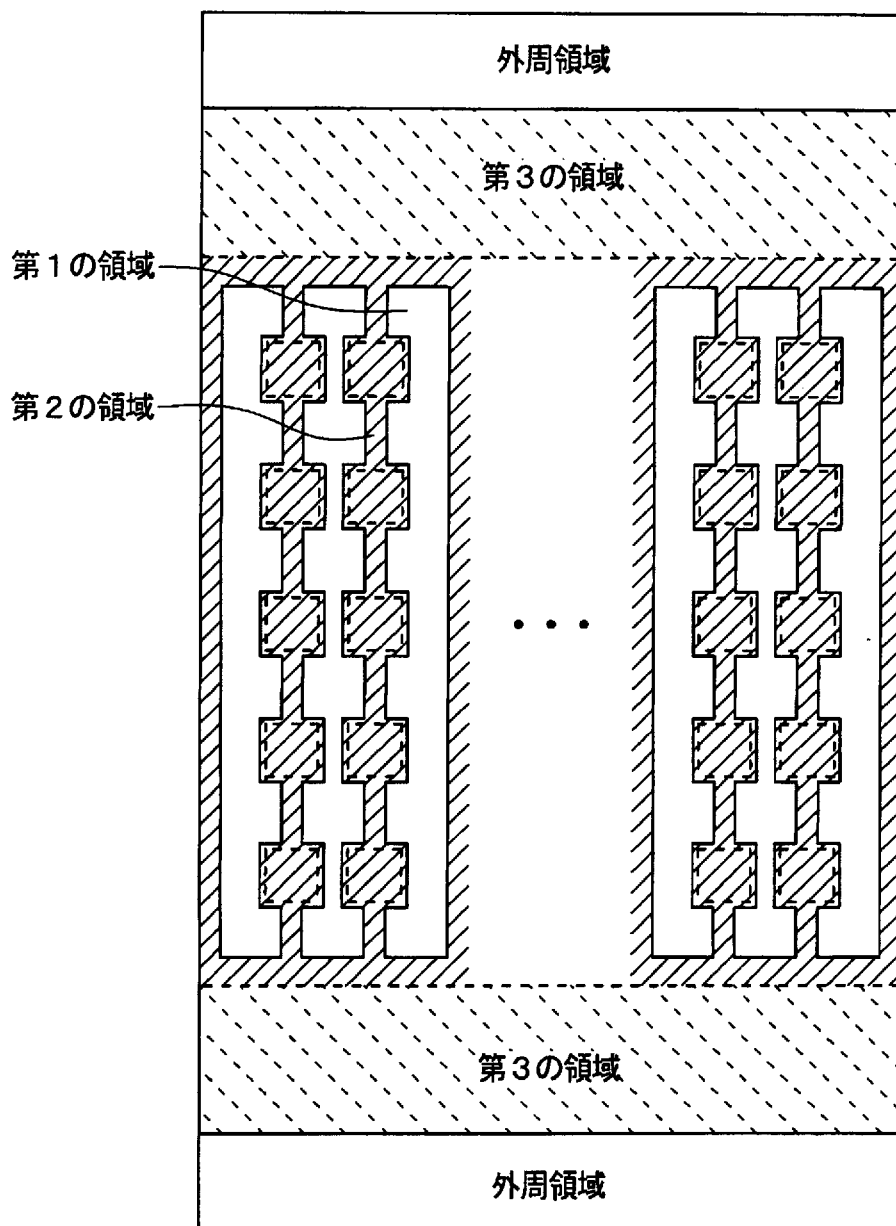
[図13]



[図14]

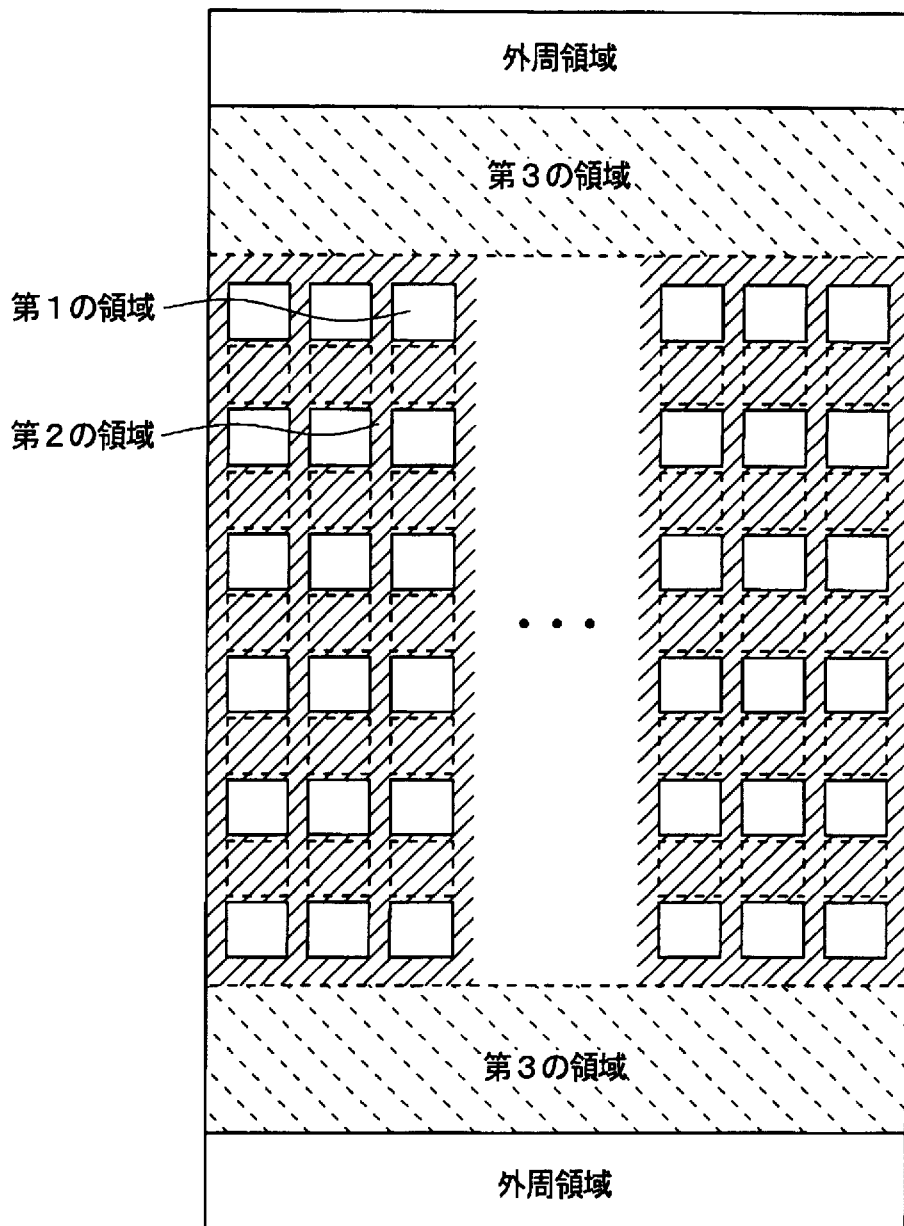


[図15]

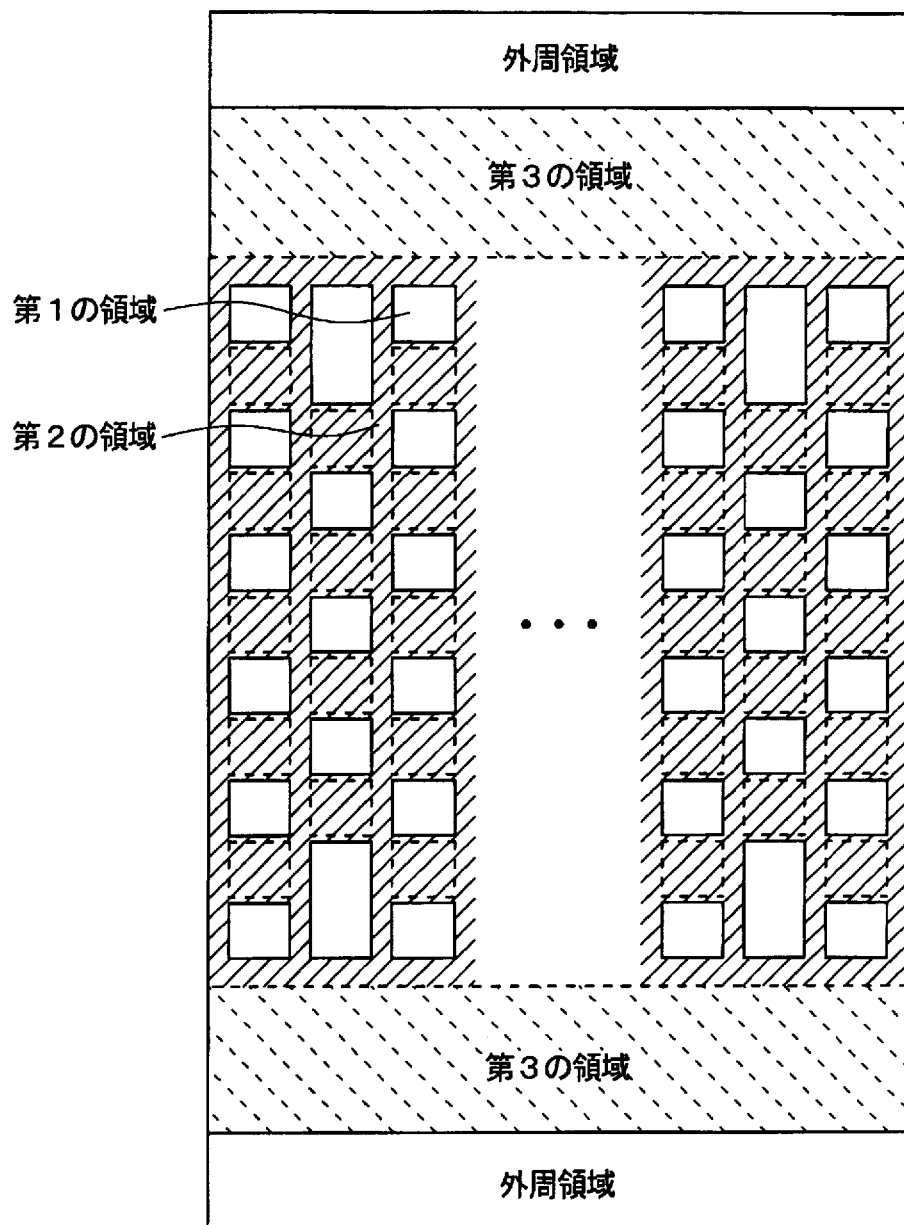




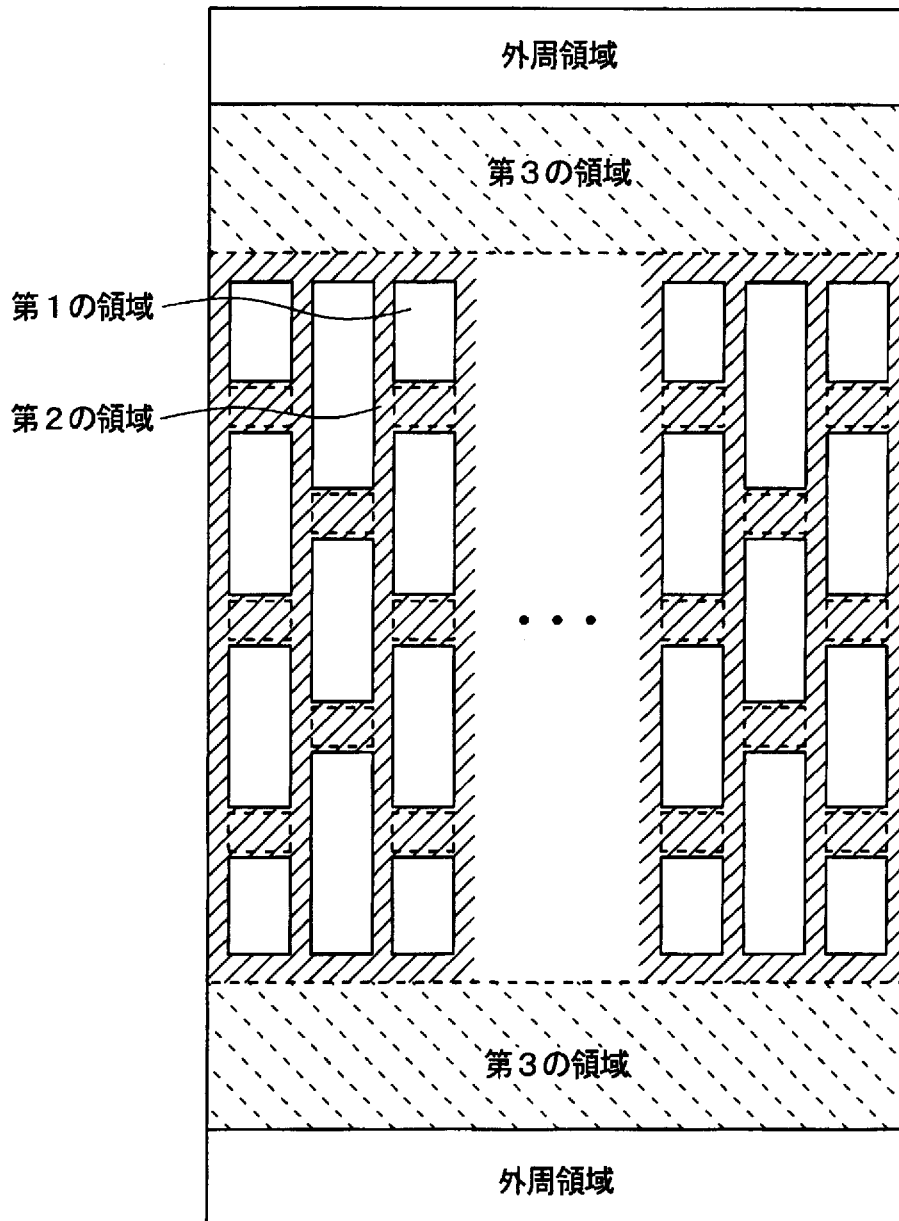
[図16]



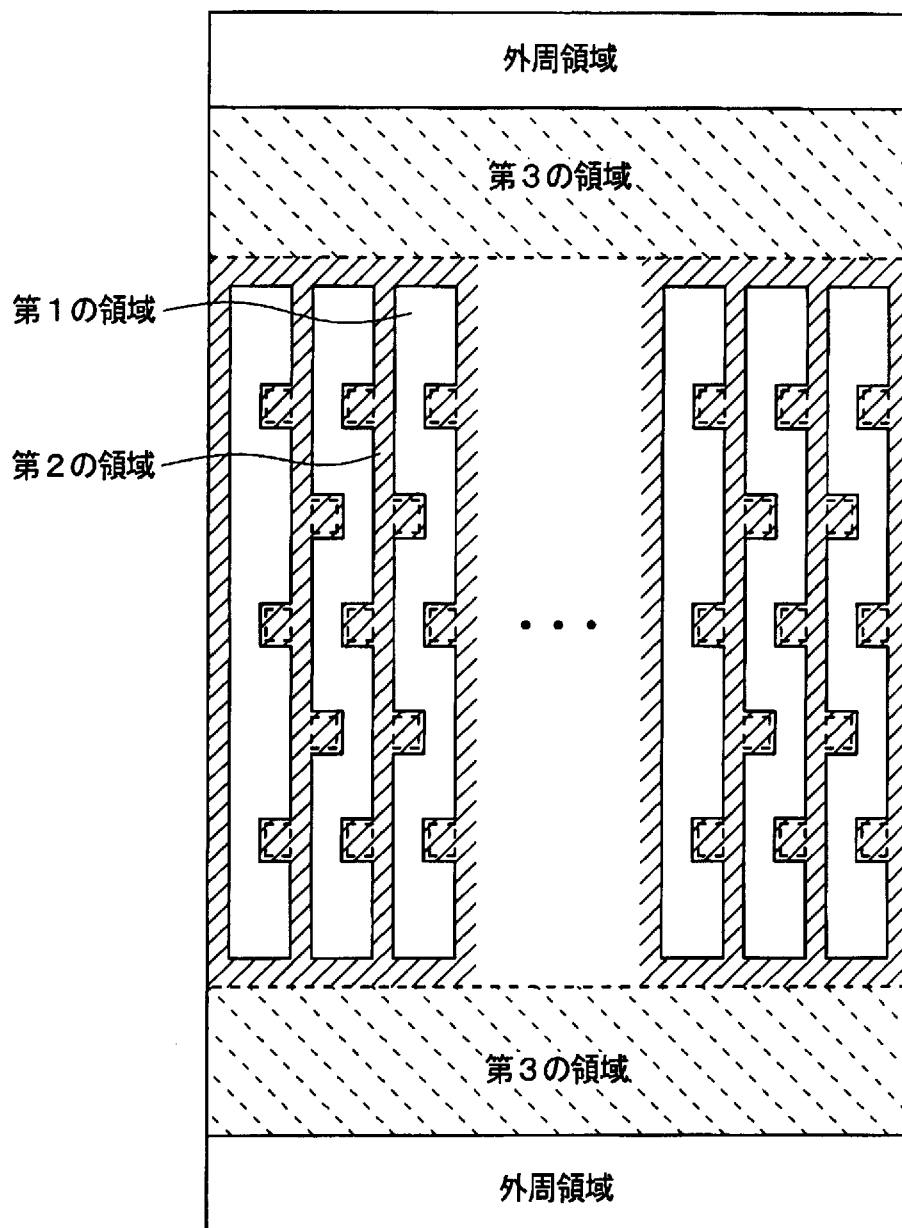
[図17]



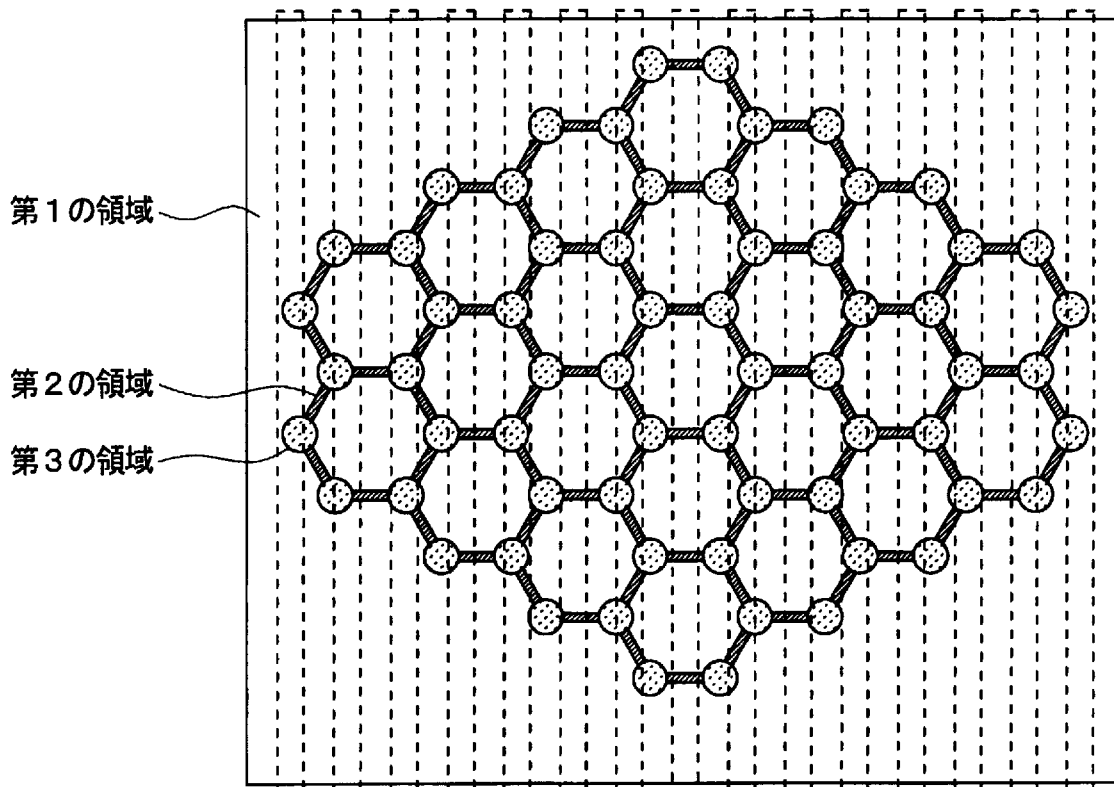
[図18]



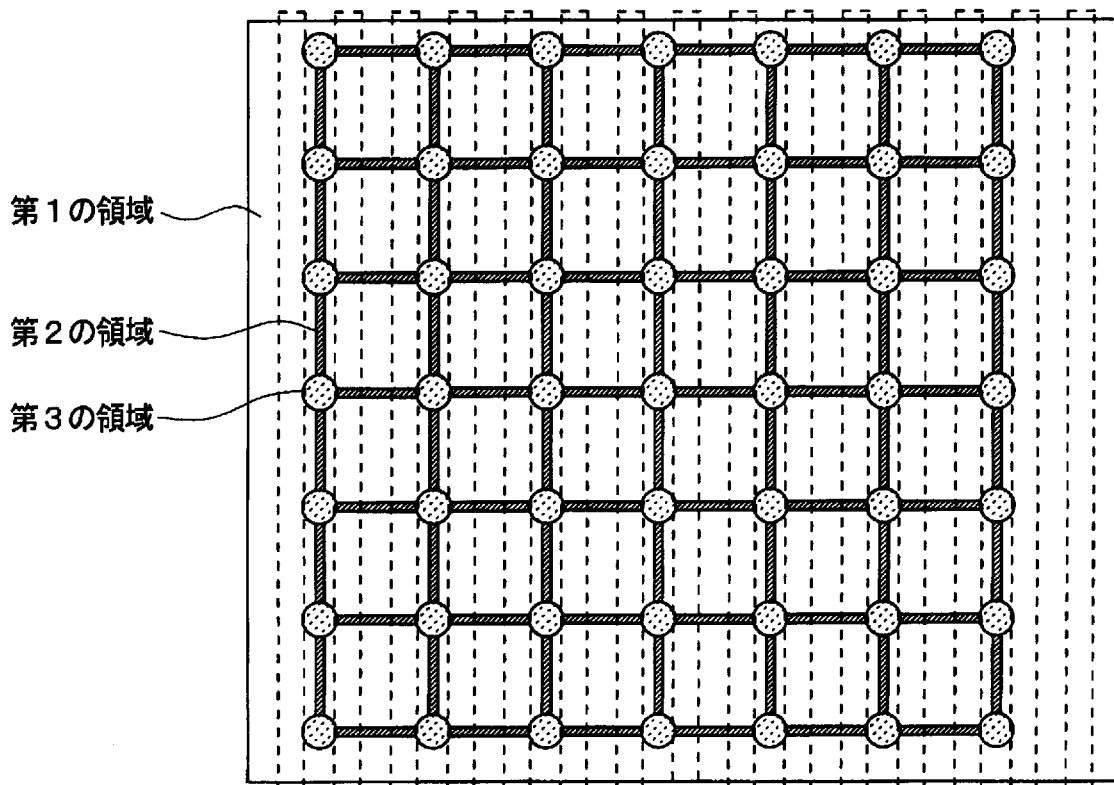
[図19]



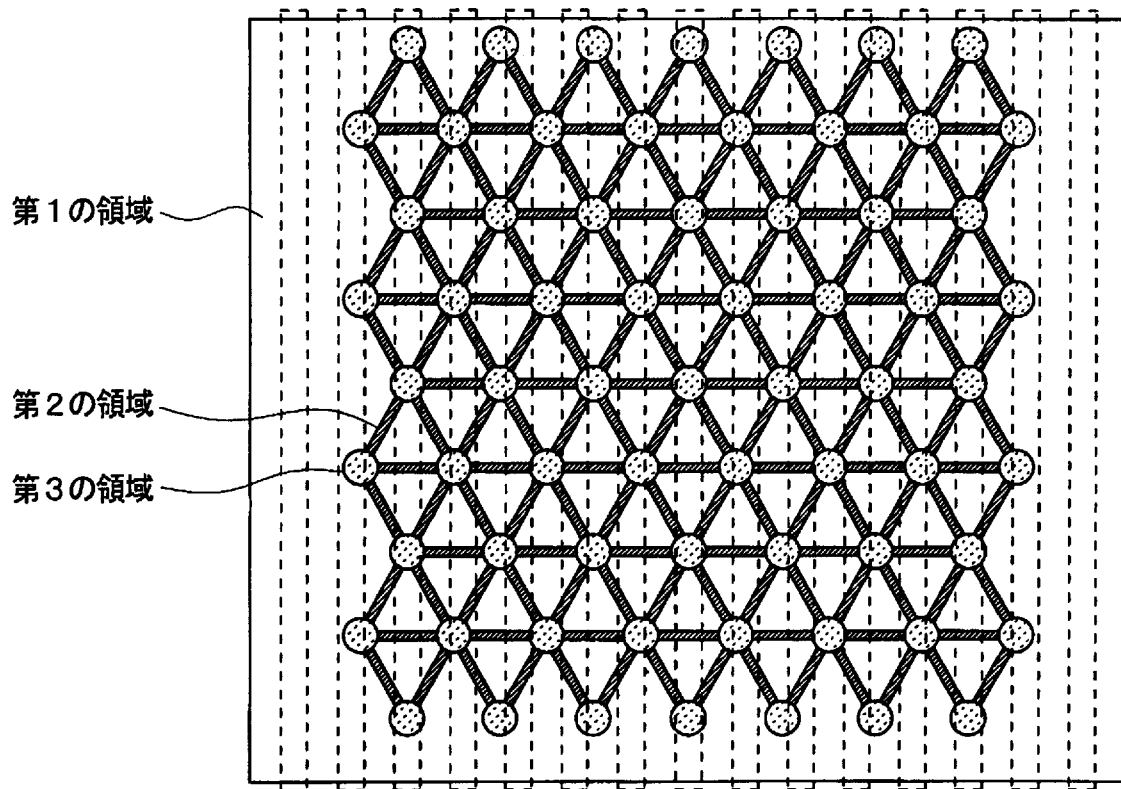
[図20]



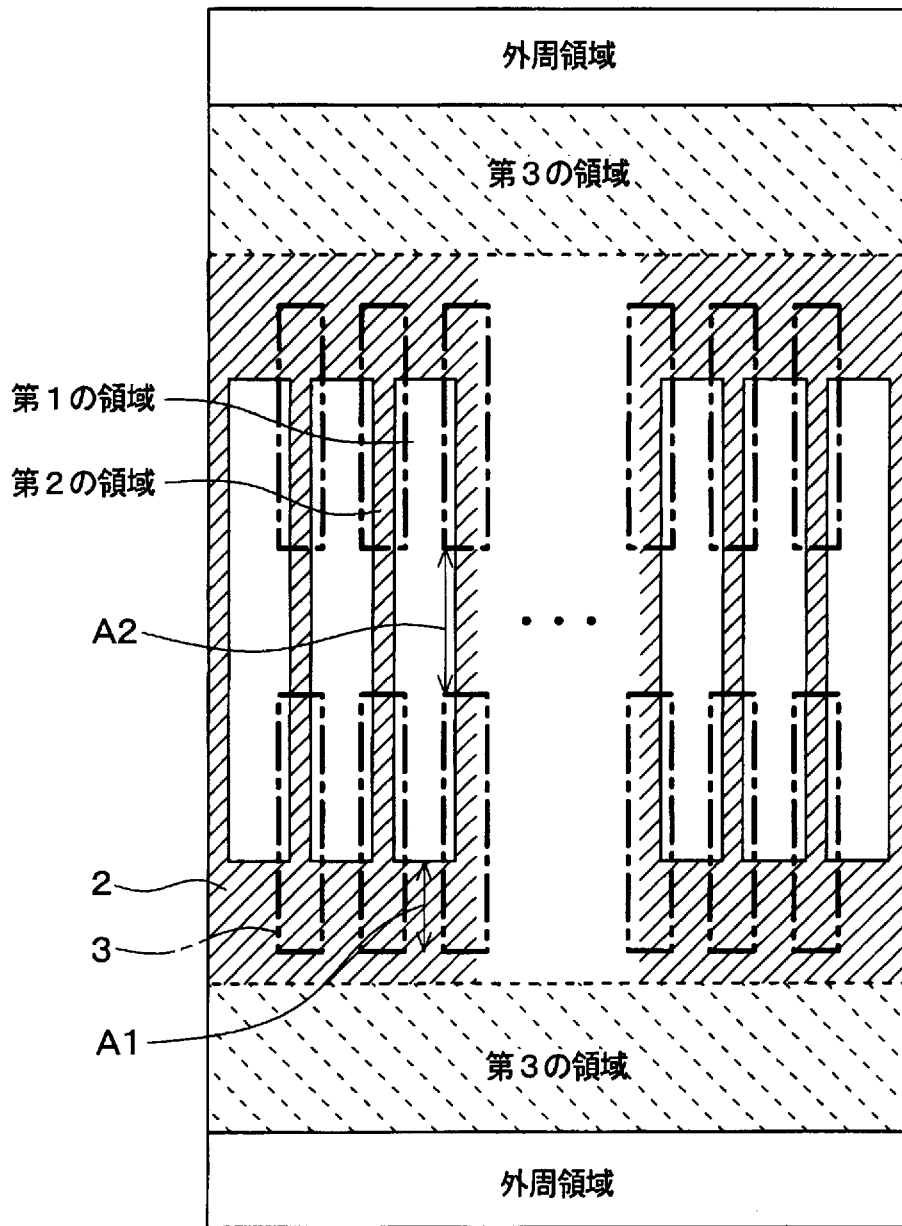
[図21]



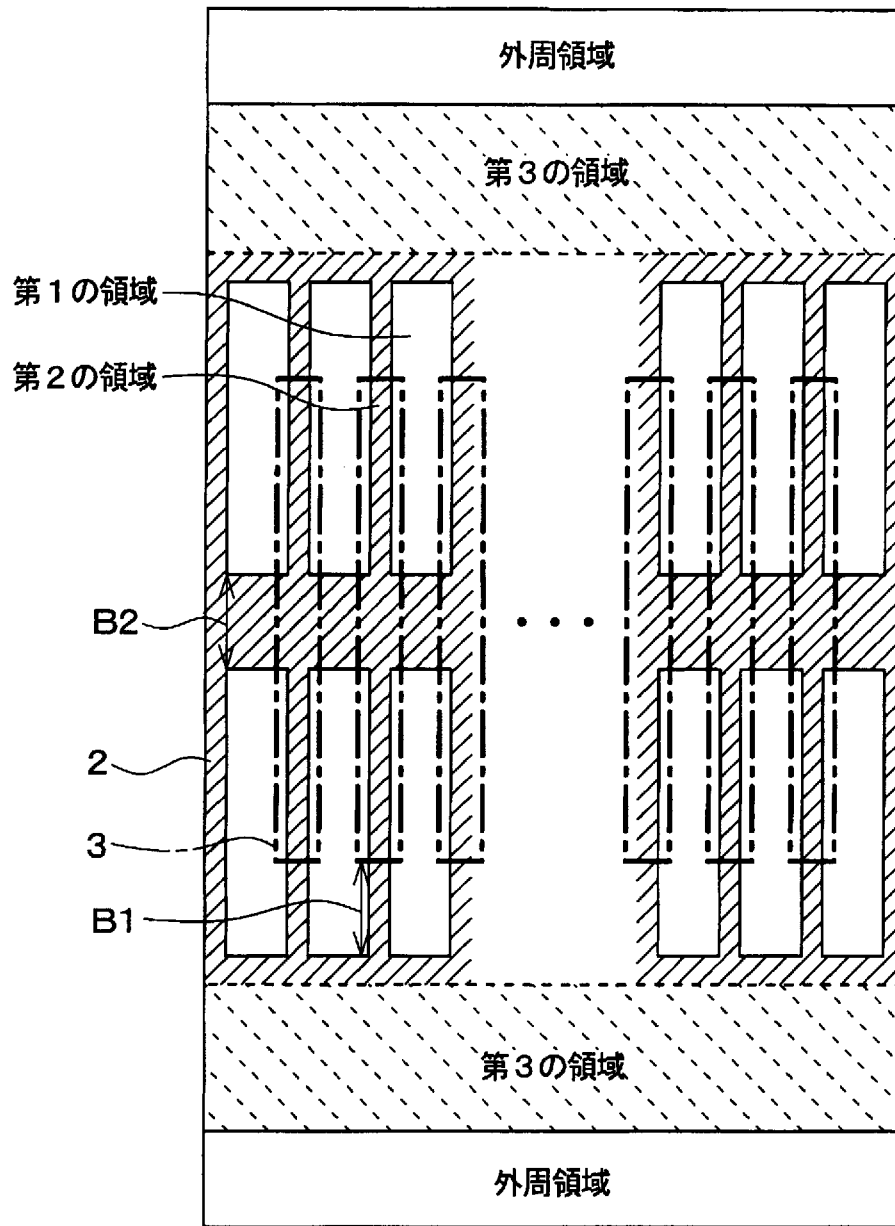
[図22]



[図23]

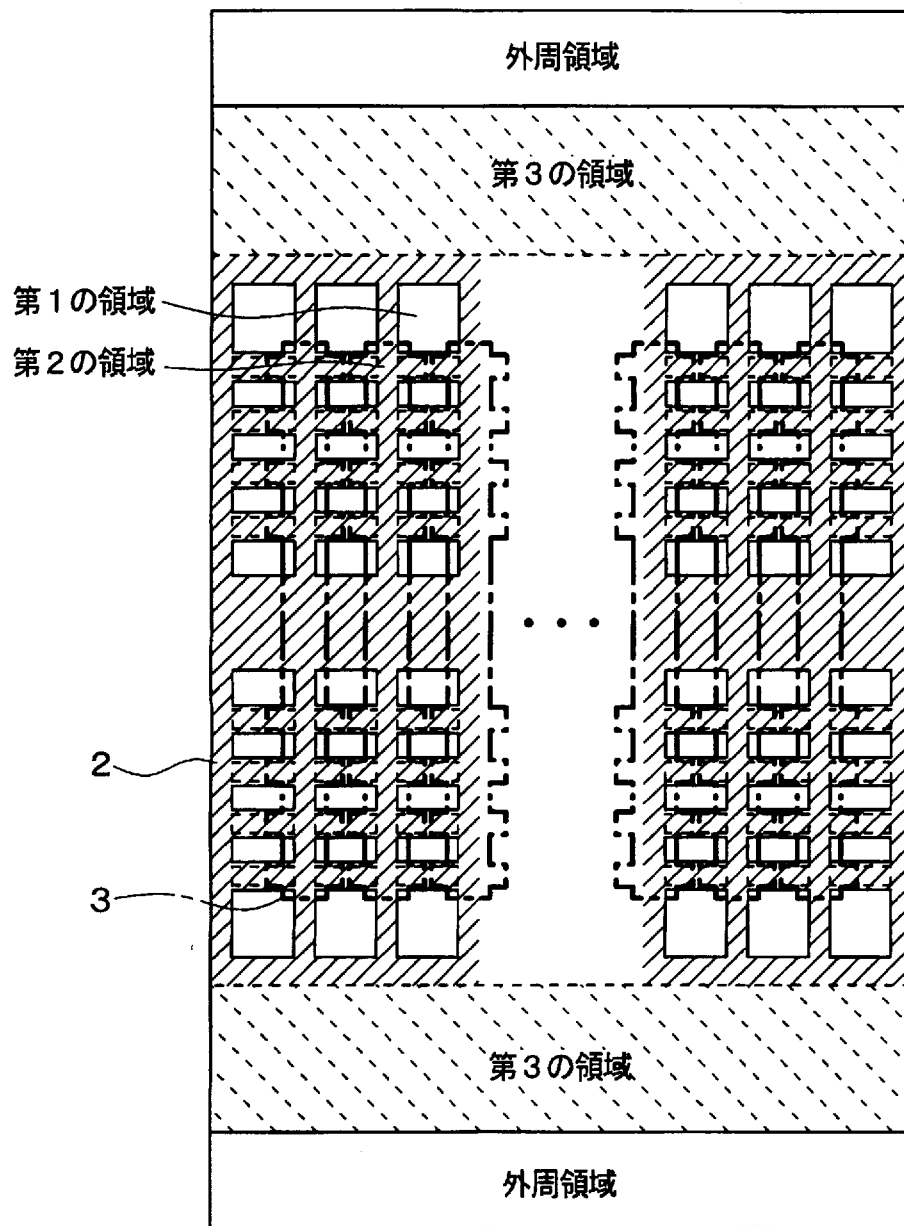


[図24]

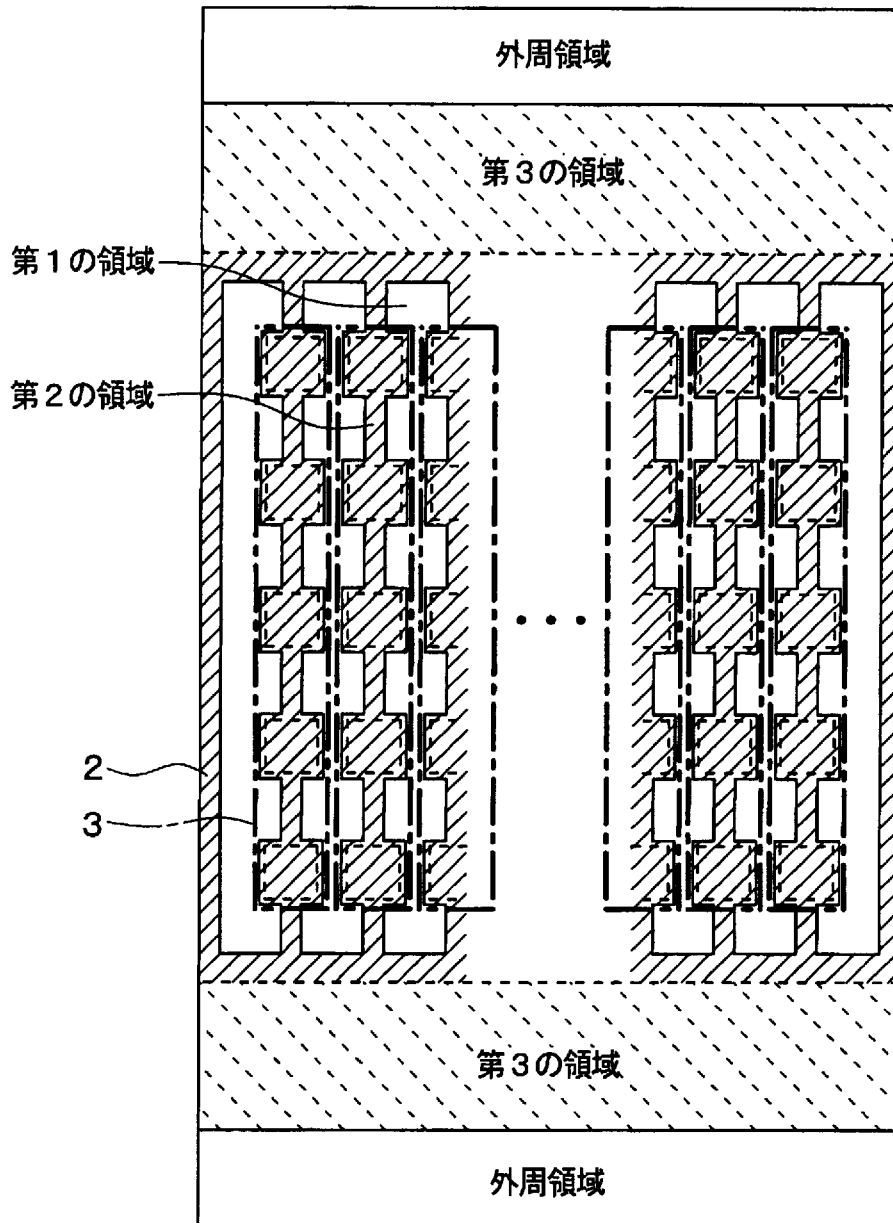




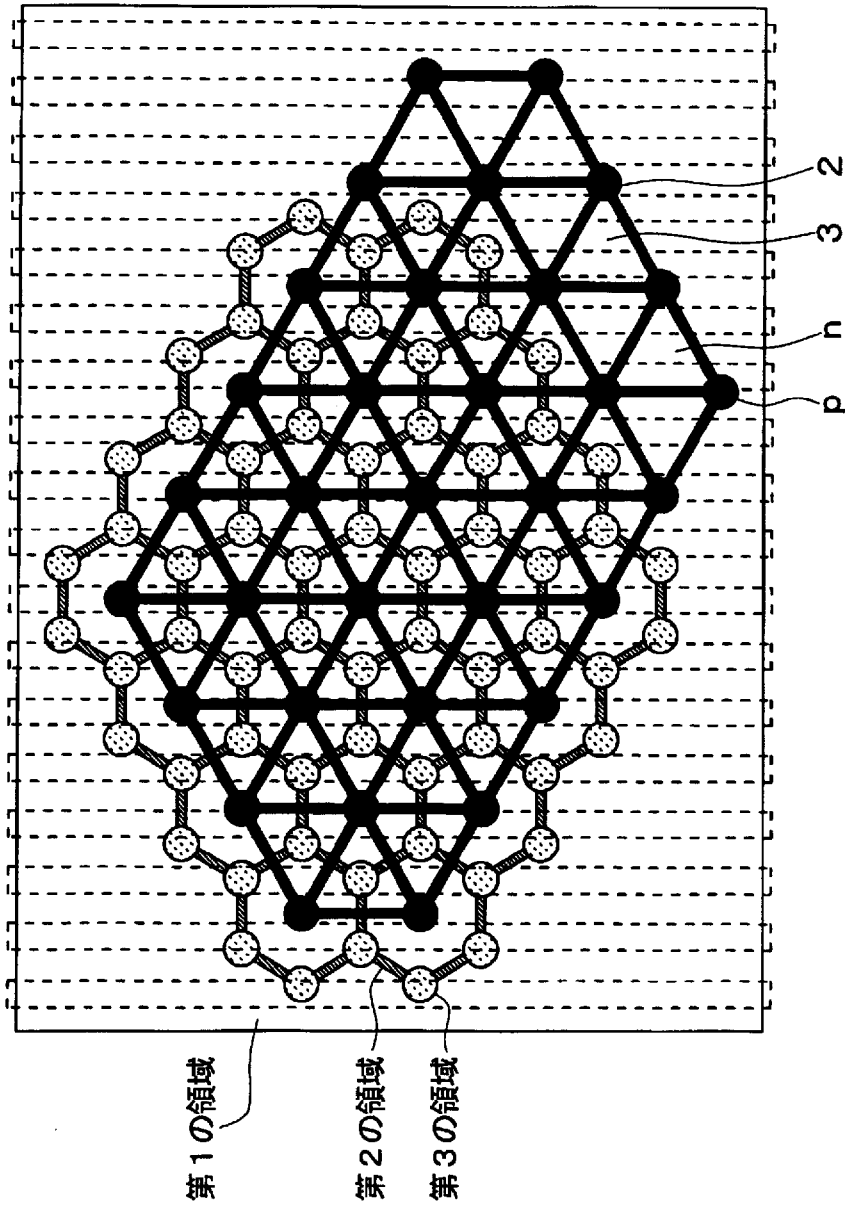
[図25]



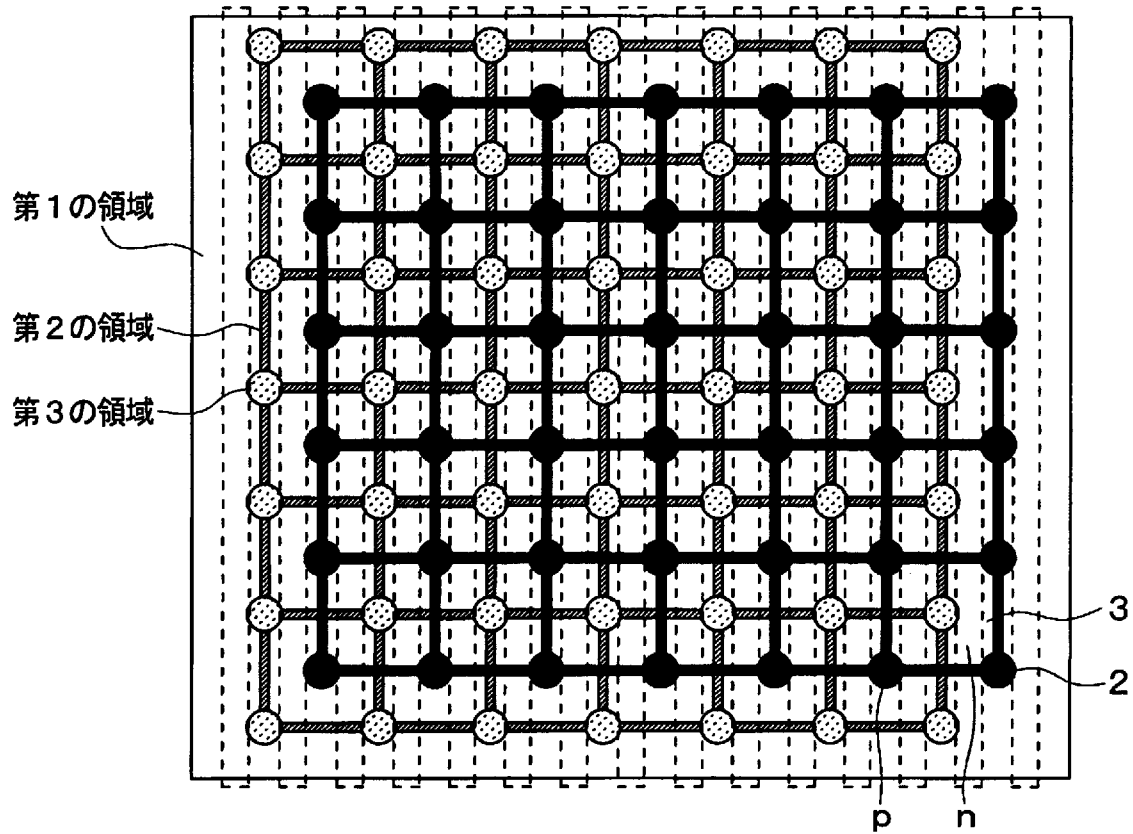
[図26]



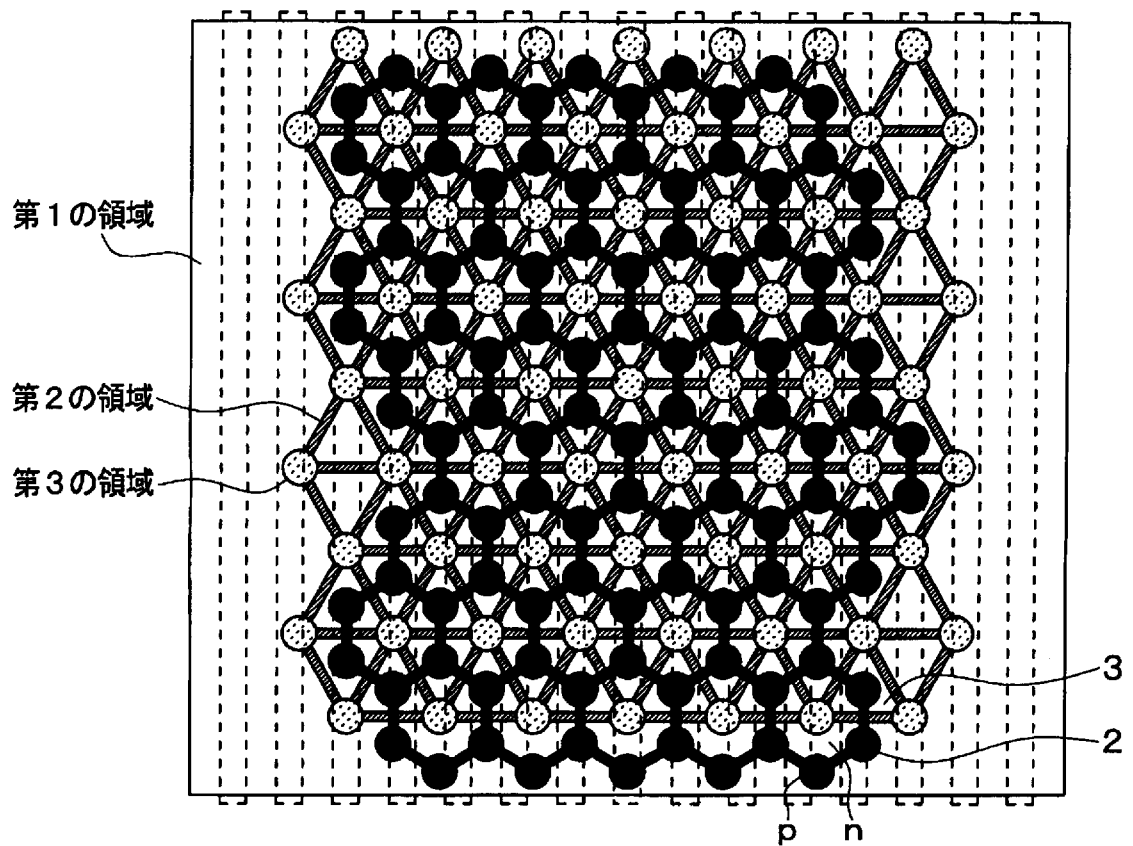
[図27]



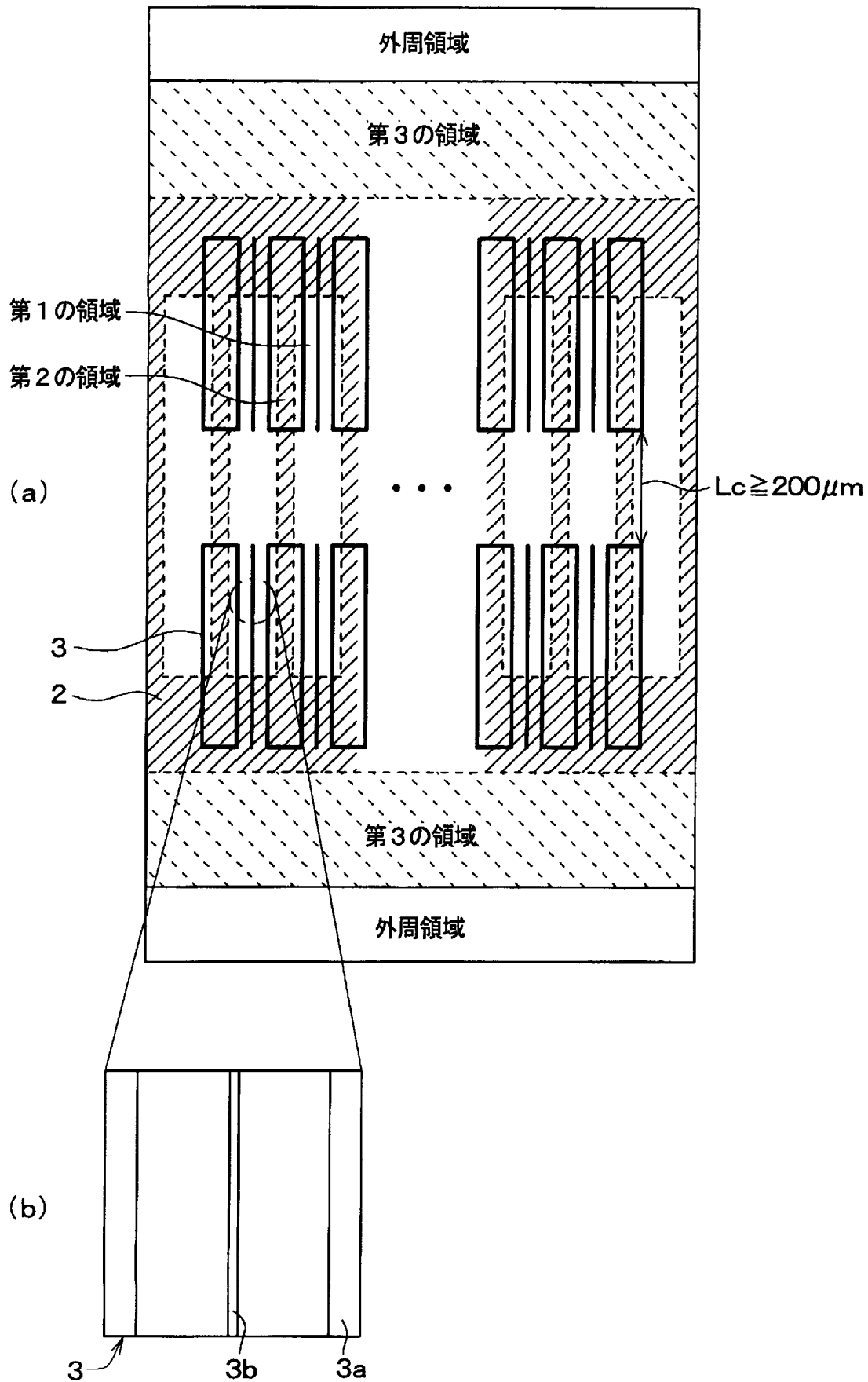
[図28]



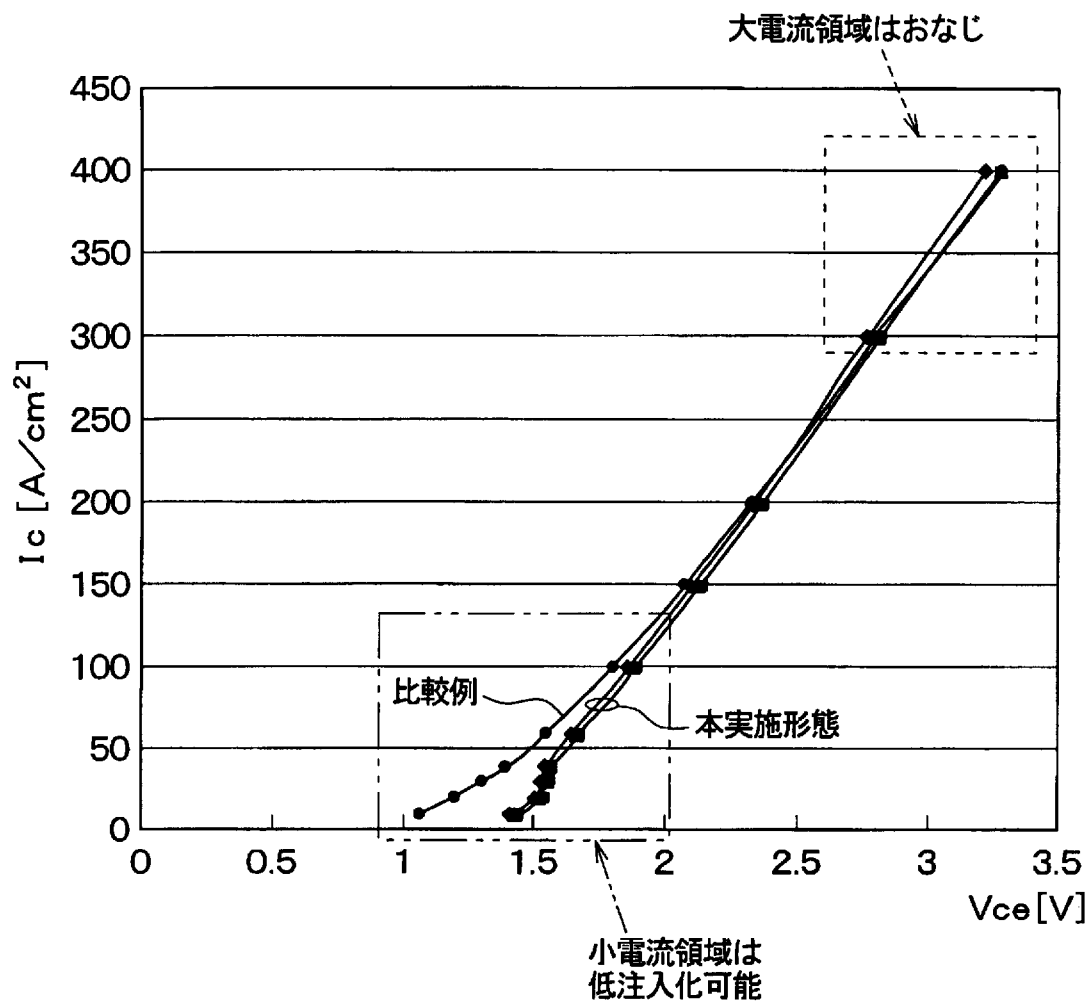
[図29]



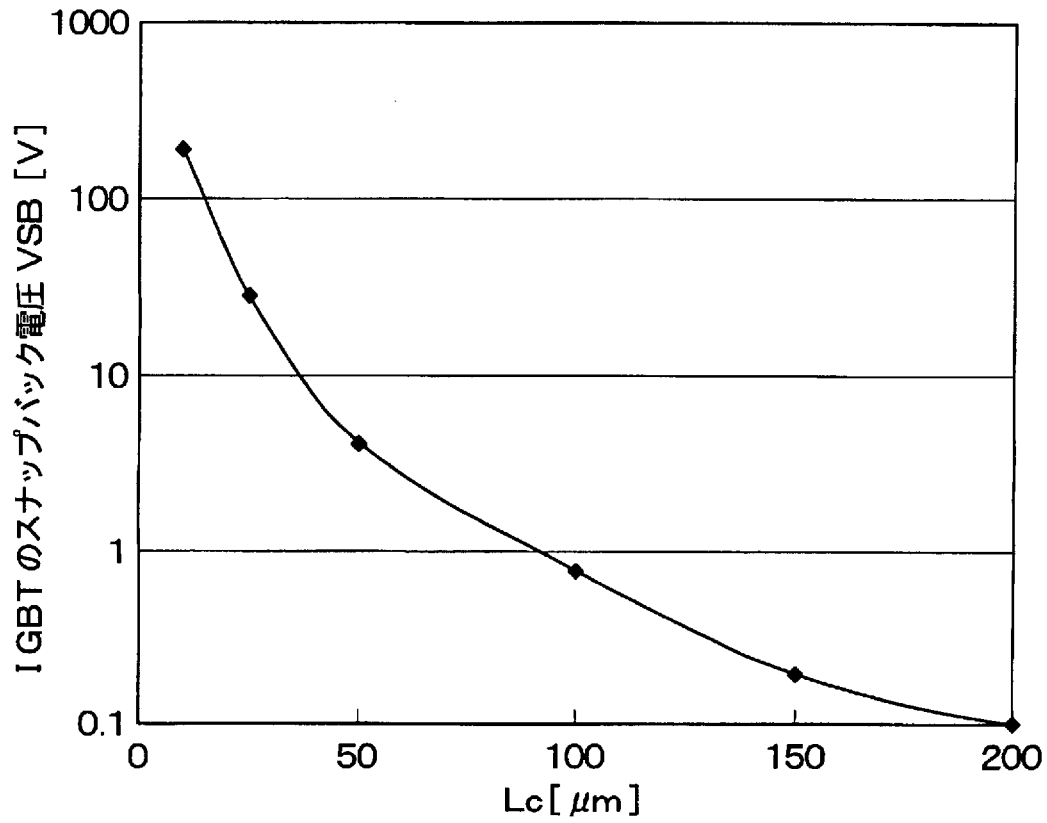
[図30]



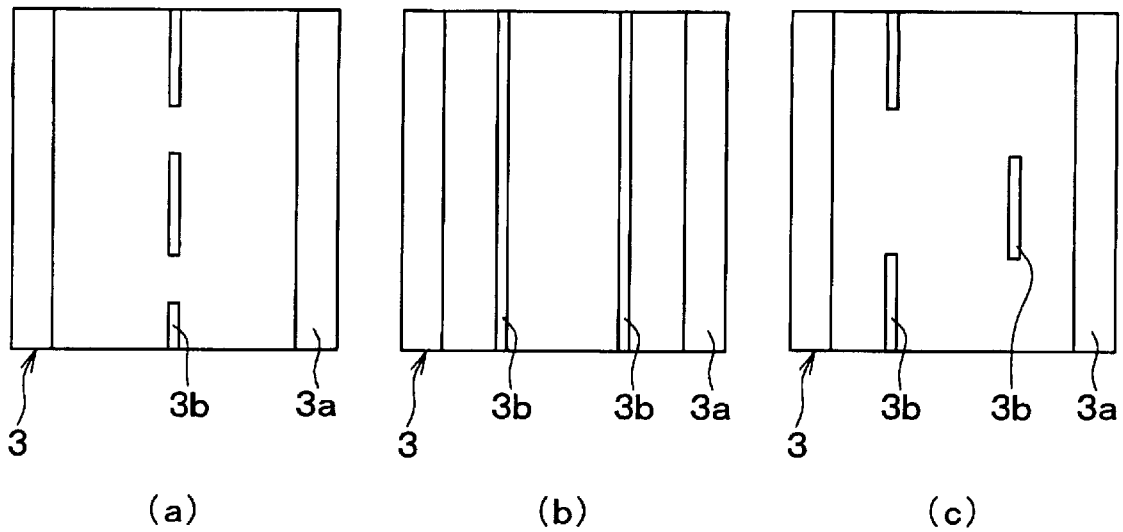
[図31]



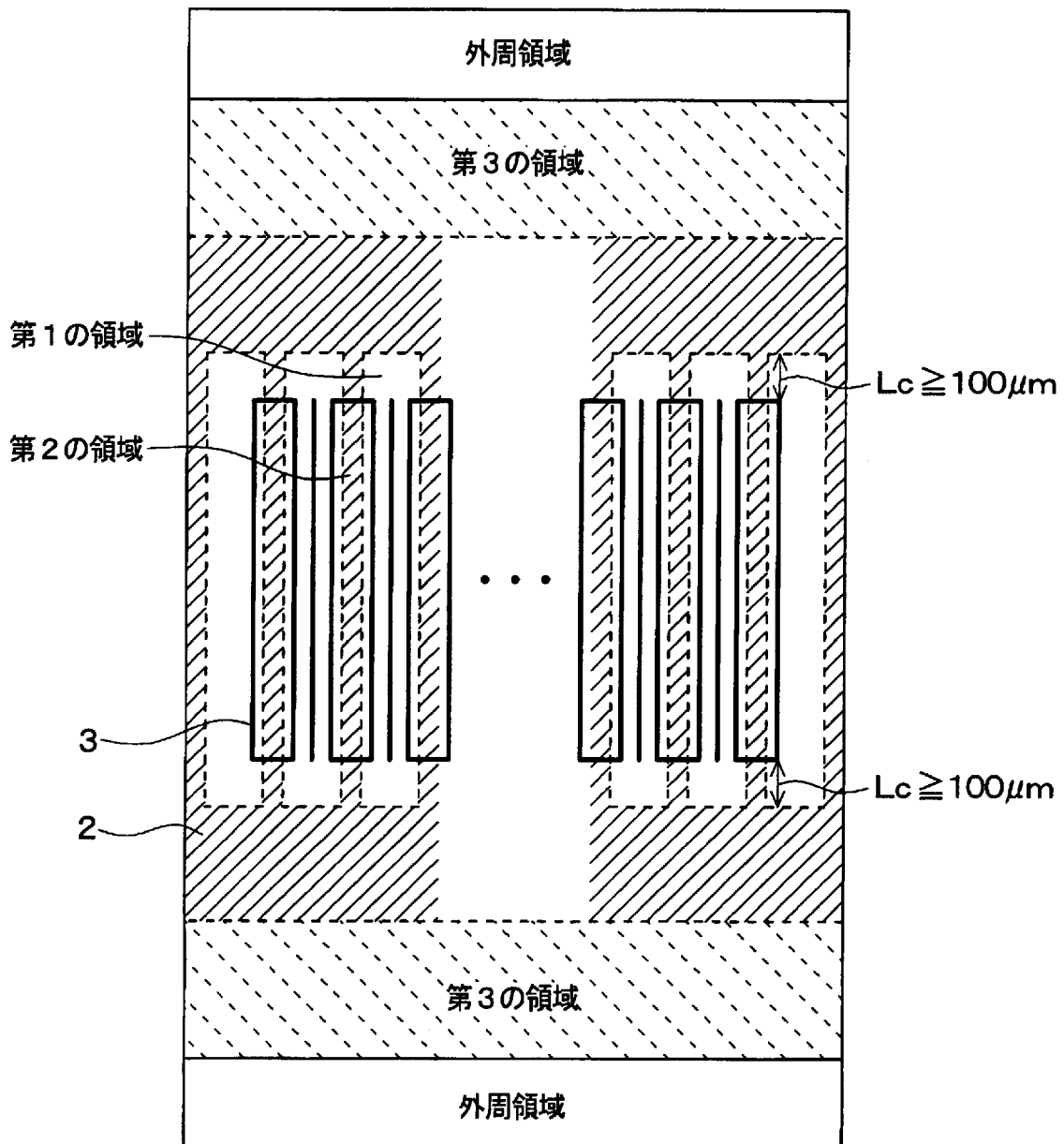
[図32]



[図33]

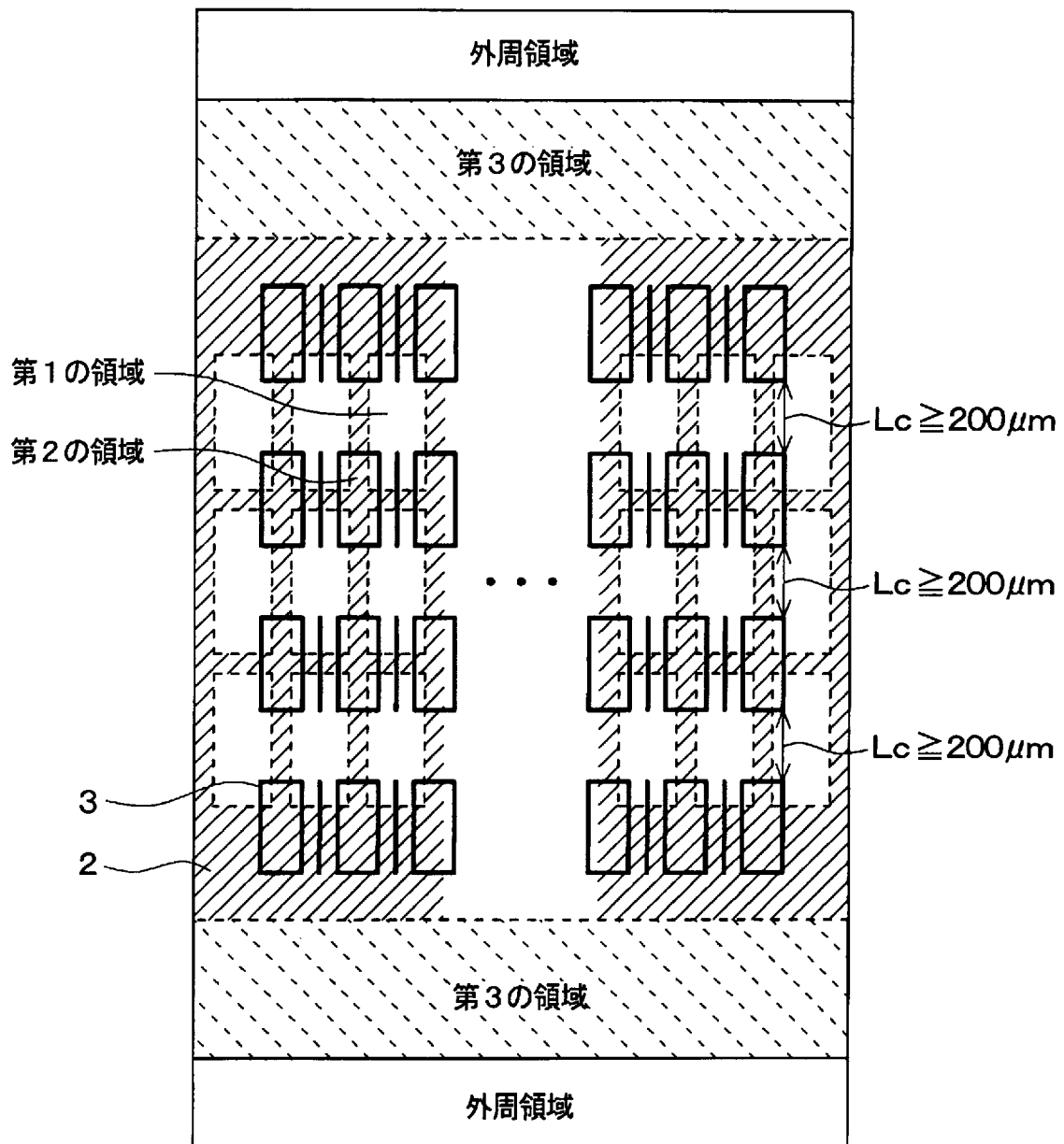


[図34]

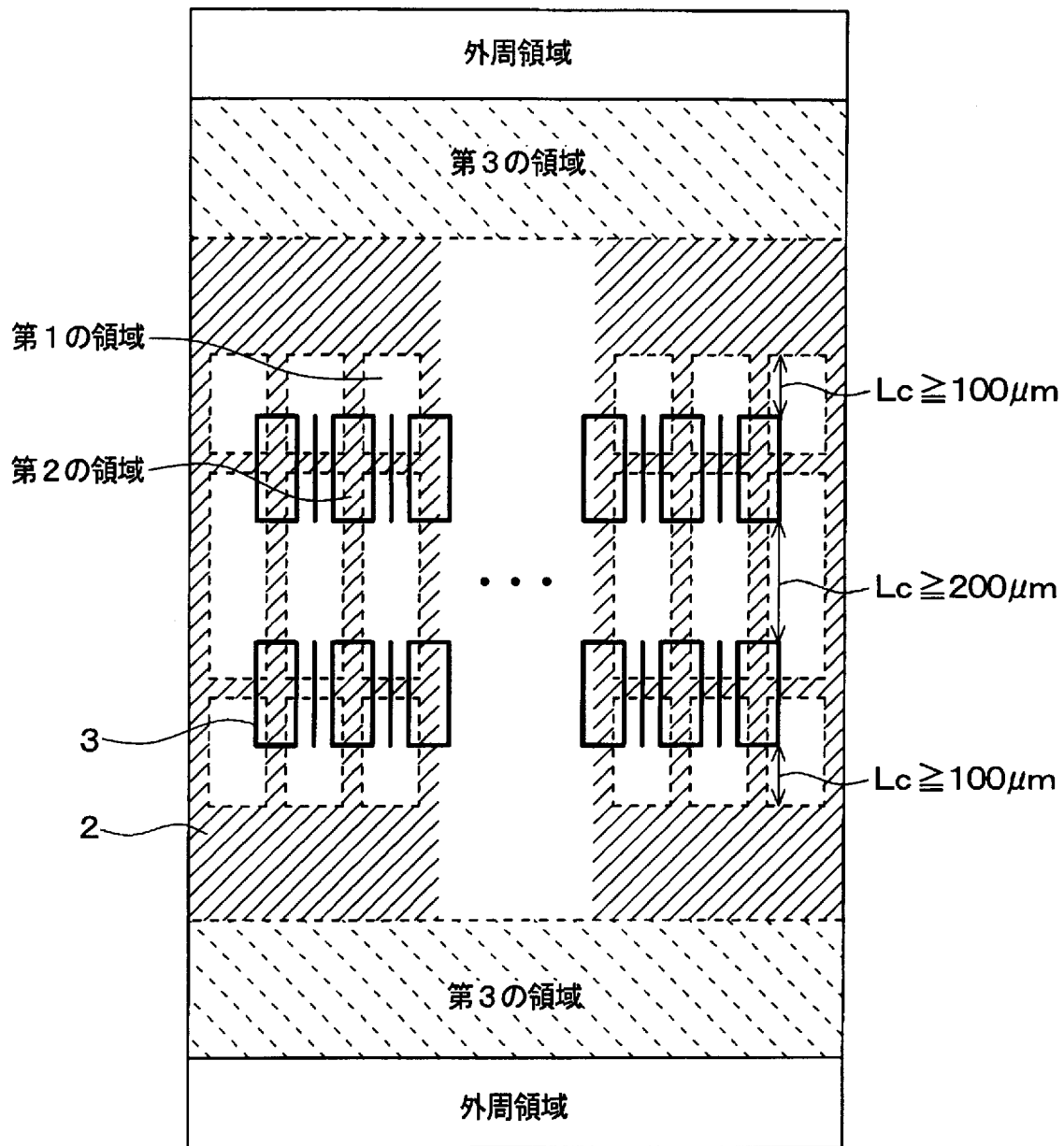




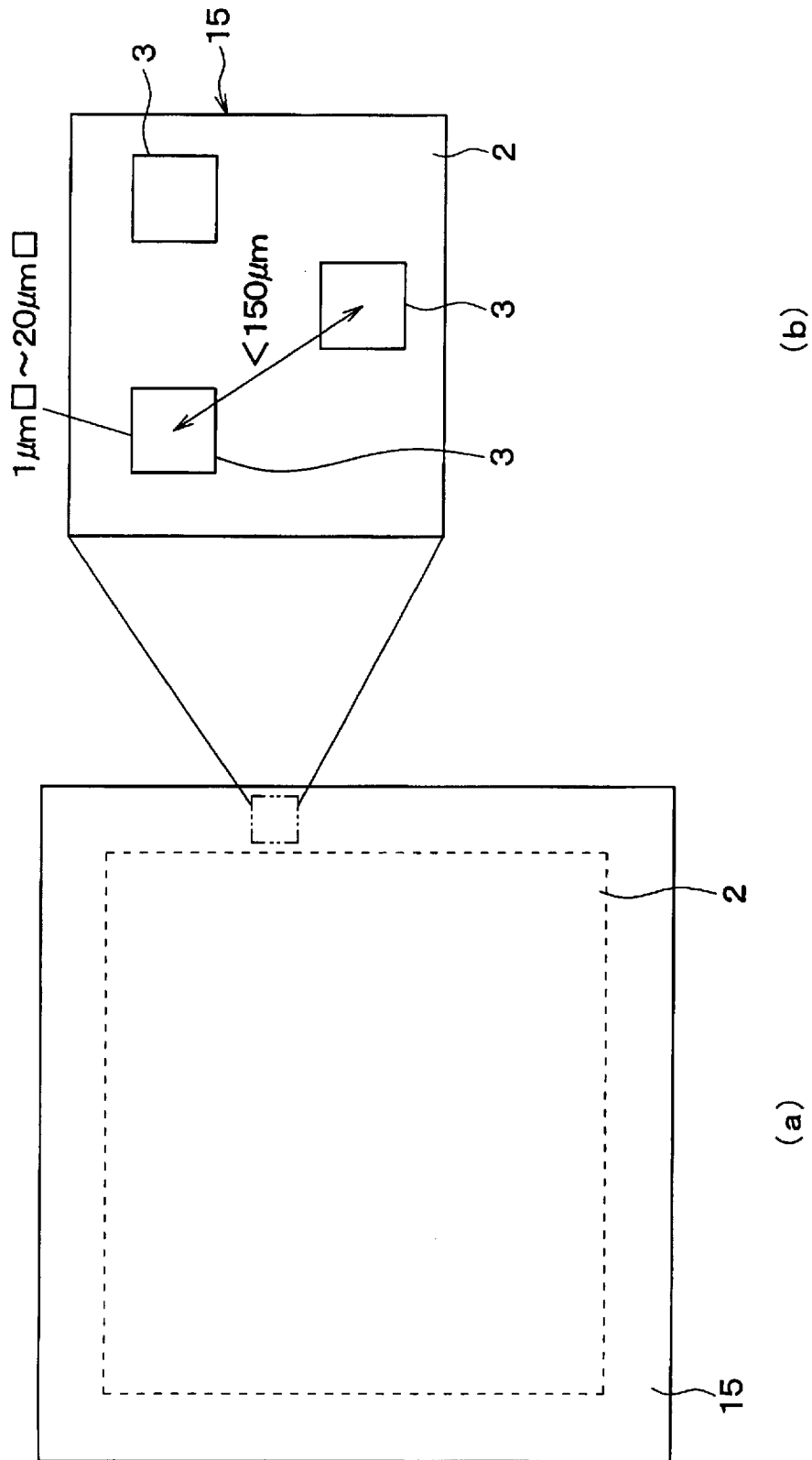
[図35]



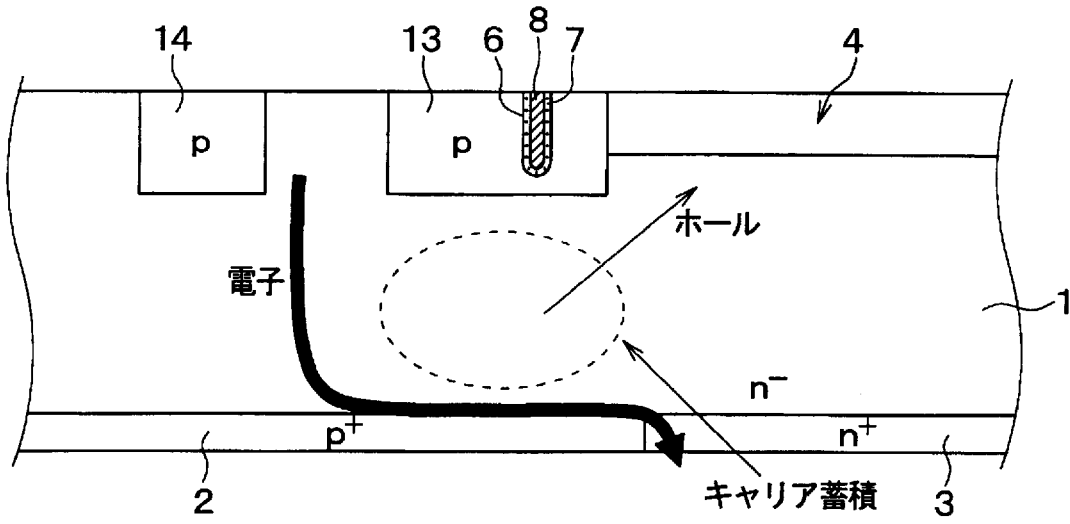
[図36]



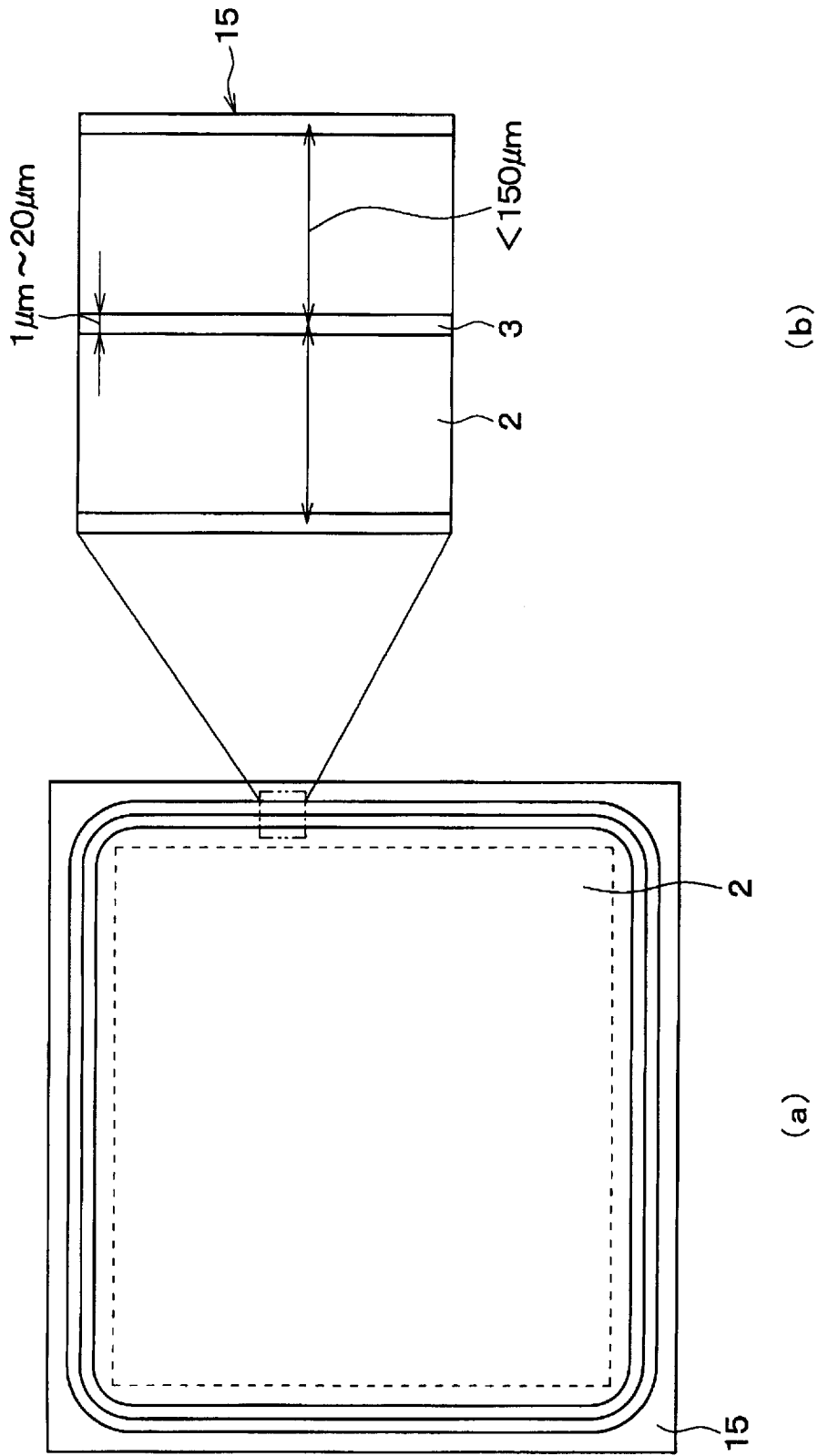
[37]



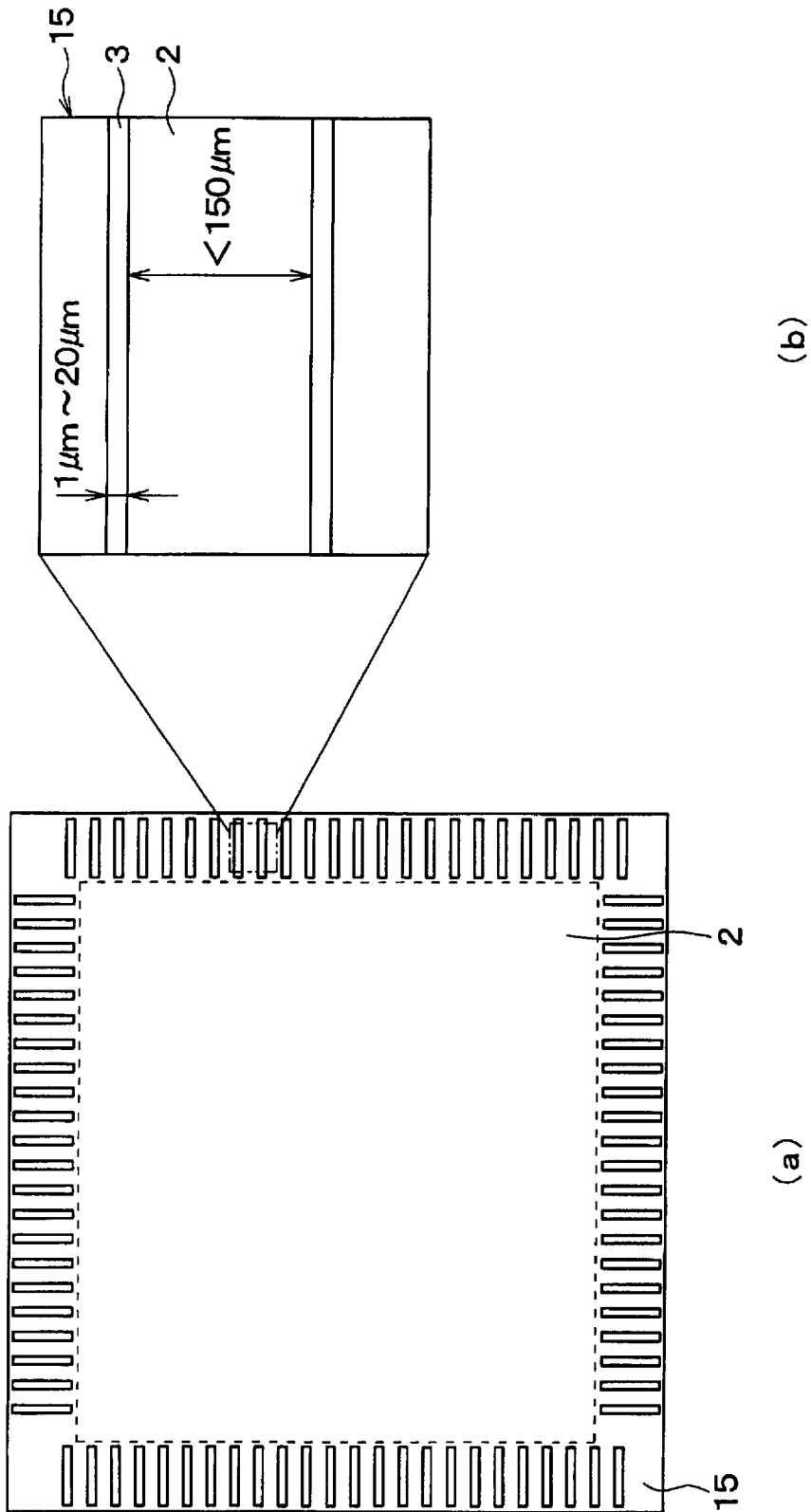
[図38]



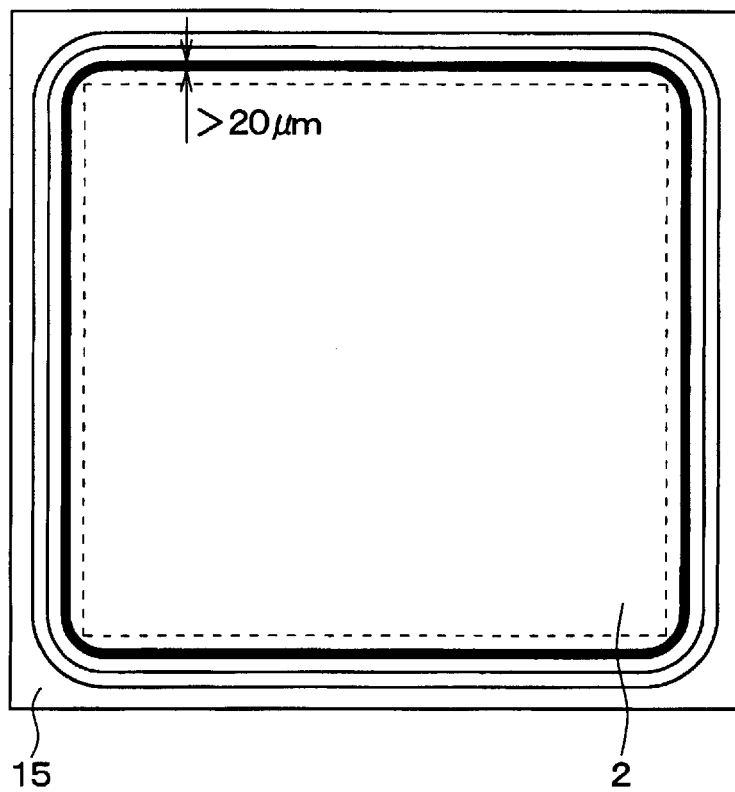
[ 39]



[図40]

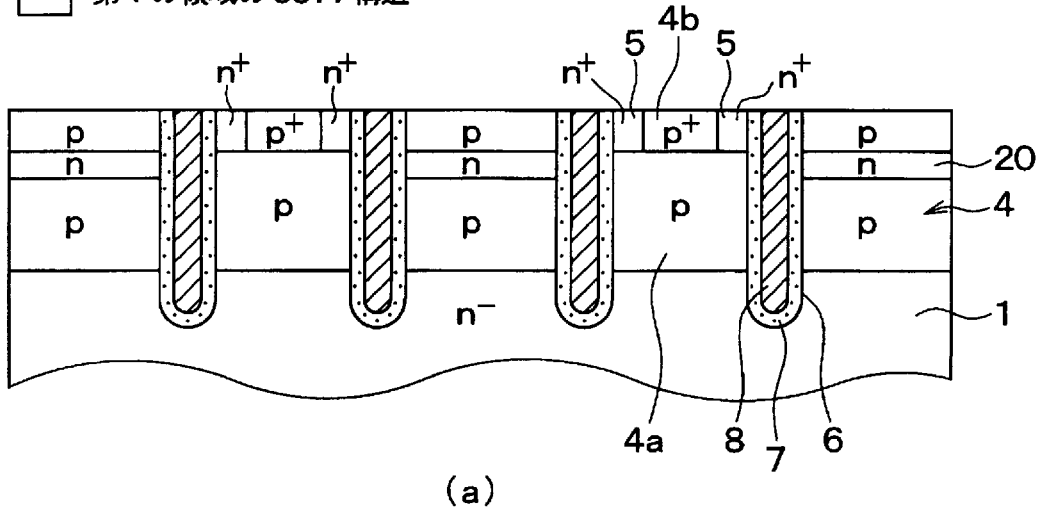


[図41]

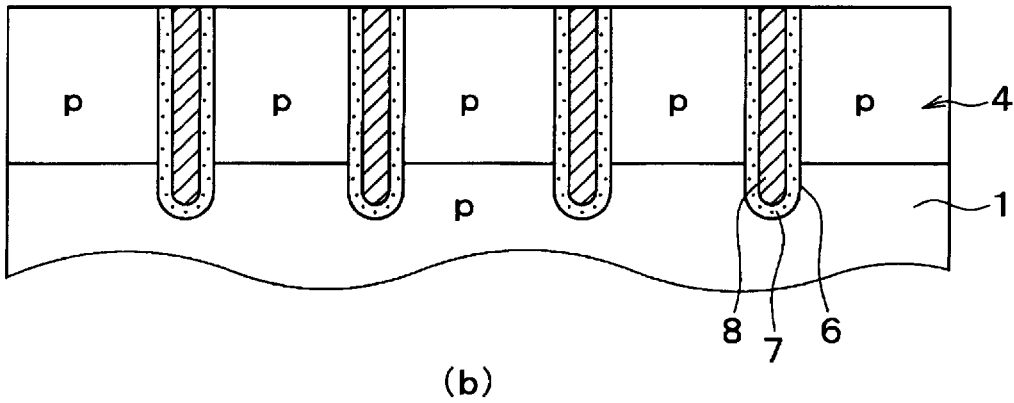


[図42]

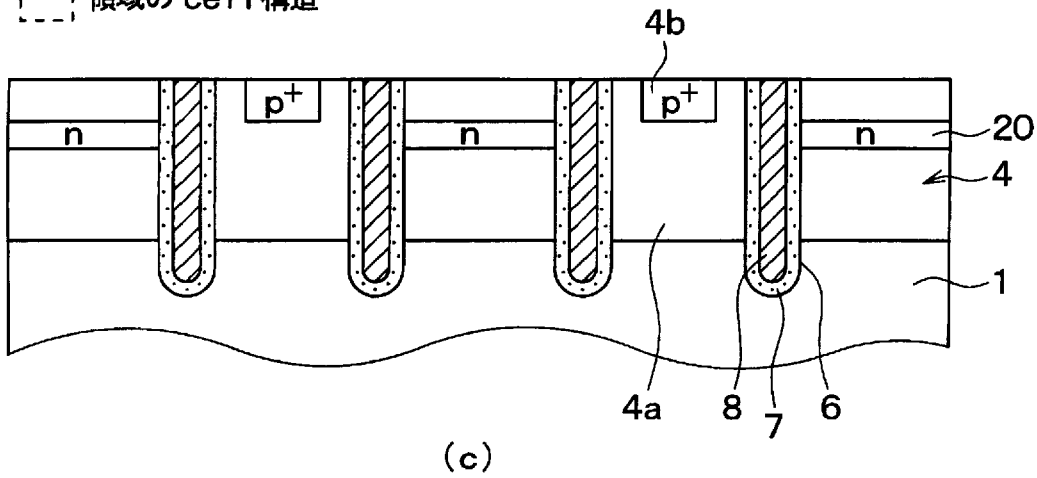
□ 第1の領域の cell 構造



▨ ▨ 第2、第3の領域の cell 構造



▨ 領域の cell 構造





## INTERNATIONAL SEARCH REPORT

International application No.

PCT/JP2011/003718

<b>A. CLASSIFICATION OF SUBJECT MATTER</b> H01 L 2 7/0 4 (2 0 0 6 . 0 1) i , H01L21 /33 6 . 2 0 0 6 . 0 1) ± f H01 L21 /8234 (2 0 0 6 . 0 1) i , H01 L 2 7/0 6 (2 0 0 6 . 0 1) i f H01L2 7 / 0 8 8 (2 0 0 6 . 0 1) i , H01 L 2 9 / 7 3 9 (2 0 0 6 . 0 1) i , H01 1,25/ 7 5 (2 0 0 6 . 0 1) i According to International Patent Classification (IPC) or to both national classification and IPC		
<b>B. FIELDS SEARCHED</b> Minimum documentation searched (classification system followed by classification symbols) H 0 1 L 2 7 / 0 4 , H 0 1 L 2 1 / 3 3 6 , H 0 1 L 2 1 / 8 2 3 4 , H 0 1 L 2 7 / 0 6 , H 0 1 L 2 7 / 0 8 8 , H 0 1 L 2 9 / 7 3 9 , H 0 1 L 2 9 / 7 8 Documentation searched other than minimum documentation to the extent that such documents are included in the fields searched Jitsuyo Shinan Koho 1922-1 996 Jitsuyo Shinan Toroku Koho 1996-2011 Kokai Jitsuyo Shinan Koho 1971-2011 Toroku Jitsuyo Shinan Koho 1994 - 2011 Electronic data base consulted during the international search (name of data base and, where practicable, search terms used)		
<b>C. DOCUMENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT</b>		
Category*	Citation of document, with indication, where appropriate, of the relevant passages	Relevant to claim No.
P, X P, Y P, A	J P 2 0 1 0 - 1 8 6 8 0 5 A ( F u j i E l e c t r i c S y s t e m s C o . , L t d . ) , 2 6 A u g u s t 2 0 1 0 ( 2 6 . 0 8 . 2 0 1 0 ) f p a r a g r a p h s [ 0 0 2 2 ] t o [ 0 0 3 1 ] ; f i g . 1 , 3 t o 1 0 (F a m i l y : n o n e )	1 f 1 6 , 1 7 3 - 6 , 1 5 2 , 7 - 1 4
Y	U S 2 0 1 0 / 0 1 5 6 5 0 6 A I ( D E N S O C O R P . ) , 2 4 J u n e 2 0 1 0 ( 2 4 . 0 6 . 2 0 1 0 ) , p a r a g r a p h s [ 0 1 4 6 ] t o [ 0 1 5 2 ] ; f i g . 1 9 t o 2 1 & J P 2 0 1 0 - 1 7 1 3 8 5 A & D E 1 0 2 0 0 9 0 5 5 3 2 2 A & C N 1 0 1 7 6 4 1 3 9 A	3 - 6 , 1 5
Y	J P 8 - 1 0 2 5 3 6 A ( S a n y o E l e c t r i c C O . , L t d . ) , 1 6 A p r i l 1 9 9 6 ( 1 6 . 0 4 . 1 9 9 6 ) , p a r a g r a p h [ 0 0 2 4 ] ; f i g . 5 (F a m i l y : n o n e )	1 5
<input checked="" type="checkbox"/> Further documents are listed in the continuation of Box C. <input type="checkbox"/> See patent family annex.		
* Special categories of cited documents: "A" document defining the general state of the art which is not considered to be of particular relevance "E" earlier application or patent but published on or after the international filing date "L" document which may throw doubts on priority claim(s) or which is cited to establish the publication date of another citation or other special reason (as specified) "O" document referring to an oral disclosure, use, exhibition or other means "P" document published prior to the international filing date but later than the priority date claimed "Y" later document published after the international filing date or priority date and not in conflict with the application but cited to understand the principle or theory underlying the invention "X" document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered novel or cannot be considered to involve an inventive step when the document is taken alone "Y" document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered to involve an inventive step when the document is combined with one or more other such documents, such combination being obvious to a person skilled in the art "&" document member of the same patent family		
Date of the actual completion of the international search 3 0 S e p t e m b e r , 2 0 1 1 ( 3 0 . 0 9 . 1 1 )		Date of mailing of the international search report 1 1 O c t o b e r , 2 0 1 1 ( 1 1 . 1 0 . 1 1 )
Name and mailing address of the ISA/ J a p a n e s e P a t e n t O f f i c e		Authorized officer
Facsimile No.		Telephone No.

## INTERNATIONAL SEARCH REPORT

International application No.

PCT/JP2011/003718

C (Continuation). DOCUMENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT		
Category*	Citation of document, with indication, where appropriate, of the relevant passages	Relevant to claim No.
A	WO 2007/108456 A1 (Dens o Corp .) , 27 September 2007 (27.09.2007) , paragraph s [0022] to [0118] ; fig . 1 to 13 & JP 2007-288158 A & US 2008/0315248 A1 & DE 112007000010 T & CN 101322248 A	1 - 17

<p>A. 発明の属する分野の分類 (国際特許分類 (IPC))</p> <p>Int.Cl. H01L27/04 (2006. 01) i, H01L21/336 (2006. 01) i, H01L21/8234 (2006. 01) i, 腿 L27/06 (2006. 01) i, H01L27/088 (2006. 01) i, H01L29/739 (2006. 01) i, H01L29/78 (2006. 01) i</p>											
<p>B. 調査を行った分野</p> <p>調査を行った最小限資料 (国際特許分類 (IPC))</p> <p>Int.Cl. H01L27/04, H01L21/336, H01L21/8234, H01L27/06, H01L27/088, H01L29/739, H01L29/78</p>											
<p>最小限資料以外の資料で調査を行った分野に含まれるもの</p> <p>日本国実用新案公報 1922-1996年                  日本国公開実用新案公報 1971-2011年                  日本国実用新案登録公報 1996-2011年                  日本国登録実用新案公報 1994-2011年</p>											
<p>国際調査で使用した電子データベース (データベースの名称、調査に使用した用語)</p>											
<p>C. 関連すると認められる文献</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>引用文献の カテゴリー*</th> <th>引用文献名 及び一部の箇所が関連するときは、その関連する箇所の表示</th> <th>関連する 請求項の番号</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>P, X P, Y P, A</td> <td>JP 2010-186805 A (富士電機システムズ株式会社) 2010. 08. 26, 段落 [0022] - [0031], 図 1, 3-10 (ファミリーなし)</td> <td>1, 16, 17 3-6, 15 2, 7-14</td> </tr> <tr> <td>Y</td> <td>US 2010/0156506 AI (DENSO CORPORATION) 2010. 06. 24, Par. [0146] - [0152], Fig. 19- 21 &amp; JP 2010-171385 A &amp; DE 102009055322 A &amp; CN 101764139 A</td> <td>3-6, 15</td> </tr> </tbody> </table>			引用文献の カテゴリー*	引用文献名 及び一部の箇所が関連するときは、その関連する箇所の表示	関連する 請求項の番号	P, X P, Y P, A	JP 2010-186805 A (富士電機システムズ株式会社) 2010. 08. 26, 段落 [0022] - [0031], 図 1, 3-10 (ファミリーなし)	1, 16, 17 3-6, 15 2, 7-14	Y	US 2010/0156506 AI (DENSO CORPORATION) 2010. 06. 24, Par. [0146] - [0152], Fig. 19- 21 & JP 2010-171385 A & DE 102009055322 A & CN 101764139 A	3-6, 15
引用文献の カテゴリー*	引用文献名 及び一部の箇所が関連するときは、その関連する箇所の表示	関連する 請求項の番号									
P, X P, Y P, A	JP 2010-186805 A (富士電機システムズ株式会社) 2010. 08. 26, 段落 [0022] - [0031], 図 1, 3-10 (ファミリーなし)	1, 16, 17 3-6, 15 2, 7-14									
Y	US 2010/0156506 AI (DENSO CORPORATION) 2010. 06. 24, Par. [0146] - [0152], Fig. 19- 21 & JP 2010-171385 A & DE 102009055322 A & CN 101764139 A	3-6, 15									
<p><input checked="" type="checkbox"/> c 欄の続きにも文献が列挙されている。 <input type="checkbox"/> パテントファミリーに関する別紙を参照。</p>											
<p>* 引用文献のカテゴリー</p> <p>IA 「特に関連のある文献ではなく、一般的技術水準を示すもの」</p> <p>IE 「国際出願日前の出願または特許であるが、国際出願日以後に公表されたもの」</p> <p>I 「優先権主張に疑義を提起する文献又は他の文献の発行日若しくは他の特別な理由を確立するために引用する文献 (理由を付す)」</p> <p>Iθ 「口頭による開示、使用、展示等に言及する文献」</p> <p>IP 「国際出願日前で、かつ優先権の主張の基礎となる出願日の後に公表された文献」</p> <p>け 「国際出願日又は優先日後に公表された文献であつて出願と矛盾するものではなく、発明の原理又は理論の理解のために引用するもの」</p> <p>X 「特に関連のある文献であつて、当該文献のみで発明の新規性又は進歩性がないと考えられるもの」</p> <p>Y 「特に関連のある文献であつて、当該文献と他の1以上の文献との、当業者にとって自明である組合せによって進歩性がないと考えられるもの」</p> <p>&amp; 「同一パテントファミリー文献」</p>											
<p>国際調査を完了した日</p> <p>30. 09. 2011</p>	<p>国際調査報告の発送日</p> <p>11. 10. 2011</p>										
<p>国際調査機関の名称及びあて先</p> <p>日本国特許庁 (ISA/JP)</p> <p>郵便番号 100-8915</p> <p>東京都千代田区霞が関三丁目4番3号</p>	<p>特許庁審査官 (権限のある職員)</p> <p>原 和秀</p> <p>電話番号 03-3581-1101 内線 3462</p>	<p>4 M 4039</p>									

C (続き) . 関連すると認められる文献		
引用文献の カテゴリー*	引用文献名 及び一部の箇所が関連するときは、その関連する箇所の表示	関連する 請求項の番号
Y	JP 8- 102536 A (三洋電機株式会社) 1996. 04. 16 , 段落 [0024] , 図 5 (ファミリーなし)	15
A	W0 2007/108456 A1 (株式会社デンソー) 2007. 09. 27, 段落 [0022] - [0118], 図 1- 13 & JP 2007-288 158 A & US 2008/03 15248 A I & DE 112007000010 T & CN 101322248 A	1- 17